



旭東機械工業股份有限公司
(SHUZ TUNG MACHINERY INDUSTRIAL CO., LTD)

一一三年度 年報

中華民國一十四年五月二十三日刊印

年報查詢網址：<http://mops.twse.com.tw>

本公司網址：<http://www.wisepioneer.com.tw>
<http://www.shuztung.com>

一、本公司發言人：

姓名：呂海淋

職稱：財務主管、會計主管、公司治理主管

電話：(04)2556-1000

電子郵件信箱：ranlu@shuztung.com.tw

本公司代理發言人：

姓名：林育信

職稱：總經理室 特別助理

電話：(04)2556-1000

電子郵件信箱：yuhsin@shuztung.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及總公司電話：

總公司地址：台中市后里區后里里后科南路30號

分公司地址：台中市大甲區頂店里中山路一段1325號

外埔廠地址：台中市外埔區大同里后寮路15-6號

幼獅廠地址：台中市大甲區日南里幼六路20號1樓

昆山廠地址：江蘇省昆山經濟技術開發區東部工業區金陽西路6號

總公司電話：(04)2556-1000

三、股票過戶機構名稱、地址、網址及電話：

名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部

地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓

網址：<https://www.fubon.com/>

電話：(02)2361-1300

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

簽證會計師姓名：陳燕慧會計師、陳政學會計師

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所

地址：台北市信義區信義路五段7號68樓

網址：<http://www.kpmg.com.tw>

電話：(02)8101-6666

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：
無。

六、公司網址：<http://www.wisepioneer.com.tw>

<http://www.shuztung.com>

目錄

壹、 致股東報告書	1
貳、 公司治理報告	4
一、 董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	4
二、 董事會多元化及獨立性	11
三、 公司治理運作情形	16
四、 會計師公費資訊	31
五、 更換會計師資訊	32
六、 公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者	32
七、 最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	32
八、 持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：	33
九、 公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	35
參、 募資情形	36
一、 資本及股份	36
二、 公司債辦理情形	38
三、 特別股辦理情形	38
四、 海外存託憑證辦理情形	38
五、 員工認股權憑證辦理情形	38
六、 限制員工權利新股辦理情形	38
七、 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	38
八、 資金運用計畫執行情形	38
肆、 營運概況	39
一、 業務內容	39
二、 市場及產銷概況	66
三、 從業員工最近二年度及截至年報刊印日止之資料	77
四、 環保支出資訊	77
五、 勞資關係	77
六、 資通安全管理	79
七、 重要契約	80
伍、 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	81
一、 財務狀況	81
二、 財務績效	81
三、 現金流量	82
四、 最近年度重大資本支出對財務業務之影響	82
五、 最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫	82
六、 最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估	84
七、 其他重要事項	86
陸、 特別記載事項	87
一、 關係企業相關資料	87
二、 最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	87
三、 其他必要補充說明事項	87
柒、 最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證	

壹、致股東報告書

各位股東先生、女士，大家好！

承蒙各位股東於百忙之中撥冗與會，深表感謝。茲將本公司一一三年度營運成果及未來展望報告如下：

一、一一三年度營業報告

(一)營業計劃實施成果：

一一三年度合併營收為新台幣 1,822,989 千元，較一一二年度 1,627,153 千元增加 195,836 千元，增加 12.04%；稅後淨利為新台幣 40,063 千元，較一一二年度稅後淨損 134,288 千元增加 174,351 千元，增加 129.83%，每股稅後盈餘為 0.51 元。

(二)預算執行情形：

一一三年度未公開財務預測，故無預算達成情形。

(三)財務收支及獲利能力分析：

項目		112 年	113 年
財務結構(%)	負債占資產比率	66.14	65.14
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	219.44	293.66
償債能力(%)	流動比率	135.50	173.62
	速動比率	97.11	128.00
	利息保障倍數	-3.48	3.88
獲利能力	資產報酬率(%)	-2.59	1.67
	股東權益報酬率(%)	-8.92	2.85
	稅前純益占實收資本比率(%)	-18.40	12.91
	純益率(%)	-8.25	2.20
	每股盈餘(元)	-1.70	0.51

(四)研究發展狀況：

旭東基於多年來奠基之尖端研發能量，積極佈局智慧設備、整合智慧系統以及設備低碳化，發展智能產線之應用設備及綠色製造。並在半導體先進封裝製程、高階顯示器製程相關設備及自行車、航太、高階散熱等產業專用設備已多有所斬獲，其客群已包含國內與國際指標性大廠。

未來設備智慧化的發展趨勢將會朝向自動化數據收集與分析、自主維護及自我診斷及智慧化控制、節能低碳生產循環等方向發展，以提高生產效率品質及產品永續。旭東將積極整合全方位的研發能量，與時俱進扮演產業鏈轉型應用的關鍵角色，擴展公司的營運能量。

二、一一四年度營運計畫概要

(一)經營方針：

展望未來，產業趨勢持續加速數位轉型與綠色轉型的腳步，落實企業誠信經營與強化內部治理，以符合監管機構、股東和員工等利害關係人的期望。因此深化機械設備創新的核心技術，提高精密機械產業附加價值及永續製造，持續投入推動綠色供應鏈的產業趨勢。

旭東機械將秉持全力追求成為全球頂尖製程設備商的願景為目標。全體經營團隊以堅持改善、精益求精的經營決心，以期在各領域不斷精進成長。並佈局技術創新，經由研發、行銷及生產策略之相互配合運作，擴展多元營運方向及能量，提升公司整體獲利能力。

(二)市場銷售預測：

美國和歐盟市場對台灣自行車製造商來說意味著巨大的機會。受人們健康意識增強、環境問題以及對永續交通的偏好日益增加等因素推動，海外對自行車的需求強勁。而東南亞市場城市化進程加快以及人們對騎自行車的健康和環境益處的認識不斷提高等因素的推動，東南亞自行車市場正在快速增長。近年來公司產品朝高值化發展，持續在自動化設備投資與製程改善研發，已開發多款完整的自動化及智慧化設備，將聚焦於高附加價值的設備發展，以及多元市場策略。

顯示器製造商和 OEM 供應鏈正在重塑其全球製造策略，越來越多的 LCD 和 OLED 後端模組在東南亞生產，而東協和南美國家在液晶電視組裝領域的重要性日益凸顯，同時中國正採取新措施刺激國內顯示器需求，根據 GII 分析報告指出全球顯示設備市場規模 2024 年至 2031 年的複合年增長率為 5.3%。在顯示器新的多元應用商機發展下，本公司顯示器設備預期具高性價比及系統開發整合能力之優勢。

半導體市場根據 SEMI 研究報告指出 2025 年預估將成長 7% 至 1,210 億美元、2026 年大增 15% 至 1,390 億美元，半導體製造投資估計將有連續三年的增長，這顯示出半導體業在支撐全球經濟與尖端科技創新方面扮演的重要角色。自 2024 年半導體設備展望更為光明，主要是與 AI 相關的投資超乎預期，直到 2026 年，台灣、中國大陸與南韓，仍是全球前三大半導體設備支出市場。除了看好現有的半導體產業應用設備銷售之外，更看好未來半導體先進封裝設備及檢、量、測設備需求，預期今年公司半導體設備業績將持續提升成長。

(三)重要產銷政策：

1.研發設計與生產策略：

- 結合產官學研資源，開創具有市場競爭力的利基型智慧機械設備及低碳化應用設備，擴大利基市場之研發投資。

- 積極結合產業界的關鍵技術合作能量，發展關鍵性策略合作夥伴，緊密聯手加速取得客戶認同與應用。

- 強化客製化設計能力與提升控制系統及軟體服務能量，積極精進兩岸營運資源，提升營運競爭能力與獲利能力。

- 強化零組件供應鏈體系、導入低碳採購機制、優化生產排程及設計改善，以確保接單合理利潤並提升存貨週轉率。

- 持續加速各項設備認證規劃，強化資訊安全措施，與永續製造循環，增加質量與機會。

2.行銷策略：

- 掌握產業演化契機，拓展跨領域、跨產業之應用，持續發展半導體、顯示器、自行車、航太相關產業之智慧化關鍵設備，創造更多元發展契機，以及更高附加價值。

- 積極擴展半導體關鍵客戶合作開發先進製程設備機會，取得客戶的驗證，成為國際大廠之關鍵性策略夥伴。

- 全面拓展與國際代理商合作關係，積極參與海外展覽及行銷曝光，增加海外市場商機。

- 透過各相關工、協會平台，爭取各產官學研之合作機會，掌握產業發展契機，共同創造優勢競爭力。

三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

2025 年仍將在全球化調整期中進行動盪性地成長的年份，在氣候變遷的衝擊下，綠色產業已然為國際趨勢與共識將繼續發展，台灣在 AI 與半導體的加持與內需活絡下，內穩與外溫的經濟將持續下去，終端需求維持復甦趨勢，加上 AI、高效能運算等新興科技應用持續推展，逐漸擴散多種產業應用價值，產業智慧機械設備的需求將持續增長演進。

因應數位與淨零雙轉型的全球趨勢契機，旭東機械將積極整合公司內部與外部夥伴的研發能量，扮演產業鏈轉型應用的關鍵角色。全體經營團隊仍以積極而審慎的態度，持續進行前瞻投資，以蓄積企業綠色永續的成長動能。

在未來，我們將堅持創新，持續轉型，強化內部治理，落實企業誠信經營，為股東和客戶創造更大的價值。最後，我再次感謝各位股東的支持和信任。我們將以穩健的態度，追求卓越、效率、敏捷和以客為尊的經營理念，為股東和客戶創造更大的多元價值。

衷心感謝各位股東的支持，敬祝身體健康、萬事如意！



董事長：莊 添 財



總經理：黃 榮 杉



主辦會計：呂 海 淋

貳、 公司治理報告

一、 董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事

1. 姓名、性別、年齡、國籍或註冊地、主要經(學)歷、目前兼任本公司及其他公司之職務、選(就)任日期、任期、初次選任日期及本人、配偶、未成年子女與利用他人名義持有股份：

114年4月15日；單位：千股、%

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就) 任日期	任期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未 成年子 女現在 持有股 份		利用他人 名義持 有股 份		主要經(學)歷	目前兼任本公司 及其他公司之職 務	具配偶或 二親等以 內關係之 其他主 管、董事或 監察人			備註	
						股數	持 股比 率	股數	持 股比 率	股數	持 股比 率	股數	持 股比 率			股數	持 股比 率	職 稱		姓 名
董事長	中華民國	莊添財	男 71-80	113. 6.21	3 年	72. 5.17	16,370	20.76	16,370	20.76	1,508	1.91	10,042	12.74	學歷： 逢甲大學EMBA高階管理組碩士 北京清華大學-卓越經營謀略與管理高級研習班 經歷： 本公司董事長 旭冠投資(股)公司董事長 旭東機械(昆山)有限公司董事長暨總經理 昆山鉅東光電設備有限公司董事長暨總經理 耀東機械(天津)有限公司總經理 TAIROA 台灣智慧自動化與機器人協會理事 台灣電子製造設備工業同業公會理事 台灣航太工業同業公會理事 SME 國際製造工程學會 理事 中華民國分會 理事長 TEEIA 台灣電子設備協會 理事 AOIEA 自動光學檢測設備聯盟 監事	本公司董事長 旭冠投資(股)公司董事長 旭東機械(昆山)有限公司董事長暨總經理 昆山鉅東光電設備有限公司董事長暨總經理 耀東機械(天津)有限公司總經理 TAIROA 台灣智慧自動化與機器人協會理事 台灣電子製造設備工業同業公會理事 台灣航太工業同業公會理事	董事	莊弘銘	父子	無
董事	中華民國	莊瑋欣	男 31-40	113. 6.21	3 年	110.7. 16	2,195	2.78	2,164	2.75	776	0.98	-	-	學歷： 興國管理學院學士 經歷： 旭東機械工業股份有限公司 航太處長 旭東機械工業股份有限公司 董事暨專設事業處副總經理 旭翔投資股份有限公司 監察人	旭東機械工業股份有限公司 專設事業處副總經理 旭翔投資(股)公司 監察人	總經理	莊朝輝	父子	無
董事	中華民國	莊弘銘	男 41-50	113. 6.21	3 年	110.7. 16	1,427	1.81	1,427	1.81	-	-	-	-	學歷： 成功大學/電機資訊學院/微電子工程研究所博士 經歷： 旭東機械(昆山)有限公司 監事暨副總經理 昆山鉅東光電設備有限公司 監事 旭冠投資(股)公司 監察人	旭東機械(昆山)有限公司 監事暨副總經理 昆山鉅東光電設備有限公司 監事 旭冠投資(股)公司 監察人	董事長	莊添財	父子	無

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	盧勇宏	男 51-60	113.6.21	3年	107.6.28	-	-	-	-	-	-	-	-	學歷： 國立交通大學應用化學所博士 經歷： 友達光電副總經理	華威國際科技顧問股份有限公司營運執行董事 洄音股份有限公司執行董事	-	-	-	無
董事	中華民國	李芳裕	男 71-80	113.6.21	3年	109.6.29	131	0.17	131	0.17	-	-	-	-	學歷： 中國醫藥大學藥物化學研究所博士(藥師) 經歷： 1.永信藥品工業(股)公司、永鴻國際生技(股)公司、CHEMIX INC.、財團法人永信李天德醫藥基金會、財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會、永信育樂事業有限公司等董事長。 2.永信國際投資控股(股)公司、永甲興業(股)公司、YSP INTERNATIONAL CO., LTD.、永信天德(上海)藥品貿易有限公司、香港永信有限公司、CARLSBAD TECHNOLOGY, INC.、永日化學工業(股)公司等董事。 3.財團法人杏園基金會常務董事。 4.臺中市私立新民高級中學董事。	1.永信藥品工業(股)公司、永鴻國際生技(股)公司、CHEMIX INC.、財團法人永信李天德醫藥基金會、財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會、永信育樂事業有限公司等董事長。 2.永信國際投資控股(股)公司、永甲興業(股)公司、YSP INTERNATIONAL CO., LTD.、永信天德(上海)藥品貿易有限公司、香港永信有限公司、CARLSBAD TECHNOLOGY, INC.、永日化學工業(股)公司等董事。 3.財團法人杏園基金會常務董事。 4.臺中市私立新民高級中學董事。	-	-	-	無

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就) 任日期	初次 選任 日期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未 成年子 女現在 持有股 份		利用他人 名義持 有股 份		主要經(學)歷	目前兼任本公司 及其他公司之職 務	具配偶或 二親等以 內關係之 其他主 管、董事或 監察人			備 註
						股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
董事	中華民國	童瑞龍	男 71-80	113. 6.21	3 年	109.6. 29	504	0.64	504	0.64	-	-	-	-	學歷： 1.國立陽明大學醫務管理研究所碩士 2.國立台灣大學卓越領導人訓練班第一期結業 3.國立台灣大學精鍊高階管理與實務研習班第一期結業 經歷： 1.曾任台灣醫院協會 常務理事 2.曾任中華民國區域醫院協會 常務理事 3.教育部部定講師 1.童綜合醫療社團法人 副董事長 2.財團法人臺中市私立家寶社會福利慈善事業基金會 董事長 3.鏡鈦科技股份有限公司 獨立董事 4.串合企業股份有限公司 董事長 5.京傑企業股份有限公司 董事 6.尚有利企業股份有限公司 董事 7.大洸醫院管理顧問股份有限公司 董事 8.衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會<重大採購組> 委員 9.衛生福利部中央健康保險署-全民健康保險醫療給付費用醫院總額研商議事會議代表暨全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分會議 委員 10.衛生福利部桃園醫院<採購審議小組> 審查委員 11.中央健康保險署中區業務組與醫院總額中區執行分會共同管理會議 委員 12.台灣私立醫療院所協會 常務理事 13.社團法人台灣醫務管理學會 常務理事 14.台灣醫院協會法規委員會&長期照護委員會 委員 15.財團法人臺中市港區文化藝術基金會第八屆 常務董事	-	-	-	無

114年4月15日；單位：千股、%

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選(就)任日期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
						股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
獨立董事	中華民國	易昌運	男 41-50	113.6.21	3年	107.6.28	-	-	-	-	-	-	-	學歷： 逢甲大學會計學系學士/ 逢甲大學經營管理研究所碩士 經歷： 安侯建業會計師事務所 審計組主任 東海大學會計學系講師 台中科技大學財政稅務系講師 橙的電子股份有限公司 監察人 吉茂精密股份有限公司 監察人 吉茂精密股份有限公司 董事 建智聯合會計師事務所 合夥會計師	建智聯合會計師事務所 彰化所所長 定緯建設開發有限公司 負責人 宇隆科技股份有限公司 獨立董事暨薪酬 委員暨審計委員 友威科技股份有限公司 獨立董事暨薪酬 委員暨審計委員 美律實業股份有限公司 獨立董事暨薪酬 委員暨審計委員	-	-	-	無
獨立董事	中華民國	胡淑賢	女 51-60	113.6.21	3年	109.6.29	-	-	-	-	-	-	-	學歷： 輔仁大學 法律系財經 法學組學士 銘傳大學 管科所碩士 銘傳大學 管理學博士 經歷： 共通科技(股)公司 副總 經理 寶一科技(股)公司董事 長特別助理 照康科技科技系統(股) 公司 監察人	寶一科技(股)公司 董 事暨副總經理 駐龍精密機械(股)公 司 獨立董事/薪酬委 員會(召集人)/審計委 員會(召集人)	-	-	-	無
獨立董事	中華民國	唐光義	男 61-70	113.6.21	3年	113.6.21	-	-	-	-	-	-	-	學歷： 東吳大學法學士、國立 中正大學法研碩士班、 高考金融法務人員及 格、經濟部乙等特考法 制人員及格。 經驗： 台灣台東地方法院院長 台灣高等法院台中分院 庭長 台灣台中地方法院襄閱 庭長兼發言人 台灣台中雲林地方法院 法官 司法院第一屆法官遴選 委員會委員法官代表 台灣高等法院台中分院 調解委員	光義律師事務所 主 持律師 台灣高等法院台中分 院調解委員	-	-	-	無

2. 法人股東之主要股東：無。

3. 法人股東之主要股東屬法人者其主要股東：無。

(二)董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名 條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
莊添財 董事長	<ul style="list-style-type: none"> • 畢業於逢甲大學 EMBA 高階管理組碩士、北京清華大學-卓越經營謀略與管理高級研習班 • 經驗: 本公司董事長、旭冠投資(股)公司董事長、旭東機械(昆山)有限公司董事長暨總經理、昆山鉅東光電設備有限公司董事暨總經理、耀東機械(天津)有限公司總經理、SME 國際製造工程學會中華民國分會 理事長、TEEIA 台灣電子設備協會 理事、AOIEA 自動光學檢測設備聯盟 監事。 • 具有商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗及專業知識與技能。 • 未有公司法第 30 條各款情事。 	<ul style="list-style-type: none"> • 於選任前二年及任職期間擔任本公司董事長，係公司所有重大事項皆報請董事會決議後再執行，並不影響其獨立性。 • 本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 27,919,796 股，占 35.41% 並為持股前十名之自然人股東。 	無。
莊璋欣 董事	<ul style="list-style-type: none"> • 畢業於興國管理學院學士 • 具有商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗及專業知識與技能。 • 未有公司法第 30 條各款情事。 	<ul style="list-style-type: none"> • 於選任前二年及任職期間擔任專設事業處副總經理、旭翔投資(股)公司 監察人。 	無。
莊弘銘 董事	<ul style="list-style-type: none"> • 畢業於成功大學/電機資訊學院/微電子工程研究所博士 • 具有商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗及專業知識與技能。 • 未有公司法第 30 條各款情事。 	<ul style="list-style-type: none"> • 於選任前二年及任職期間擔任旭東機械(昆山)有限公司 監事暨副總經理、昆山鉅東光電設備有限公司 監事、旭冠投資(股)公司 監察人。 	無。
盧勇宏 董事	<ul style="list-style-type: none"> • 畢業於國立交通大學應用化學所博士 • 主要經驗: 友達光電副總經理 • 具有商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗及專業知識與技能。 • 未有公司法第 30 條各款情事。 	<ul style="list-style-type: none"> • 於選任前二年及任職期間擔任華威國際科技顧問股份有限公司營運執行董事、洄音股份有限公司 執行董事。 	無。

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
李芳裕 董事	<ul style="list-style-type: none"> • 畢業於中國醫藥大學藥物化學研究所博士(藥師) • 主要經驗: 永信藥品工業(股)公司、永鴻國際生技(股)公司、CHEMIX INC.、財團法人永信李天德醫藥基金會、財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會、永信育樂事業有限公司等董事長。 • 具有商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗及專業知識與技能。 • 未有公司法第 30 條各款情事。 	<ul style="list-style-type: none"> • 於選任前二年及任職期間擔任 1.永信藥品工業(股)公司、永鴻國際生技(股)公司、CHEMIX INC.、財團法人永信李天德醫藥基金會、財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會、永信育樂事業有限公司等董事長。 2.永信國際投資控股(股)公司、永甲興業(股)公司、YSP INTERNATIONAL CO., LTD.、永信天德(上海)藥品貿易有限公司、香港永信有限公司、CARLSBAD TECHNOLOGY, INC.、永日化學工業(股)公司等董事。 3.財團法人杏園基金會常務董事。(詳如董事目前兼任本公司及其他公司之職務) 	無。
童瑞龍 董事	<ul style="list-style-type: none"> • 畢業於國立陽明大學醫務管理研究所碩士 • 主要經驗: 童綜合醫療社團法人副董事長 台灣醫院協會常務理事、財團法人童傳盛文教基金會副董事長 財團法人臺中市私立家寶社會福利慈善事業基金會 董事長 • 具有商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗及專業知識與技能。 • 未有公司法第 30 條各款情事。 	<ul style="list-style-type: none"> • 於選任前二年及任職期間擔任童綜合醫療社團法人副董事長、財團法人臺中市私立家寶社會福利慈善事業基金會 董事長、鏡鈦科技股份有限公司<審計委員會委員> 獨立董事等(詳如董事目前兼任本公司及其他公司之職務)。 	無。

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
易昌運 獨立董事 審計委員會委員(召集人) 薪資報酬委員會委員(召集人)	<ul style="list-style-type: none"> 畢業於逢甲大學會計學系學士/逢甲大學經營管理研究所碩士 主要經驗: 建智聯合會計師事務所合夥會計師、東海大學會計學系講師、台中科技大學財政稅務系講師 現職: 建智聯合會計師事務所彰化所所長、定緯建設開發有限公司 負責人、宇隆科技股份有限公司 獨立董事暨薪酬委員暨審計委員、友威科技股份有限公司 獨立董事暨薪酬委員暨審計委員、美律實業股份有限公司 獨立董事暨薪酬委員暨審計委員 具有商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗及專業知識與技能;具會計師資格及執業執照。 未有公司法第 30 條各款情事。 	<ul style="list-style-type: none"> 於選任前二年及任職期間未擔任公司或其關係企業之受僱人、董事、監察人。 本人之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬均無任職於本公司或其關係企業之受僱人、董事、監察人、經理人。 本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份數 0 股。 無擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 無最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係及未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。 	兼任 3 家。 宇隆科技股份有限公司 獨立董事暨薪酬委員暨審計委員、友威科技股份有限公司 獨立董事暨薪酬委員暨審計委員、美律實業股份有限公司 獨立董事暨薪酬委員暨審計委員
胡淑賢 獨立董事 審計委員會委員 薪資報酬委員會委員 永續發展委員會委員	<ul style="list-style-type: none"> 畢業於輔仁大學法律系財經法學組學士 銘傳大學 管科所碩士 銘傳大學 管理學博士 主要經驗: 共通科技(股)公司 副總經理 寶一科技(股)公司 董事長特別助理 煦康科技科技系統(股)公司 監察人 現職: 寶一科技(股)公司 董事暨副總經理 駐龍精密機械(股)公司 獨立董事/薪酬委員會(召集人)/審計委員會(召集人) 具有商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗及專業知識與技能。 未有公司法第 30 條各款情事。 	<ul style="list-style-type: none"> 於選任前二年及任職期間未擔任公司或其關係企業之受僱人、董事、監察人。 本人之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬均無任職於本公司或其關係企業之受僱人、董事、監察人、經理人。 本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份數 0 股。 無擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 無最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係及未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。 	兼任 1 家。 駐龍精密機械(股)公司 獨立董事/薪酬委員會(召集人)/審計委員會(召集人)

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
唐光義 獨立董事 審計委員會委員 薪資報酬委員會委員	<ul style="list-style-type: none"> 畢業於東吳大學法學士、國立中正大學法研碩士班、高考金融法務人員及格、經濟部乙等特考法制人員及格。 主要經驗： 台灣台東地方法院院長 台灣高等法院台中分院庭長 台灣台中地方法院襄閱庭長兼發言人 台灣台中雲林地方法院法官 司法院第一屆法官遴選委員會委員法官代表 台灣高等法院台中分院調解委員 具有法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。 	<ul style="list-style-type: none"> 於選任前二年及任職期間未擔任公司或其關係企業之受僱人、董事、監察人。 本人之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬均無任職於本公司或其關係企業之受僱人、董事、監察人、經理人。 本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份數 0 股。 無擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 無最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係及未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。 	無。

二、董事會多元化及獨立性：

(一) 董事會多元化

本公司董事會 9 名董事成員（含 3 名獨立董事），本公司期許董事成員組成具有產業專長、營運專長，甚至是性別多元性之目標。目前成員具有產業經營經驗者為莊添財董事長、莊瑋欣董事、莊弘銘董事及盧勇宏董事、李芳裕董事、童瑞龍董事；獨立董事中易昌運獨立董事具備會計師執照並有實際執業及稅務申報等經歷；胡淑賢獨立董事具有商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗及專業知識與技能，且為本公司董事成員唯一女性，而唐光義獨立董事具備高考金融法務人員及格、經濟部乙等特考法制人員及格及地方法院院長、庭長等經歷。

本公司依照金管會推動為期八年的「上市櫃公司永續發展行動方案」其中針對「董事性別多元化」三大階段進行，第一及第二階段已達成，第三階段說明：本公司董事會女性董事未達動事席次三分之一，未來將視營運狀況或法令規定，預計於 116 年度第十三屆董事屆滿全面改選達成董事會任一性別董事席次達三分之一之情形。綜上本公司董事會多元性目標已初步達成。

(二) 董事會獨立性

本公司董事會 9 名董事成員，其中獨立董事 3 名，占董事成員比率為 33.33%，獨立董事已符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循辦法」獨立性資格要求。本公司董事會成員皆未有公司法第 30 條之情事，董事長莊添財、莊弘銘董事係為二親等之關係，參酌「公司治理問答集—強化董事會、監察人之獨立性篇」第 9 題之釋例，並無違反證券交易法第 26 條之 3 第 3 項規定。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管

114年4月15日；單位：千股、%

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
總經理	中華民國	黃榮杉	男	112.05.05	-	-	-	-	-	-	臺灣科技大學 工業管理研究所碩士/優你康光學股份有限公司 副總經理/聯相光電股份有限公司 副總經理	無	-	-	-
專設事業處總經理	中華民國	莊朝輝	男	72.05.17	11,291	14.32	1,415	1.79	9,971	12.65	大甲高中畢業	旭翔投資(股)公司董事長 旭東機械(昆山)有限公司董事 國睦工業(股)公司監察人	董事長	莊添財	兄弟
電設事業處副總經理	中華民國	莊凱評 (註1)	男	110.11.16	-	-	-	-	-	-	交通大學 光電工程研究所 博士 工業技術研究院/量測技術發展中心/儀器與感測技術發展組/組長	無	-	-	-
電設事業處副總經理	中華民國	范一龍	男	113.01.02	-	-	-	-	-	-	成功大學 機械工程研究所 碩士 友達光電股份有限公司 海外建廠 資深經理/ 陽程科技股份有限公司 業務部 副總經理/寶虹科技股份有限公司 研發部 副處長	無	-	-	-
專設事業處副總經理	中華民國	莊瑋欣	男	111.08.05	2,164	2.75	776	0.98			興國管理學院學士	旭翔投資(股)公司 監察人	總經理	莊朝輝	父子
專設事業處總經理室副總經理	中華民國	鄭奇周	男	113.03.29	177	0.22	-	-	4,701	5.96	中華大學經營管理研究所 台灣櫻花營業部專員 豐興鋼鐵儀控工程師	貝里斯商 ASIA GREAT INTERNATIONAL CO., LTD. 董事長	-	-	-
財務部經理 發言人 公司治理主管	中華民國	呂海淋	男	109.04.01	-	-	-	-	-	-	逢甲大學會計系/安侯建業聯合會計師事務所 審計經理/正瀚生技股份有限公司董事長特助	無	-	-	-
專設事業處總經理室協理	中華民國	莊君怡 (註2)	女	113.08.09	656	0.83	-	-	-	-	東海大學國際貿易系學士	無	董事長	莊添財	父女

註1:本公司電設事業處副總經理莊凱評因個人職涯規劃於113/10/31離職。

註2:本公司專設事業處總經理室莊君怡協理,原擔任電設總經理室特助於113/8/9董事會決議通過晉升案。

(三) 最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

(一) 一般董事及獨立董事之酬金

113年12月31日；單位：新台幣千元、%

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)				薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G) (註2)						
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	
董事長	莊添財	240	240	-	-	240	240			480 1.20%	480 1.20%	2,467	3,108	-	-	-	-	-	-	2,947 7.36%	3,588 8.96%	-
董事	盧勇宏	240	240	-	-	240	240	50	50	530 1.32%	530 1.32%	-	-	-	-	-	-	-	-	530 1.32%	530 1.32%	-
董事	李芳裕	240	240	-	-	240	240	50	50	530 1.32%	530 1.32%	-	-	-	-	-	-	-	-	530 1.32%	530 1.32%	-
董事	童瑞龍	240	240	-	-	240	240	50	50	530 1.32%	530 1.32%	-	-	-	-	-	-	-	-	530 1.32%	530 1.32%	-
董事	莊瑋欣	240	240	-	-	240	240			480 1.20%	480 1.20%	1,982	1,982	102	102	-	-	-	-	2,564 6.40%	2,564 6.40%	-
董事	莊弘銘	240	240	-	-	240	240			480 1.20%	480 1.20%	1,313	2,343	55	55	-	-	-	-	1,848 4.61%	2,878 7.18%	-
獨立董事	易昌運	480	480	-	-	-	-	50	50	530 1.32%	530 1.32%	-	-	-	-	-	-	-	-	530 1.32%	530 1.32%	-
獨立董事	胡淑賢	480	480	-	-	-	-	60	60	540 1.35%	540 1.35%	-	-	-	-	-	-	-	-	540 1.35%	540 1.35%	-
獨立董事	唐光義	253	253	-	-	-	-	30	30	283 0.71%	283 0.71%	-	-	-	-	-	-	-	-	283 0.71%	283 0.71%	-
獨立董事	陳滿賢	227	227	-	-	-	-	20	20	247 0.62%	247 0.62%	-	-	-	-	-	-	-	-	247 0.62%	247 0.62%	-

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性；本公司獨立董事酬金給付政策係授權薪資報酬委員會建議後送董事會依其對公司營運參與程度及貢獻議定之。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

註1:陳滿賢獨立董事於113/6/21股東會期滿自然解任，唐光義獨立董事於113/6/21股東會新上任。

註2:114/3/20董事會決議通過發放員工酬勞4,010,732元，截至年報刊印日止尚未發放，依法按最近一期實際分派金額比例計算並考量事業處獲利狀況估算經理人員員工酬勞數額。

(二) 監察人之酬金：本公司於109/6/29成立審計委員會廢除監察人制度,監察人於109/6/29自然解任

(三) 總經理及副總經理之酬金

113年12月31日；單位：新台幣千元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B) (註1)		獎金及特支費等等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	黃榮杉	1,800	1,800	108	108	120	120	50	-	50	-	2,078 5.19%	2,078 5.19%	-
專設事業處總經理	莊朝輝	1,440	1,440	92	92	160	160	-	-	-	-	1,692 4.22%	1,692 4.22%	-
電設事業處副總經理	莊凱評 (註2)	1,500	1,500	158	158	1,200	1,200	-	-	-	-	2,858 7.13%	2,858 7.13%	-
電設事業處副總經理	范一龍 (註3)	1,440	1,440	86	86	16	16	40	-	40	-	1,582 3.95%	1,582 3.95%	-
專設事業處副總經理	莊瑋欣	1,920	1,920	102	102	120	120	-	-	-	-	2,142 5.35%	2,142 5.35%	-
專設事業處總經理室副總經理	鄭奇周 (註4)	1,356	1,356	82	82	110	110	-	-	-	-	1,548 3.86%	1,548 3.86%	-

註1：依法提繳之退休金計628千元。

註2：莊凱評副總經理因個人職涯規劃於113/10/31離職。

註3：范一龍副總經理於113/1/2到職,113/3/29董事會決議通過聘任

註4：鄭奇周副總經理原為專設事業處協理於113/3/29董事會決議通過升任為專設事業處總經理室副總經理

註5：114/3/20董事會決議通過發放員工酬勞4,010,732元，截至年報刊印日止尚未發放，依法按最近一期實際分派金額比例計算並考量事業處獲利狀況估算經理人員工酬勞數額。

(四) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

113年12月31日；單位：新台幣千元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	總經理	黃榮杉	-	50	50	0.12%
	總經理	莊朝輝	-	-	-	-
	副總經理	莊凱評	-	-	-	-
	副總經理	范一龍	-	40	40	0.1%
	副總經理	莊瑋欣	-	-	-	-
	副總經理	鄭奇周	-	-	-	-
	協理	莊君怡	-	-	-	-
	財務主管、會計主管 公司治理主管	呂海淋	-	30	30	0.07%

註 1：114/3/20 董事會決議通過發放員工酬勞 4,010,732 元，截至年報刊印日止尚未發放，依法按最近一期實際分派金額比例計算並考量事業處獲利狀況估算經理人員工酬勞數額。

(五) 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性。

1. 本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析

單位：新台幣千元

項目	112 年度		總額占稅後純益之比例(%)		113 年度		總額占稅後純益之比例(%)	
	酬金總額				酬金總額			
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
董事	9,162	11,215	-6.82%	-8.35%	10,549	12,220	26.33%	30.50%
監察人	-	-	-	-	-	-	-	-
總經理、副總經理	11,155	11,155	-8.31%	-8.31%	11,900	11,900	29.70%	29.70%

註 1. 上述酬金包含車馬費、報酬、盈餘分配之酬勞，紅利及其他報酬；本公司 113/3/29 董事會決議不發放員工酬勞；114/3/20 董事會決議通過發放員工酬勞 4,010,732 元，截至年報刊印日止尚未發放，依法按最近一期實際分派金額比例計算並考量事業處獲利狀況估算經理人員工酬勞數額。

2. 給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序與經營績效及未來風險之關聯性：

- (1) 本公司章程第廿二條規定執行公司董事及監察人報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並依國內外業界水準支給。本公司董事如擔任公司職務者，除依本公司章程第二十五條規定分派董監酬勞外，得依一般經理人薪資水準按月支領薪俸。
- (2) 本公司如公司年度決算有獲利時，另依公司章程第二十五條規定分派酬勞，董監事酬勞不得高於百分之四。
- (3) 本公司支付總經理及副總經理酬金之酬金包含薪資、獎金及員工酬勞等，係依據其所擔任職位及所承擔之責任，並參考同業水準及對公司營運目標達成之貢獻度為依據訂定。
- (4) 本公司給付經理人酬金之政策、標準係依該職位之權責及對公司營運目標達成之貢獻度為依據訂定，給付之組合包含月薪、獎金及年終獎金，訂定酬金之程序由董事長核決並經薪酬委員會決議，個人獎金與公司整體之經營績效有關，並參照個人對公司經營績效達成之貢獻度而決定金額。

3. 本公司於 109/6/29 成立審計委員會廢除監察人制度。

三、 公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形

最近年度(113.01.01~113.12.31)董事會開會 5 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出 (列)席 次數 B	委託出 席次數	實際出(列) 席率(%) 【 B/A 】	備註
董事長	莊添財	4	1	80	—
董事	莊瑋欣	5	-	100	—
董事	莊弘銘	5	-	100	—
董事	盧勇宏	5	-	100	—
董事	李芳裕	5	-	100	—
董事	童瑞龍	5	-	100	—
獨立董事	易昌運	5	-	100	—
獨立董事	胡淑賢	5	-	100	—
獨立董事	陳滿賢	2	-	100	113/6/21 期滿解任
獨立董事	唐光義	3	-	100	113/6/21 新上任

其他應記載事項：

一、 董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項。

1. 董事會日期、期別、議案內容：請參閱年報 113 年度及年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議。
2. 所有獨立董事意見：無獨立董事反對保留意見之情形。
3. 公司對獨立董事反對意見之處理：無此情形。

(二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。

二、 董事對利害關係議案迴避之執行情形

董事姓名	會議日期	議案內容	利益迴避原因	參與表決情形
1. 莊添財 莊瑋欣 莊弘銘 李芳裕 童瑞龍 盧勇宏 易昌運 胡淑賢	113.05.02	1. 擬提名董事及獨立董事候選人名單案。	1. 本議案討論到董事(含獨立董事)本人(或二親等)時迴避。	依法進行利益迴避，未參與討論及表決。
2. 莊添財 莊瑋欣 莊弘銘 李芳裕 童瑞龍 盧勇宏 易昌運 胡淑賢		2. 解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。	2. 本議案討論到董事本人(或二親等)時迴避。	依法進行利益迴避，未參與討論及表決。

3. 莊添財 莊瑋欣 莊弘銘	113.05.02	3.本公司向關係人承租 土地租約租期展延案。	3.本議案討論到董事 本人(或二親等)時 迴避。	依法進行利益迴 避，未參與討論及 表決。
4. 莊添財 莊弘銘	113.08.09	4.擬建議本公司電設總 經理室莊君怡特助調 升專設總經理室協理 暨薪資核定案。	4.本議案討論到董事 本人(或二親等)時 迴避。	依法進行利益迴 避，未參與討論及 表決。
5. 莊添財 莊瑋欣 莊弘銘 胡淑賢		5.本公司成立「永續發展 委員會」及制定「永續 發展委員會組織規程」 案。	5.本議案討論到董事 本人(或二親等)時 迴避。	依法進行利益迴 避，未參與討論及 表決。
6. 莊添財 莊瑋欣 莊弘銘	113.12.20	6.本公司113年度高階主 管暨經理人年終獎金 分派案。	6.本議案討論到董事 本人(或二親等)時 迴避。	依法進行利益迴 避，未參與討論及 表決。

三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

1. 本公司113年度及截至年報刊印日止，董事會運作均依照「董事會議事規範」，並遵循此規範召開本公司之董事會，執行情形良好。
2. 本公司已於109年6月29日設置審計委員會，並同薪資報酬委員會協助董事會履行其監督職責。

四、董事會評鑑執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行 一次	113/1/1~113/12/31	董事會績 效評估	董事會內部 自評	一、董事會績效評估 1. 對公司營運之參與程度。 2. 董事會決策品質。 3. 董事會組成與結構。 4. 董事的選任及持續進修。 5. 內部控制。
		個別董事 成員績 效評估	董事會成員 自評	二、董事會成員自我績效評估 1. 公司目標與任務之掌握。 2. 董事職責認知。 3. 對公司營運之參與程度。 4. 內部關係經營與溝通。 5. 董事之專業及持續進修。 6. 內部控制。

董事會暨功能性委員會績效評估彙總報告
113年度

職稱	姓名	董事成員 自評	董事會績效評估	審計委員會績效考 核	薪酬委員會績效考 核
董事長	莊添財	A級	財務部評估結果為： 等級A級	財務部評估結果為： 等級A級	人資部評估結果為： 等級A級
董事	莊瑋欣	A級			
董事	莊弘銘	A級			
董事	童瑞龍	A級			

董事	李芳裕	A 級			
董事	盧勇宏	A 級			
獨立董事	易昌運	A 級			
獨立董事	唐光義	A 級			
獨立董事	胡淑賢	A 級			

說明:81-100 分為等級 A 級

※本公司依「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」辦理 113 年度董事會及功能性委員會評鑑執行情形報告已提 114 年 3 月 20 日董事會報告。

(二)審計委員會運作情形運作：

本公司於 109 年 6 月 29 日股東常會選任補增選任至 3 名獨立董事，並依證券交易法設置審計委員會代替監察人。

最近年度(113.01.01~113.12.31)審計委員會開會 4 次 (A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數 (B)	委託出席次數	實際列席率(%) (B/A)	備註
召集人	易昌運	4	0	100%	
委員	胡淑賢	4	0	100%	
委員	陳滿賢	2	0	100%	113/6/21 期滿解任
委員	唐光義	2	0	100%	113/6/21 新上任

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：詳下方附表一。

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：請詳五、公司治理運作情形之二董事對利害關係議案迴避之執行情形。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）。

(一)本公司內部稽核主管定期與審計委員溝通稽核報告結果，若有特殊狀況，亦會即時向審計委員報告，民國 113 年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與內部稽核主管溝通良好。

(二)本公司簽證會計師針對每半年度財務報表核閱或查核結果及其他相關事項，透過會前會充分溝通及交流；若有特殊狀況，亦會即時向審計委員報告，民國 113 年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好。

本公司審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的

品質與誠信度。

審計委員會之職權事項如下：

- 1.依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 2.內部控制制度有效性之考核。
- 3.依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 4.涉及董事自身利害關係之事項。
- 5.重大之資產或衍生性商品交易。
- 6.重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 7.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 8.簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 9.財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 10.年度財務報告、營業報告書以及盈餘分派或虧損撥補之議案。
- 11.其他公司或主管機關規定之重大事項。

附表一：

會議日期	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見處理
113年03月29日第二屆第十二次審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> 1.簽證會計師之委任暨會計師專業、獨立性評估審查案。 2.本公司112年度營業報告書及決算表冊案。 3.本公司112年度董事酬金報告案。 4.112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 5.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 6.修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。 7.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 8.本公司超過正常授信期限一定期間(超過3個月)之應收帳款是否屬資金融通評估案。 	經全體出席委員同意通過。	提報113年03月29日第十二屆第十二次董事會，經主席徵詢全體出席董事無異議後同意通過。
113年05月02日第二屆第十三次審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> 1.歐洲投資案，請公決案。 2.本公司向關係人承租土地租約租期展延案。 	經全體出席委員同意通過。	提報113年05月02日第十二屆第十三次董事會，經主席徵詢全體出席董事無異議後同意通過。
113年08月09日第三屆第一次審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> 1.擬選任本屆審計委員會召集人，請公決案。 2.承認113年第二季合併財務報告。 3.修訂本公司「核決權限實施規則」案。 4.修訂本公司「董事選任辦法」案 5.成立「永續發展委員會」及制定「永續發展委員會組織規程」案。 6.本公司超過正常授信期限一定期間(超過3個月)之應收帳款是否屬資金融通評估案。 	召集人經全體出席委員推舉由易昌運委員為本屆召集人，其餘經全體出席委員同意通過。	提報113年08月09日第十三屆第一次董事會，經主席徵詢全體出席董事無異議後同意通過。
113年12月20日第三屆第二次審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> 1.簽證會計師之委任暨會計師專業、獨立性評估審查案。 2.本公司114年預算案。 3.本公司114年稽核計畫案。 4.本公司修訂「銷貨及收款循環」案。 5.本公司修訂「預算管理辦法」案。 6.本公司超過正常授信期限一定期間(超過3個月)之應收帳款是否屬資金融通評估案。 	經全體出席委員同意通過。	提報113年12月20日第十三屆第二次董事會，經主席徵詢全體出席董事無異議後同意通過。

(二) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守 則差異情形及 原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」於110/8/6增訂「公司治理實務守則」111/8/5及112/3/30及113/12/20依法修訂，經審計委員會審議及董事會決議通過後實施，並揭露於公開資訊觀測站。	無。
二、公司股權結構及股東權益 (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ (二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？ (三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？ (四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V V V V		(一)本公司已設置發言人及代理發言人機制處理股東建議及糾紛等問題。 (二)本公司由專業股務代理機構負責，並設有專責人員處理相關事宜，可掌握實際控制公司之主要股東名單。 (三)本公司與關係企業間交易往來訂有「對子公司之監督與管理辦法」及「關係人交易管理辦法」，並由稽核人員定期執行。 (四)本公司訂定有防範內線交易管理辦法禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。	無。
三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？ (二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？ (三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？ (四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V V V V		(一)董事會成員組成考量多元化，董事中分別跨足商務、財務及科技產業之專長，備執行職務所必須之知識、技能及素養，經營管理及營運判斷經驗豐富，領導公司及股東獲取最大之股東權益。 (二)公司已設置薪資報酬委員會、審計委員會及永續發展委員會，未來將審慎評估設立其他功能性委員會。 (三)本公司依「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」辦理113年度董事會及功能性委員會評鑑執行情形報告已提114年3月20日董事會報告，並作為遴選或提名董事時之參考依據。 (四)本公司聘任之簽證會計師並非本公司之關係人，且對於會計師之聘任、解任及報酬，均須提董事會通過，113年12月20日董事會通過簽證會計師之委任暨會計師專業、獨立性評估審查案。會計師審計品質指標(AQI)資訊揭露請詳此表第十點所列。	無。
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	V		本公司已於111年12月23日董事會通過公司治理主管任命案，並由財務部兼職負責公司治理相關事務。	無。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商)溝通管道,及於公司網站設置利害關係人專區,並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?	V		<p>本公司除有發言人及代理發言人外,亦委託股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司」處理股東及本公司利害關係人之相關問題及建議事項,若涉及法律問題,則另向法律顧問諮詢並進行處理,以維護利害關係人權益,並於本公司網站建置投資人專區,供股東及利害關係人與本公司相關單位建立暢通的溝通管道,以妥適處理及回應利害關係人所關切之議題。</p> <p>1.股東方面:本公司定期召開股東會以外,並於公司網站設立投資人專區,由專責人員處理股東建議、疑義及糾紛等事件。</p> <p>2.員工方面:本公司鼓勵員工與管理階層進行意見交流,並設置員工意見信箱,收取員工反應意見,以使員工與公司有更多的雙向溝通管道。</p>	無。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?	V		本公司已委任專業股務代理機構-富邦綜合證券股份有限公司股務代理部處理股東會事務,使股東會在合法、有效、安全之前提下召開。	無。
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊? (二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)? (三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形?	V V V		<p>(一)本公司已架設網站,網址為: http://www.wisepioneer.com.tw及 http://www.shuztung.com,並連結至公開資訊觀測站,提供社會大眾查詢公司之財務業務及公司治理運作情形。</p> <p>(二)本公司目前依規定將應揭露資訊於「公開資訊觀測站」上揭露,並選派了解公司整體運作、財務、業務之發言人及代理發言人,統一對外發言,即時允當揭露。</p> <p>(三)本公司尚未於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,僅依法令規定於期限內申報。</p>	<p>無差異。</p> <p>無差異。</p> <p>若法令修改公告時間,本公司將依法辦理</p>
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)?	V		<p>1.員工權益:本公司一向以誠信對待員工,依勞基法保障員工合法權益。</p> <p>2.僱員關懷:本公司設立職工福利委員會,依法提撥職工福利金,並注重員工福利。</p> <p>3.投資者關係:本公司基於合作互助的理念,長期以來與各投資者維持良好的溝通管道及資訊的傳遞,以利公司未來的長期發展。</p> <p>4.供應商關係:本公司與供應商之間維繫著長期良好的合作關係。</p> <p>5.利害關係人之權利:本公司為保障利害關係人之權益,已建立好各種良好、暢通之溝通管道,秉持誠信原則及負責態度妥適處理,並善盡企業社會責任。</p> <p>6.董事進修之情形:本公司除了安排董事參與公司治理相關課程,此外亦隨時告知董事公司治理相關法令更新。本公司董事出席董事會狀況正常,且董事對董事會所列議案如涉有利害關係至損及公司利益之虞時,不得加入表決。</p>	無。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 治理實務守則 差異情形及原因
	是	否	
			7.風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：依法訂定各種內部規章，進行各種風險管理及評估。 8.客戶政策之執行情形：本公司與客戶維持穩定良好關係，以創造公司利潤。 9.公司已為董事及經理人購買責任保險。
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：本公司未列入受評公司，故不適用。			

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守 則差異情形及 原因
	是	否	摘要說明	

十、會計師審計品質指標(AQI)資訊揭露



安侯建業聯合會計師事務所
112年審計品質指標(AQI)資訊揭露-含事務所層級及個案層級

個案基本資料

公司名稱：旭東機械工業股份有限公司 股票類型：興櫃
主籤/副籤會計師姓名：陳燕慧執業會計師 / 陳政學執業會計師

構面一 指標1-1 查核經驗

事務所層級

項目	112年	同業平均
簽證會計師查核經驗	12.4 年	11.4年
案件品質管制複核(EQCR)會計師查核經驗	14.3 年	12.7年
理級以上查核人員(不含會計師)查核經驗	10.9 年	11.5年

說明事務所晉升職級與各職級年資區間:

晉升職級	112年
審計員	0.8 ~ 2.3年
高級審計員~主任	2 ~ 8.3年
副理~協理	3.9~35.3年
執業會計師	12.9~35.5年

個案層級

項目	112年
陳燕慧會計師查核經驗	2.0 年
陳政學會計師查核經驗	11.0 年
案件品質管制複核(EQCR)會計師查核經驗	25.5 年
查核團隊理級以上人員(不含會計師)查核經驗	7.3 年

簽證會計師(含主籤、副籤)、EQCR會計師學經歷(如過往簽證案件)及查核團隊規模介紹:

請詳查核團隊介紹及會計師 CVs

指標1-2 訓練時數

事務所層級

項目	112年	同業平均
簽證會計師訓練時數	114.6 小時	112.5小時
理級以上查核人員(不含會計師)訓練時數	105.5 小時	95.6 小時

指標1-3 流動率

事務所層級

項目	112年	111年	同業平均
理級以上查核人員(不含會計師)流動率	12.7%	17.0%	11.6%

指標1-4 專業支援

事務所層級

項目	112年	111年	同業平均
專業人員支援審計部門查核人數占比	6.9%	6.5%	5.9%
專業人員投入上市櫃公司案件時數占比	8.5%	9.2%	7.9%

註：專業人員包括電腦審計、財務評價人員或稅務專業人員等專家。

(三) 設置薪酬委員會其組成、職責及其運作情形：

1. 薪資報酬委員會成員資料

113 年 5 月 1 日

身分別 姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行 公司薪資報酬委員 會成員家數
獨立董事(召集人)	易昌運	參閱第 10~11 頁董事資料主要 學經歷一欄表	本人、配偶、二親等以內 親屬(或利用他人名義):未 擔任本公司或其關係企業 之董事、監察人或受僱 人、未持有本公司股份及 未擔任與本公司有特定關 係公司之董事、監察人或 受僱人;最近 2 年無提供 本公司或其關係企業商 務、法務、財務、會計等 服務所取得之報酬。	3 家
獨立董事	胡淑賢			1 家
獨立董事	唐光義			無

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2) 第五屆委員任期自110年7月16日至113年6月20日；第六屆委員任期自113年6月21日至116年6月20日。

(3) 113年共召開3次(A)薪資報酬委員會，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B)/(A)	備註
召集人	易昌運	3	-	100	—
委員	胡淑賢	3	-	100	—
委員	陳滿賢	1	-	100	113/6/21期滿解任
委員	唐光義	2	-	100	113/6/21新上任

其他應記載事項：

1.董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。

2.薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

3. 提名委員會成員資料及運作情形資訊:本公司未有提名委員會，故不適用。

二、 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？		V	本公司已於113/8/9董事會通過成立「永續發展委員會」並制定「永續發展委員會組織規程」，113/8/28召開永續發展委員會，訂定永續發展委員會組織架構及設置兼職單位，兼職人員及其職掌範圍。	
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？		V	本公司尚未訂定相關資訊。	未來將審慎評估訂定。
三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？ (二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？ (三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？ (四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？		V	(一)本公司從事機械設備的製造及買賣，尚未建立相關環境管理制度，未來將視實際需求建立合適之環境管理程序。 (二)本公司致力於執行辦公室廢棄物減量、資源分類回收等活動，以維護地球資源及保護環境衛生。 (三)對於氣候變遷及潛在風險，皆可能造成公司營運產生衝擊，本公司可藉由採取資源使用效率之提升，來降低營運成本作為因應措施。 (四)公司依營運活動之影響，制定公司節能減碳策略，推動各項節能措施，如隨手關燈及無紙化作業等，降低公司營運對自然環境之衝擊。	(一)未來將依公司發展需要及法令規定辦理。 (二)~(四)與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異。
四、社會議題 (一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？ (二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？ (三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？ (四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V	V	(一)本公司依各項勞動相關法規執行，辦理勞工之勞、健保，提撥勞工退休金，以確保勞工權益。並為全體員工投保團體意外險等商業保險。 (二)依本公司章程所載員工分紅之成數為本公司年度如有獲利，應提撥百分之三至百分之十五作為員工績效獎金及員工分紅制度。其休假及其他福利均依循勞基法為遵循基準。 (三)本公司提供給員工舒適、安全、健康的工作環境，例如實施必要之門禁措施，兩年一次定期的員工健康檢查，並依法成立職工福利委員會，每年不定期辦理員工旅遊等職工福利事項，以保障員工身心健康，另本公司於113年度無發生職業災害;本公司當年度無火災事件發生。 (四)本公司為使員工具備專業素養與發展優勢，不定期舉辦內部訓練課程及派外接受專業訓練。	(一)~(六)與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？</p> <p>(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？</p>	V		<p>(五) 本公司在經營業務上皆依相關規定作業。</p> <p>(六) 本公司對於供應商之選擇均經過審慎評估，考量其生產過程是否有符合相關法令規定，並訂有「採購安衛管理程序」，皆依相關規定作業。</p>	
<p>五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？</p>		V	<p>本公司尚未編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書。</p>	<p>未來將依公司發展需要及法令規定辦理。</p>
<p>六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司已訂定永續發展實務守則，惟公司仍遵守法令及章程之規定，並考量國內外企業社會責任之發展趨勢、公司本身及其集團企業整體營運活動，推動各項企業社會活動。</p>				
<p>七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：無。</p>				

三、 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p> <p>(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	V	V	<p>(一) 本公司目前已訂有誠信經營守則，所建置各項辦法與制度，業已涵蓋誠信原則，符合公司誠信經營守則運作。</p> <p>(二) 本公司由人資單位負責執行相關運作，隨時對內部員工宣導誠信行為之重要性。</p> <p>(三) 本公司「工作守則」中，對所屬員工相關行為準則皆有所規範，符合法令之規範。</p>	<p>尚無重大差異</p>
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？</p> <p>(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p> <p>(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當</p>	V	V	<p>(一) 本公司對往來之客戶及供應商均有評核機制，訂立合約時，對雙方的權利義務均詳訂其中並保密。</p> <p>(二) 本公司推動企業誠信經營相關宣導由人資單位及稽核單位負責。由各部門依其職務所及範疇盡力履行企業社會責任。</p> <p>(三) 本公司設有人資及稽核單位，可提</p>	<p>尚無重大差異</p>

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
陳述管道，並落實執行？ (四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ (五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		供檢舉人檢舉的陳述管道並對檢舉人身分及內容應保密。 (四) 本公司訂定有內部稽核計畫，內部稽核單位均依稽核計畫執行各項查核作業。 (五) 本公司於例行性的週會及月會向員工宣導誠信經營之重要性。	
三、公司檢舉制度之運作情形 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ (二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？ (三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		(一) 本公司已設立「員工意見及申訴信箱」建置申訴機制管道及舉報程序，設有專人負責處理。 (二) 本公司舉報程序設有保密機制，保密當事人資料之責任。 (三) 本公司舉報程序設有保密機制，禁止對於善意檢舉人進行報復。	尚無重大差異
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	V		本公司依相關法規揭露各項相關資訊於官網及公開資訊觀測站。	尚無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：無。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) 1. 本公司遵守公司法、證券交易法、上市上櫃公司誠信經營守則或其他商業行為有關法令，以落實誠信經營原則創造永續發展之經營環境。 2. 本公司「董事會議事規則」訂有董事利益迴避規定，董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，並不得代理其他董事行使其表決權。				

四、 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：無。

五、 內部控制制度執行狀況

1. 內部控制聲明書：請至公開資訊觀測站(<https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t06sg20>)查詢。
2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：不適用。

六、 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

1. 股東會重要決議及執行情形

開會日期	重要決議事項
113.06.21	<p>承認事項</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 追認本公司 111 年度盈餘分配修正案。 (2) 112 年度營業報告書及決算表冊案。 (3) 本公司 112 年度虧損撥補案。 <p>討論事項</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 <p>選舉事項</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 全面改選董事九席(含獨立董事三席)。 <p>其他議案</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。 <p>臨時動議</p> <p>無。</p> <p>執行情形</p> <p>本公司已依 113/6/21 股東會決議結果執行完畢。</p>

2. 董事會重要決議

開會日期	重要決議事項
113.03.29 第十二屆第十二次 董事會	<p>討論事項</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 簽證會計師之委任暨會計師專業、獨立性評估審查案。 (2) 本公司 111 年度盈餘分配修正案。 (3) 本公司 112 年度營業報告書及決算表冊案。 (4) 本公司 112 年度董事酬勞與員工酬勞分配情形案。 (5) 本公司 112 年度董事酬金報告案。 (6) 本公司 112 年度虧損撥補案。 (7) 112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 (8) 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 (9) 修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。 (10) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (11) 擬委任范一龍先生擔任本公司電設事業處工程處副總經理暨薪資核定案。 (12) 擬建議本公司專設總管理處鄭奇周協理晉升專設事業處總經理室副總經理暨薪資核定案。 (13) 全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。

開會日期	重要決議事項
	(14) 113 年股東常會受理股東提案權及董事(含獨立董事)候選人提名事宜案。 (15) 召開 113 年股東常會之時間、地點及案由案。 (16) 本公司超過正常授信期限一定期間(超過 3 個月)之應收帳款是否屬資金融通評估案。 (17) 本公司為業務週轉需求，擬向下列各金融機構洽訂融資額度案。
113.05.02 第十二屆第十三次 董事會	討論事項 (1) 擬提名董事及獨立董事候選人名單。 (2) 解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。 (3) 歐洲投資案。 (4) 本公司向關係人承租土地租約租期展延案。 (5) 本公司為業務週轉需求，擬向下列各金融機構洽訂融資額度案。
113.06.21 第十三屆第一次 臨時董事會	討論事項 (1) 為擬委任易昌運先生、胡淑賢女士及唐光義先生擔任第六屆薪資報酬委員會成員。 選舉事項 (2) 選任本公司董事長案。
113.08.09 第十三屆第一次 董事會	討論事項 (1) 承認 113 年第二季合併財務報告。 (2) 擬建議本公司電設總經理室莊君怡特助調升專設總經理室協理暨薪資核定案。 (3) 修訂本公司「核決權限實施規則」案。 (4) 修訂本公司「董事選任辦法」案。 (5) 本公司成立「永續發展委員會」及制定「永續發展委員會組織規程」案。 (6) 本公司超過正常授信期限一定期間(超過 3 個月)之應收帳款是否屬資金融通評估案。 (7) 本公司為業務週轉需求，擬向下列各金融機構洽訂融資額度案。
113.12.20 第十三屆第二次 董事會	討論事項 (1) 簽證會計師之委任暨會計師專業、獨立性評估審查案。 (2) 本公司 114 年營運計畫案。 (3) 本公司 114 年預算案。 (4) 本公司 114 年稽核計畫案。 (5) 本公司 113 年度高階主管暨經理人年終獎金分派案。 (6) 本公司修訂「銷貨及收款循環」案。 (7) 本公司修訂「公司治理實務守則」案。 (8) 本公司修訂「預算管理辦法」案。 (9) 本公司超過正常授信期限一定期間(超過 3 個月)之應收帳款是否屬資金融通評估案。 (10) 本公司為業務週轉需求，擬向下列各金融機構洽訂融資額度案。
114.03.20 第十三屆第三次 董事會	討論事項 (1) 本公司 113 年度營業報告書及決算表冊案。 (2) 本公司 113 年度董事酬勞與員工酬勞分派案。 (3) 本公司 113 年度給付董事酬金報告案。 (4) 本公司 113 年度盈餘分配案。 (5) 113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 (6) 本公司依主管機關之規範，定義基層員工之範圍案。 (7) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (8) 擬辦理初次上市掛牌前之現金增資提撥新股公開承銷案。

開會日期	重要決議事項
	(9) 114 年股東常會受理股東提案權事宜案。 (10) 召開 114 年股東常會之時間、地點及案由案。 (11) 本公司超過正常授信期限一定期間(超過 3 個月)之應收帳款是否屬資金融通評估案。 (12) 本公司為業務週轉需求，擬向下列各金融機構洽訂融資額度案。

七、最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

四、會計師公費資訊

金額單位：新臺幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
安侯建業聯合會計師事務所	陳燕慧	113.01.01	2,150	613	2,763	非審計公費:為稅簽及移轉訂價報告、查核車資及打字費等
	陳政學	~113.12.31				

註:

- (一) 給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容：無此情形。
- (二) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無。
- (三) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：113年度較112年度審計公費減1,010千元，減少達31.96%，因112年增加Q1季報核閱公費700千元及內控審查300千元而113年無，係公費減少之原因。

五、更換會計師資訊

配合安侯建業聯合會計師事務所內部職務調動，安侯建業聯合會計師事務所建議自民國112年度起財務報告查核簽證會計師由陳燕慧會計師及郭士華會計師改為陳燕慧會計師及陳政學會計師。

(一) 關於前任會計師

更換日期	112年5月5日董事會通過		
更換原因及說明	配合安侯建業聯合會計師事務所內部職務調動		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當 事 人	會 計 師	委 任 人
	情 況		
	主動終止委任	不適用	不適用
	不再接受(繼續)委任	不適用	不適用
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無		
與發行人有無不同意見	有	會計原則或實務	
		財務報告之揭露	
		查核範圍或步驟	
		其 他	
	無	V	
	說明		
其他揭露事項(本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無		

(二)關於繼任會計師

事 務 所 名 稱	安侯建業聯合會計師事務所
會 計 師 姓 名	陳燕慧、陳政學
委 任 之 日 期	113年12月20日董事會通過
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

(三) 前任會計師對本準則第 10 條第 6 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：無。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：
無。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形：

請至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw/>)查詢。

(一) 董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形：

請至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw/>)查詢。

(二) 股權移轉資訊：

請至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw/>)查詢。

(三) 董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權質押之相對人為關係人者：無。

八、 持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：

114年4月15日；單位：千股

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱 (或姓名)	關係	
莊添財	16,370	20.76	1,508	1.91	10,042	12.74	旭冠投資股份有限公司	其為該公司董事長	-
							洪勉	配偶	
							莊弘銘	二親等以內親屬	
							莊朝輝	二親等以內親屬	
莊朝輝	11,291	14.32	1,415	1.79	9,971	12.65	汪素珠	二親等以內親屬	-
							莊添財	二親等以內親屬	
							洪勉	二親等以內親屬	
							莊秀娟	二親等以內親屬	
							莊瑋欣	二親等以內親屬	
							旭冠投資股份有限公司	其為該公司董事長	
旭冠投資股份有限公司 代表人：莊添財	16,370	20.76	1,508	1.91	-	-	洪勉	配偶	-
							莊弘銘	二親等以內親屬	
							莊朝輝	二親等以內親屬	
							汪素珠	二親等以內親屬	
旭翔投資股份有限公司	9,971	12.65	-	-	-	-	莊朝輝	其為該公司董事長	-
旭翔投資股份有限公司 代表人：莊朝輝	11,291	14.32	1,415	1.79	-	-	汪素珠	配偶	-
							莊添財	二親等以內親屬	
							洪勉	二親等以內親屬	
							莊秀娟	二親等以內親屬	
							莊瑋欣	二親等以內親屬	
貝里斯商 ASIA GREAT INTERNATIONAL CO., LTD.	4,701	5.96	-	-	-	-	無	無	-
貝里斯商 ASIA GREAT INTERNATIONAL CO., LTD. 代表人：CHENG,CHI-C HOU(鄭奇周)	177	0.22	-	-	-	-	無	無	-
莊秀娟	2,180	2.76	-	-	-	-	莊朝輝	二親等以內親屬	-

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱	關係	
							(或姓名)		
莊瑋欣	2,164	2.75	-	-	-	-	汪素珠	二親等以內親屬	-
							莊瑋欣	二親等以內親屬	
							莊朝輝	二親等以內親屬	
							汪素珠	二親等以內親屬	
洪勉	1,508	1.91	16,370	20.76	-	-	旭翔投資股份有限公司	其為該公司監察人	-
							莊秀娟	二親等以內親屬	
							旭冠投資股份有限公司	其為該公司董事	
							莊添財	配偶	
							莊弘銘	二親等以內親屬	
莊弘銘	1,427	1.81	-	-	-	-	莊朝輝	二親等以內親屬	-
							汪素珠	二親等以內親屬	
							莊添財	二親等以內親屬	
							洪勉	二親等以內親屬	
							旭冠投資股份有限公司	其為該公司監察人	
							洪勉	二親等以內親屬	
汪素珠	1,415	1.79	11,291	14.32	-	-	莊秀娟	二親等以內親屬	-
							莊瑋欣	二親等以內親屬	
							莊朝輝	配偶	
							旭翔投資股份有限公司	其為該公司董事	
							莊添財	二親等以內親屬	

註1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

註2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。

註3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例：

(一) 綜合持股比例

113年12月31日；單位：千股、%

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
Bouncy Development Group Inc.	8,534	100%	-	-	8,534	100%
昆山鉅東光電設備有限公司	-	100%	-	-	-	100%
Asia Great International Co.,Ltd.	-	-	-	100%	-	100%
Shuz Tung Machinery Industrial Co.,Ltd.	-	-	-	100%	-	100%
旭東機械(昆山)有限公司	-	-	-	100%	-	100%
耀東機械(天津)有限公司	-	-	-	100%	-	100%
昆山威仕東人工智能科技有限公司	-	-	-	100%	-	100%
LDI Systems B.V. (註 1)	30	30%	-	-	30	30%

註1：業已全數提列減損損失。

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

1. 股本形成經過：

114年5月1日；單位：千股/新台幣千元

年 月	發 行 價 格	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股本來源	以現金以外財產抵充股款者	其他
72年5月	10	400	4,000	400	4,000	創立資本	-	
81年7月	10	1,600	16,000	1,600	16,000	現金增資	-	
89年8月	10	2,800	28,000	2,800	28,000	現金增資	-	
94年12月	10	8,000	80,000	8,000	80,000	現金增資	-	94年12月26日經授中字第09433414530號
97年2月	10	19,200	192,000	19,200	192,000	現金增資	-	97年02月21日經授中字第09731754040號
98年12月	10	50,000	500,000	20,448	204,480	盈餘轉增資	-	98年12月09日經授中字第09835058850號
98年12月	10	50,000	500,000	23,200	232,000	現金增資	-	98年12月09日經授中字第09835058850號
98年12月	14	50,000	500,000	33,200	332,000	現金增資	-	98年12月30日經授中字第0985262360號
99年7月	15	100,000	1,000,000	42,200	422,000	現金增資	-	99年07月30日經授中字第09932370400號
100年6月	10	100,000	1,000,000	54,860	548,600	盈餘轉增資	-	100年08月02日經授商字第10001173880號
100年8月	30	100,000	1,000,000	60,000	600,000	現金增資	-	100年08月16日經授商字第10001189480號
101年8月	10	100,000	1,000,000	72,000	720,000	盈餘轉增資	-	101年08月16日 中商字第1010018988號
108年9月	10	100,000	1,000,000	78,840	788,400	盈餘轉增資	-	108年09月09日 中商字第1080019333號

2. 已發行之股份種類：

114年5月1日；單位：股

股 份 種 類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股數 (註1)	未發行股份	合 計	
記名普通股	78,840,000	21,160,000	100,000,000	其中保留 6,000,000 股為員工認股權憑證之股份使用

註1：係為興櫃股票

3. 總括申報制度相關資訊：不適用。

(二) 主要股東名單：

114年4月15日；單位：股

主要股東名稱	股份 持有股數	持股比例
莊添財	16,370,059	20.76%
莊朝輝	11,290,842	14.32%
旭冠投資股份有限公司	10,042,166	12.74%
旭翔投資股份有限公司	9,970,741	12.65%
貝里斯商ASIA GREAT INTER	4,700,966	5.96%
莊秀娟	2,179,684	2.76%
莊璋欣	2,164,454	2.75%
洪勉	1,507,571	1.91%
莊弘銘	1,427,270	1.81%
汪素珠	1,414,977	1.79%

(三) 公司股利政策及執行狀況：

1. 公司章程所訂之股利政策：

本公司年度如有獲利，應提撥百分之三至百分之十五為員工酬勞；及不高於百分之四為董事、監察人酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件及方式由董事會特別決議並提股東會報告。

本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限；另視公司營運需要及法令規定提列特別或迴轉盈餘公積，如尚有盈餘併同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分派之。本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，考量將當年度可分配盈餘全數分派。盈餘之分派得以現金股利為優先，亦得以股票股利之方式分派，惟現金股利分派之比例以不低於股利總額之百分之五。

2. 本次股東會擬議股利分派情形：本公司114年3月20日董事會擬議分派現金股利，每股配發0.5元，惟尚待114年股東常會決議。

3. 預期股利政策將有重大變動時，應加以說明：本公司股利政策並無重大變動。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

(五) 員工、董事及監察人酬勞：

1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍

本公司年度如有獲利，應提撥百分之三至百分之十五為員工酬勞；及不高於百分之四為董事、監察人酬勞。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件及方式由董事會特別決議並提股東會報告。

2. 本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理

(1) 本公司本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎係依據公司章程所列成數規定，分別以3.93%及1.41%估列計算。

(2) 本公司以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎係按決議分派之金額除以股票公平價值決定，股票公平市價係指資產負債表日之每股淨值，並考量除權除息之影響為計算基礎。

(3) 實際分派金額若與估列數有差異時，依會計估計變動處理，於股東會決議年度調整入帳。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

(1) 以現金或股票分派之員工、董事及監察人酬勞金額：本公司114年3月20日經董事會擬議配發員工酬勞4,010,732元及董監酬勞1,440,000元，與認列費用年度估列金額並無差異，依法於股東常會報告，相關發放作業擬授權董事長全權處理，截至年報刊印日前尚未發放。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：不適用。

4. 前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：本公司113年3月29日董事會決議不發放員工酬勞及董事酬勞，實際執行情形與通過之決議並無差異。

(六) 公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形

無。

三、特別股辦理情形

無。

四、海外存託憑證辦理情形

無。

五、員工認股權憑證辦理情形

無。

六、限制員工權利新股辦理情形

無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形

無。

八、資金運用計畫執行情形

無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 本公司所營業務之主要內容

本公司主要從事顯示器、半導體、自行車與智慧醫療產業，以及自動化專用機械等高科技產業製程精密設備研發、製造及買賣等業務，包括：

- 1、F401021 電信管制射頻器材輸入業。
- 2、E701030 電信管制射頻器材裝設工程業。
- 3、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
- 4、CB01010 機械設備製造業。
- 5、I501010 產品設計業。
- 6、CB01990 其他機械製造業。
- 7、CC01080 電子零組件製造業。
- 8、CF01011 醫療器材製造業。
- 9、F108031 醫療器材批發業。
- 10、F208031 醫療器材零售業。
- 11、CD01030 汽車及其零件製造業。
- 12、CD01040 機車及其零件製造業。
- 13、CD01990 其他運輸工具及其零件製造業。
- 14、CE01990 其他光學及精密器械製造業。
- 15、F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
- 16、F118010 資訊軟體批發業。
- 17、F119010 電子材料批發業。
- 18、F213030 電腦及事務性機器設備零售業。
- 19、F218010 資訊軟體零售業。
- 20、F219010 電子材料零售業。
- 21、F401010 國際貿易業。
- 22、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

2. 營業比重

單位：新台幣千元

主要產品	113年度	
	銷售淨額	營業比重
電子專用設備及零件	1,349,076	74.00%
專用自行車設備及零件	305,880	16.78%
液壓管件	168,033	9.22%
銷貨收入淨額	1,822,989	100.00%

3. 公司目前之商品(服務)項目：

電子專用設備及零件	專用設備及零件	液壓管件
<p>顯示器產業設備</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Array ADI/AEI AOI 2.Color Filter Repair 3.Laser Repair 4.檢測、量測專用設備 5.LCM 整廠設備 6.R2R 關鍵設備 7.AMOLED 設備 8.ACF,FPC Bonder 9.OLB Bonder <p>半導體產業設備</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.專用設備開發 2.倉儲物流系統相關設備 3.檢測、量測專用設備 4.Dispenser 5.Test handler <p>其他電子業</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Dispenser 2.各式客製化設備 3.醫療器材之設計與生產 	<ol style="list-style-type: none"> 1.各式自行車零件整廠設備之研發、製造與生產 2.專用機之研發、製造與生產 3.各式管類加工設備之設計與生產 4.汽機車生產設備之設計與生產 5.噴塗設備研發、製造與生產 6.異形管雷射切割設備 7.航太專用設備 	<ol style="list-style-type: none"> 1.各式自行車零件管類加工之設備設計製造與代工生產 2.航太各式管類加工之設備設計製造與代工生產。 3.Laser 全自動切管設備 4.散熱循環管件

4. 公司計畫開發之新商品(服務)：

目標產品名稱	主要目標
晶圓光學顯微鏡自動檢測設備	<ol style="list-style-type: none"> 1.全自動晶圓檢測 2.自動缺陷分類 3.高精度全區域量測
晶圓表面微奈米量測設備	<ol style="list-style-type: none"> 1.大面積的晶圓厚度測量功能，微奈米等級的高度測量 2.微奈米級表面粗糙度量測功能 3.具區域抽樣量測與全面量測功能
先進封裝探針量測設備	<ol style="list-style-type: none"> 1.晶圓探針卡品質檢測 2.高精度2D/3D尺寸形貌量測功能 2.多樣性針型檢量測
基板熱翹取量測設備	<ol style="list-style-type: none"> 1.針對基板的溫度變形量 2.符合客戶要求的升溫及降溫曲線 3.量測熱影響變形量
雷射光罩缺陷檢查設備	<ol style="list-style-type: none"> 1.針對光罩的表面缺陷檢測 2.表面缺陷等級自動分類 3.全自動化傳送系統

晶圓載具倉儲自動化物流系統	1.AGV/AMR & Stoker串連 2.整合上下游，全自動晶圓載具包裝及拆包 3.智慧化自主導航，高效自動運輸
晶圓載具包裝系統	1.低碳節能設備設計 2.晶圓盒包裝系統 3.包裝品質自動光學檢測
次世代顯示器檢量測設備	1.高精度2D量測功能 2.多樣化檢測形狀與區域檢查 3.全面檢測與量測功能
邊緣運算檢測系統	1.邊緣雲端架構 2. AI辨識軟體 3.影像辨識管理平台
自行車產業智慧機器人解決方案	1.CPS智慧機器人虛實整合技術 2.自動化研拋路徑的規劃 3.管件拋光研磨智慧機器人系統
散熱循環管件設備	1.高階散熱專用管材的製程加工。 2.智慧化彎管及路徑的規劃 3.共通精密治具的設計

(二) 產業概況

1. 產業之現況與發展：

(1) 全球產業概況

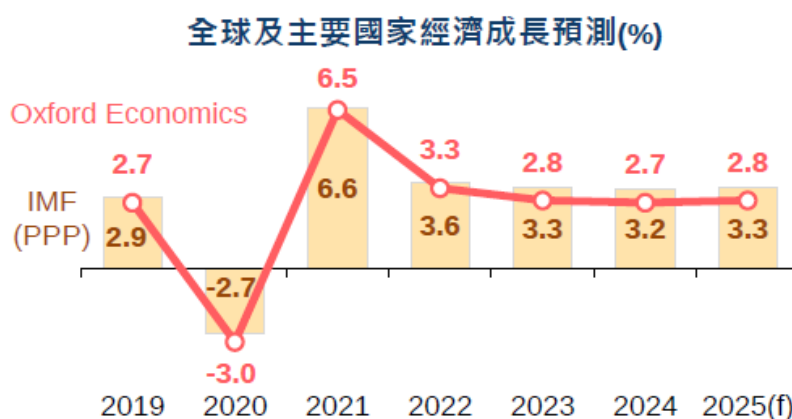
當前無論是大國之間的角力、疫情災害、地緣政治紛擾，一再打亂原有的國際分工模式，2018年美中貿易戰至今仍持續擴大、2019年新冠疫情爆發重挫各國經濟以及所引發的供應鏈韌性問題、烏俄戰爭、以哈衝突，這些國際政經情勢的變化仍將持續影響全球經濟。未來全球經濟將持續在重新調整的陣痛期中。2024年雖然全球通貨膨脹的壓力逐漸趨緩，同時超乎預期的美國韌性經濟表現穩定全球市場與企業的信心，但川普回歸帶來的國際政經情勢更不確定將使全球經濟有陷入低成長之虞。儘管如此，2024年全球經濟在AI趨動下可說是在動盪中成長。

全球經濟短期展望穩定，但仍存在不確定性。美國經濟表現預計在2025年略微放緩，但將保持穩健，主要受惠於財政支撐及生成式AI帶來的生產力提升。歐洲經濟動能較2024年有所改善，但仍顯疲弱，儘管通膨與利率下降有助提振私人消費，但出口和投資成長乏力將抵消部分影響。中國經濟成長可能受美國關稅影響及刺激政策效力的不確定性所制約。新興市場將受惠於全球貿易和商品需求回升，但強勢美元與高債務成本仍是挑戰。氣候變遷、地緣政治緊張局勢仍是全球主要風險。極端天氣事件可能擾亂農業和大宗商品市場，推高食品價格並加劇全球饑餓問題，而海平面上升和全球暖化將迫使各國投入大量資金建設防洪設施、抗旱農作物及可再生能源電網等基礎設施。另一方面，東歐、南海及中東的地緣政治衝突可能影響貿易路線穩定，進一步阻礙國際間的氣候合作。整體而言，2025年全球經濟將呈現機遇與風險並存的局面。新興科技應用，如AI、雲端運算和高效能運算，持續推動經濟發展，帶來創新與成長潛力。然而，地緣政治緊張局勢加劇以及貿易保護主義的擴大，可能對全球經濟成長形成抑制，其發展與影響宜多加留意。

根據世界銀行2025年發布的《全球經濟展望》報告，預估2025年經濟將成長2.7%，與2024年相同，2026年也將擴張2.7%，為連續第四年維持相同的成長率。這主要歸因於全球經濟低迷的成長率可能不足以促成經濟的持續發展，且可能面臨更多逆風，包括政策不確定性升高、不利的貿易政策轉向、地緣政治緊張、通膨居高不下，以及氣候相關的天災。世界銀行上調今年美國經濟成長率預測至2.3%，高於前估的1.8%，中國大陸經濟成長率預估也從4.1%調高至4.5%，歐元區下修0.4個百分點至1%，日本上修0.2

個百分點至 1.2%，印度仍以 6.7% 的預期擴張幅度穩居全球成長最快的主要經濟體。預期企業在關稅將提高而搶先拉貨的帶動下，2025 年全球貿易量將成長 3.1%，高於 2024 年的 2.7%，但較之前預估值降 0.3 個百分點，2026 年全球貿易量成長率預估也調降 0.2 個百分點到 3.2%。貿易政策不確定性和貿易管制措施依然居高不下，2024 年全球新實施的貿易管制政策比 2010-2019 年平均值高出四倍，也逼近 2023 年的歷史新高水準。其他憂慮包括利率維持更高更久，和政策不確定性提高抑制企業信心與投資。大多數開發中國家面臨投資和生產率提高疲軟、人口老齡化和環境危機等困境，全球經濟還面臨貿易政策轉變和地緣政治緊張局勢的進一步挑戰。發展中經濟體未來幾年將面臨更加艱難的局面，全球經濟成長太慢將無法提高生活水準，而政策高度不確定性的環境將阻礙已開發國家對較貧窮國家的投資。

根據經濟合作暨發展組織（OECD）的全球經濟展望報告，預測 2025 年全球經濟成長率 3.3%，看好經濟增長和通膨繼續降溫，但全球仍存在各重大挑戰，像地緣政治衝突構成短期風險、公共債務比率居高不下、和中期成長前景仍太疲弱。各國必須透過寬鬆貨幣等政策手段來穩定宏觀經濟，但要謹慎確保通膨受控。據 IMF 及 OxfordEconomics 最新展望，2025 年全球經濟成長率分別為 3.3%、2.8%，國際經貿維持平穩運行，通膨漸次回落。整體而言，各機構多半認為 2025 年經濟成長表現和 2024 年相差不遠。



資料來源：牛津經濟研究院 (OxfordEconomics)、IMF

在產業展望方面，科技產業將受益於 AI 與自動化的進步，推動半導體和軟體解決方案需求，特別在美國與亞洲市場表現亮眼，據貝恩顧問公司的報告表示，至少在未來 3 年內，AI 相關硬體和軟體的潛在市場總額將每年成長 40% 至 55%，到 2027 年達到 7,800 億至 9,900 億美元，需求成長如此之快，將導致相關零組件供應鏈緊張，加上地緣政治緊張局勢，銷量上升可能引發半導體、個人電腦和智慧型手機的短缺，為因應全球供應鏈變動的變動，全球企業逐漸減少供應商多元化預期，愈來愈多公司專注供應鏈在地化，尋找可靠當地合作供應商，面對全球供應鏈的挑戰；在能源產業方面，公私部門投資持續支援可再生能源轉型，電池技術與儲能進步有望提升電網效率並推動電動車發展，然地緣政治風險仍可能造成油價短期波動；醫療保健產業受人口高齡化及健康意識提升影響，帶動製藥與醫療技術投資，尤其是在日本和歐洲，同時遠端醫療與數位健康平台的發展將改善醫療可及性，促進技術與健康的結合；在傳統產業方面，隨著歐美市場啟動降息、中國大陸加大刺激政策力道，預期政策效果將在 2025 年陸續發酵，應可間接為傳產帶來復甦契機。

● 半導體產業

根據 WSTS（全球半導體貿易統計協會）統計，2024 年全球半導體市場全年總銷售值達 6,276 億美元，年增 19.1%。美國半導體市場總銷售值達 1,946 億美元，年增 44.8%，市占率達 31%。日本半導體市場銷售值達 466 億美元，年減 0.4%，市佔率僅 7%。歐洲半導體市場銷售值達 513 億美元，年減 8.1%，市佔率約 8.2%。中國市場銷售值達 1,825 億美元，年增 18.3%，市佔率高達 29%。亞太

區半導體市場銷售值達 1,527 億美元，年增幅 12.5%，市佔率則為 24.33%。

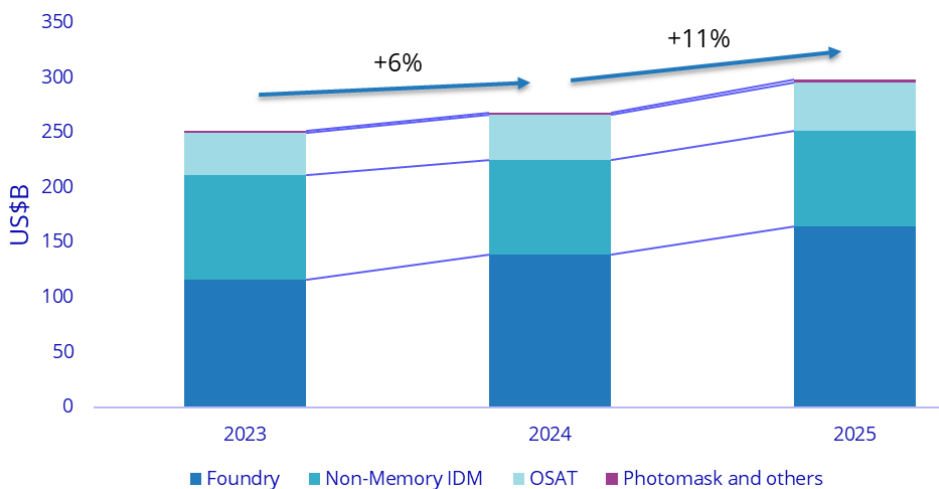
KPMG 分析報告指出，受惠於 AI 和 HPC 的需求攀升，半導體產業持續大幅成長。從雲端資料處理、電動車、無線通訊及終端產品等應用需求提升，以及新興技術的演進對高功能半導體元件需求攀升，使得需求不斷增加。綜觀全球半導體產業發展趨勢，地緣政治局勢的加劇，如烏俄戰爭和中美貿易戰，皆導致企業風險不確定性攀升，影響整個半導體生態系。為了分散地緣政治風險，各國紛紛提高供應鏈彈性，生產基地逐漸從中國擴及東南亞、印度、美國等地，將產能遷移出中國，並且強化半導體自主供應鏈，以預防供應鏈中斷危機。此外，全球主要國家積極扶植半導體產業，祭出半導體振興政策，形塑產業發展優勢，力圖提升本土產業量能和關鍵技術自主性。美國川普政府也計劃對電腦晶片、半導體和藥品等進口商品課徵關稅，就是為了將這些產業的生產移回美國。

根據國際數據公司 IDC 於 2025 年全球半導體市場八大趨勢預測報告，2025 年半導體市場將成長 15%，記憶體領域可望成長超過 24%、非記憶體領域則成長 13%，主要受惠採用先進製程晶片，AI 伺服器、高階手機晶片需求旺盛所致。亞太地區 IC 設計產品線豐富多元，應用遍及全球，包括智慧型手機 AP、電視 SoC、OLED DDIC、LCD TDDI、WiFi、PMIC、MCU、ASIC 等必備晶片。隨著庫存水準穩定、個人裝置需求回升以及 AI 運算向廣泛應用延伸，IC 設計的整體需求將增加。受地緣政治影響，全球封裝測試格局正在重構。其中，中國晶圓代工成熟製程產能持續成長，下游封測產業也並行擴張，形成了完整的製造生態系統。2025 年，中國封裝測試市佔率將持續上升，而台灣廠商將鞏固在 AI GPU 等高階晶片的封裝優勢。預計 2025 年整個封裝測試產業將成長 9%。隨著半導體晶圓的功能和性能要求不斷提高，先進封裝技術變得越來越重要。

Worldwide Foundry Market Forecast



資料來源：IDC



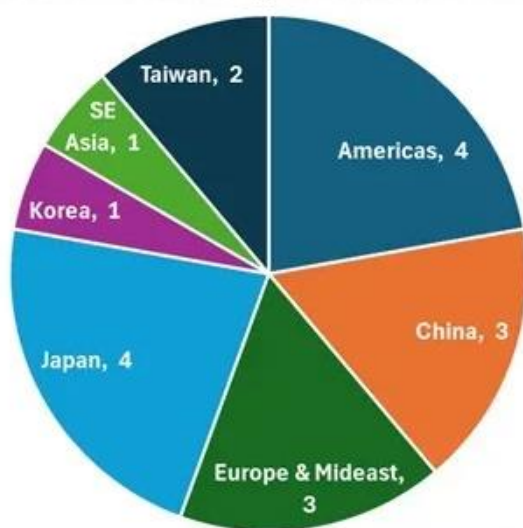
資料來源：IDC

半導體設備方面，在 AI 運算、高頻寬記憶體和中國設備需求提振之下，全球半導體市場可望連續二年暢旺。SEMI 國際半導體產業協會估計，2024 年全球半導體設備市場估計成長 3%，產值突破千億美元；2025 年會再成長 16.5%，來到 1,275 億美元。工研院分析報告指出各國政府鼓勵晶片自主，晶圓廠蓋不停，2022 至 2024 年間，全球有 185 間晶圓廠開始營運或開始興建，5 成以上廠址位於中國、台灣、美國；其中，中國一方面擴大成熟製程投資，一方面又遭遇先進設備出口管制的限制，未來一年美中貿易政策變化，攸關設備市場榮枯。

AI 無疑將是未來十年半導體市場成長的關鍵推力，相關應用同時帶動前段晶圓製造，包括極紫外光 (EUV) 微影製程、原子層沉積技術 (ALD)、原子層蝕刻技術 (ALE) 等，以及後段異質整合，如 CoWoS 製程與矽穿孔 (TSV)、重分佈線層 (RDL) 等設備需求。預估至 2028 年，先進封裝市場將達 786 億美元，具高速、低能耗特性的矽光子技術將逐漸嶄露頭角，卻也帶來製造和封裝的挑戰。在矽晶片上以「光」逐步擴大與「電」的整合，正成為未來半導體的新方向，矽光子技術被認為是下一代高速資料傳輸與光學運算的核心關鍵技術，具高效能、低功耗及高整合性的優勢。

根據 SEMI 國際半導體產業協會報告，2025 年半導體產業將有 18 座新晶圓廠啟建(研發產線不在晶圓廠總數計算之列)，包括三座 8 吋和 15 座 12 吋晶圓廠，其中 2025 年北美和日本各有 4 座新廠計畫領先其他地區；中國和歐洲及中東地區則以 3 座廠房並列第三，台灣則以 2 座、韓國和東南亞各 1 座在其之後，大部分廠房可望於 2026~2027 年間開始營運量產。半導體產業正處於關鍵時刻，擴產投資正在推進先進與主流技術的發展，以滿足不斷演進的全球產業需求。生成式 AI 與高效能運算，正在推動先進邏輯與記憶體領域的進步，而主流製程則繼續支撐汽車、物聯網和功率電子類別等關鍵應用。

New Semiconductor Fabs Starting Construction in 2025 by Region



資料來源：SEMI

半導體產能預計將進一步加速，2025 年年成長率將來到 6.6%，達每月 3,360 萬片晶圓(約當 8 吋)。此一產能擴張主要受惠於由高效能運算應用中的前端邏輯技術，以及邊緣設備中生成式 AI 滲透度的持續高漲。為了趕上大語言模型(LLM)不斷成長的運算需求，半導體業界現正加緊建立先進運算能力。晶片大廠積極擴大先進製程產能(7 奈米及以下)，年成長率將超車業界、來到 16%，至 2025 年每月產能將增加 30 萬片，達 220 萬片。主流製程(8 奈米至 45 奈米)則受到中國晶片自給自足策略以及汽車和物聯網應用預期需求帶動，可望再增 6%產能，2025 年達到突破每月 1,500 萬片晶圓的里程碑。成熟技術製程(50 奈米及以上)擴張情況則凸顯市場復甦緩慢及利用率較低等挑戰，相對較為保留，預計有 5%的漲幅，2025 年月產 1,400 萬片晶圓。

晶圓代工供應商仍將是半導體設備採購的領頭羊，晶圓代工類別產能預計年增 10.9%，將從 2024 年月產 1,130 萬片成長至 2025 年創紀錄的月產 1,260 萬片晶圓。記憶體別整體而言產能擴張則走向穩

定緩和路線，2024 年成長 3.5%、2025 年成長 2.9%。然而，強勁的生成式 AI 需求已經席捲記憶體市場，帶來重大變化。高頻寬記憶體出現大幅成長，為 DRAM 和 NAND 快閃記憶體部門帶來不同的產能成長趨勢。DRAM 類別將持續走強，到 2025 年將與去年同期比成長約 7%，達月產 450 萬片晶圓。3D NAND 裝置容量相對之下也有 5% 的漲幅，達同期月產 370 萬片晶圓。

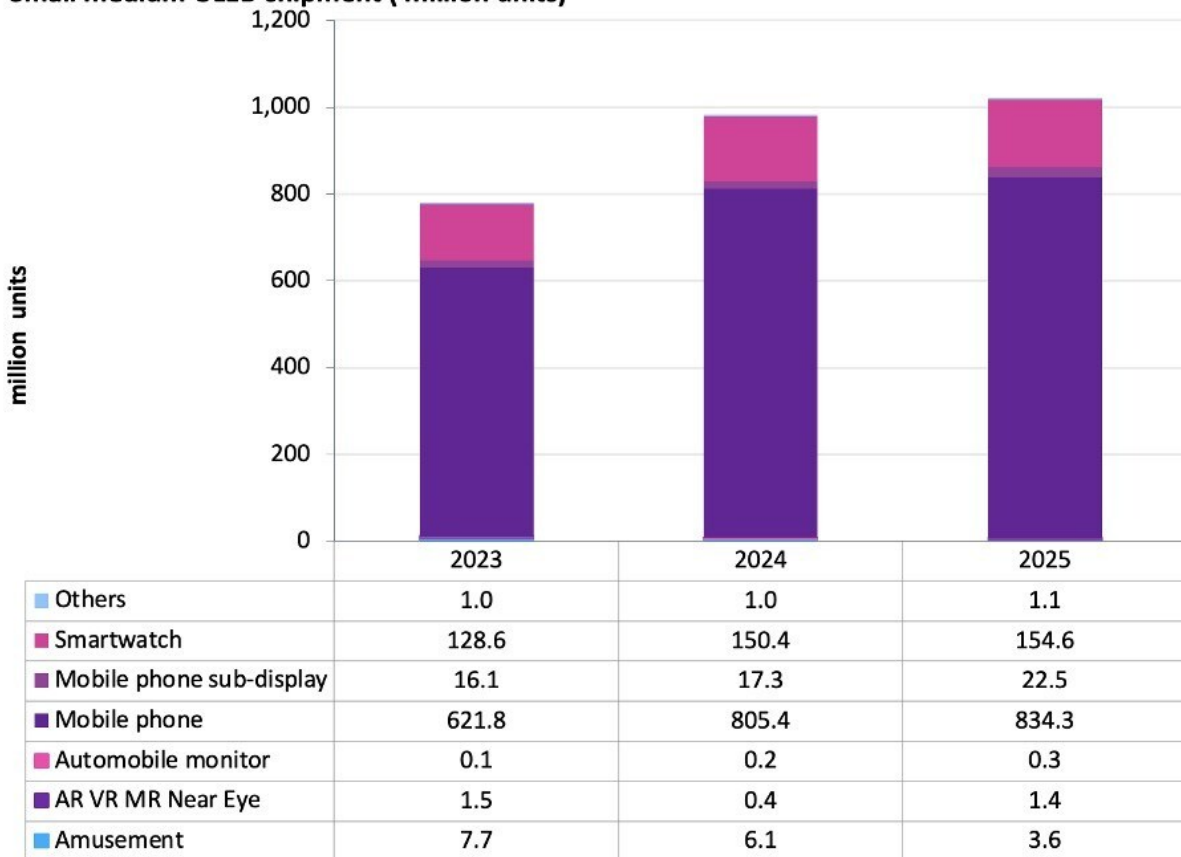
● **顯示器產業**

隨著 AMOLED 面板逐漸取代傳統 TFT LCD 面板，顯示器市場正進入一個新的發展階段。在顯示技術進步和消費者偏好轉變的推動下，顯示器市場正在快速發展。根據 Omdia 的分析報告指出，到 2028 年 AMOLED 面板預計將佔顯示器市場總收入的 43%，而目前占主導地位的 TFT LCD 預計將下降到 55%。AMOLED 面板因其卓越的畫質、更薄更輕的設計以及靈活性等眾多優勢而被廣泛應用於智慧型手機、電視和穿戴式裝置等先進電子產品。OLED 面板採用自發光技術，無需背光。這使得它們節能並且能夠顯示真正的黑色，這是消費者高度重視的功能。這些特點正在推動高階產品線採用 AMOLED 技術。

中小型 OLED 出貨量預計將首次超過 10 億台。這項里程碑包括從 1 吋到 8 吋的顯示器，涵蓋了遊戲機、AR/VR/MR 耳機、近眼鏡和頭戴式顯示器、汽車顯示器、智慧型手機、子顯示器、智慧手錶和工業顯示器等廣泛的應用。儘管成本較高且製造工藝較複雜，但 OLED 憑藉其纖薄的設計、輕巧的重量、出色的畫質、高效的功耗和靈活性，已被證明是中小型顯示器的理想選擇。除了在這些應用中取代 TFT LCD 之外，OLED 還實現了超輕型可折疊顯示器等創新外形顯示器等創新外形顯示器。

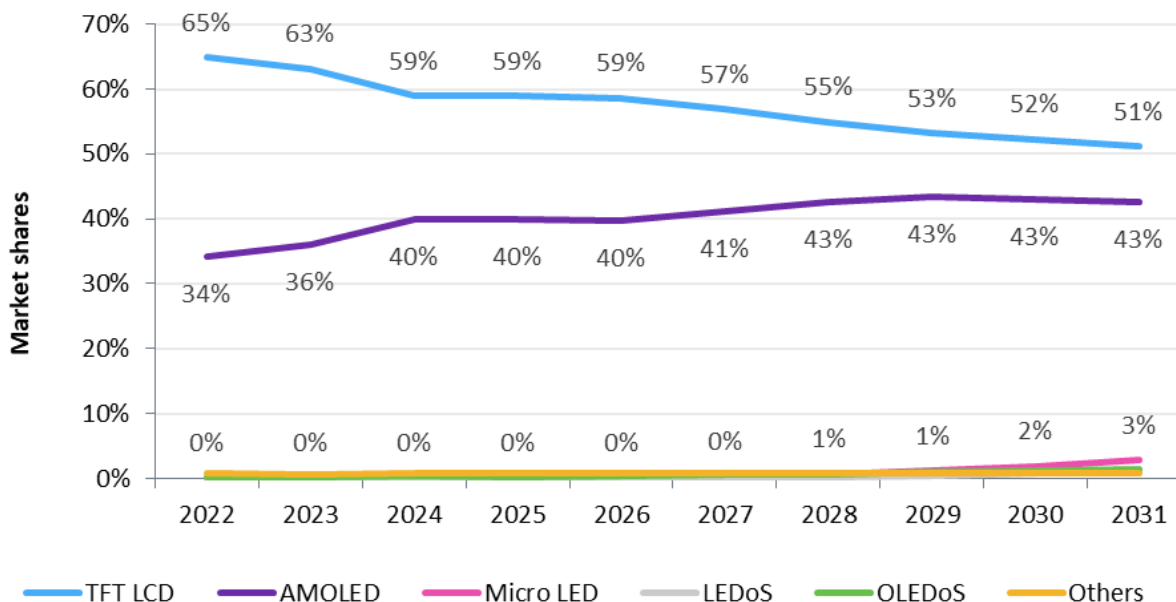
顯示器產業的這些變化正在極大地影響技術發展和投資策略。Samsung Display 和 LG Display 等全球領導者正大力投資 AMOLED 技術研發，鞏固其市場主導地位。同時中國製造商正在迅速擴大其 OLED 生產能力，在 8.6 代 OLED 工廠的投資上超過了韓國公司，生產用於 IT 應用的 OLED 面板。這種競爭格局將加速技術進步並持續推動市場成長。

Small medium OLED shipment ('million units)



資料來源：Omdia's OLED Display Market Tracker,

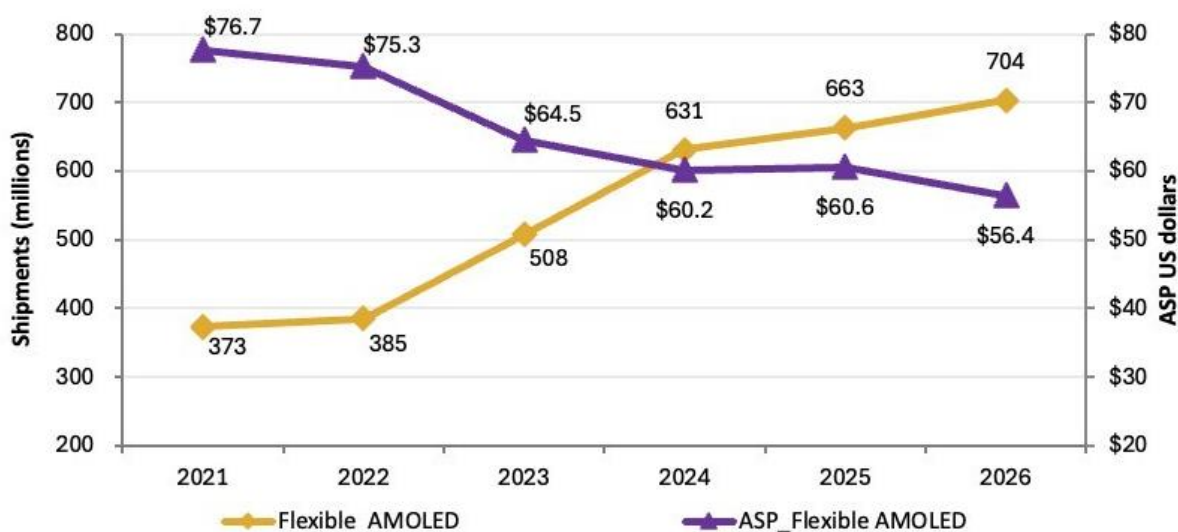
雖然 TFT LCD 技術長期佔據顯示器市場的主導地位，但由於技術限制和競爭加劇，其銷售份額正在逐漸下降。即使在中低階市場，AMOLED 面板單價的下降也正在進一步削弱 TFT LCD 的地位。然而，由於 TFT LCD 技術的生產成本相對較低且在大螢幕領域具有競爭力，因此預計將保持較大的市場份額。在 LCD 電視領域，製造商正專注於 80 吋或更大的超大電視尺寸，這項策略也影響了 OLED 電視的市場需求。



資料來源：Omdia's Display Long-Term Demand Forecast Tracker – 2Q24 Analystist

柔性 AMOLED 顯示器的出貨量預計將在 2024 年達到 6.31 億片，年成長 24%，使該技術成為智慧型手機顯示器市場的主導力量。柔性 AMOLED 預計將佔 42% 的份額，超過 a-Si LCD 的 37%，成為領先的智慧型手機顯示技術。“預計柔性 AMOLED 價格在未來兩年內將保持穩定或僅略有下降，儘管預計會出現季節性價格波動。不過預計 2026 年 8.6 代 OLED 產能釋放，以及中國 OLED 廠商的降價，OLED 價格預計將再次出現快速下滑，這一轉變將加速 2027 年 LCD 向 OLED 升級的進程。

Flexible AMOLED shipment and ASP change from 2021 to 2026

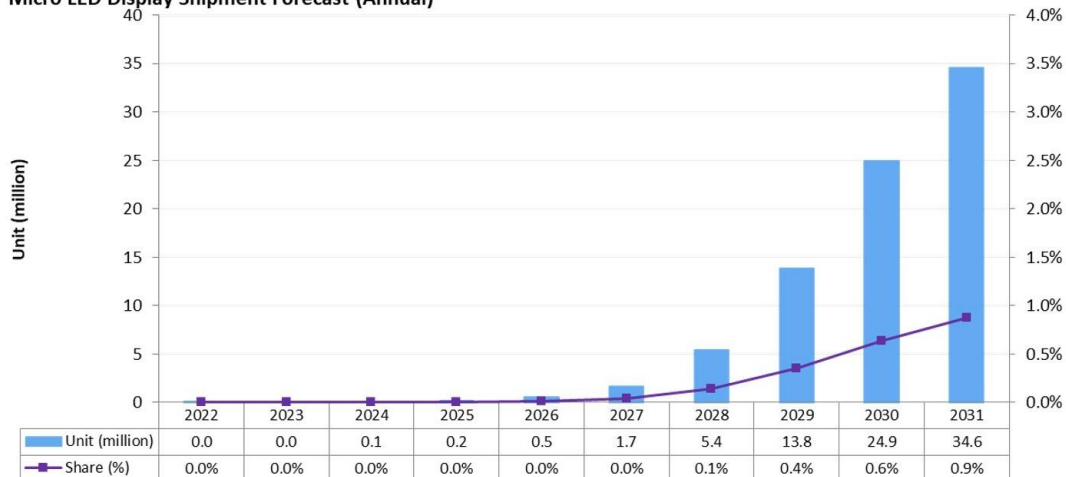


資料來源：Omdia's Smartphone Display Intelligence Service

此外 Micro LED、LEDoS、OLEDoS 等下一代顯示器技術正在興起並開始進入市場。Micro LED 具有出色的亮度和能源效率，使其成為大顯示器和高解析度電視的理想選擇。相較之下，LEDoS 和

OLEDs 在小型和超高解析度顯示器方面表現出色，使其適用於下一代應用，例如智慧手錶和擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）設備。Omdia 預測，到 2027 年 Micro LED 顯示器市場的出貨量將達到 170 萬台，這主要受超小尺寸顯示設備（例如擴展現實（XR）設備，尤其是用於戶外設計的智慧眼鏡）中 LEDs 的推動。到 2031 年 XR 設備預計將佔據 Micro LED 顯示器市場的 24.4%。Omdia 預計到 2031 年 Micro LED、LEDs 和 OLEDs 將佔據整個顯示器市場約 5% 的份額，這些技術將在高端應用中部分取代 AMOLED 和 TFT LCD 技術。

Micro LED Display Shipment Forecast (Annual)

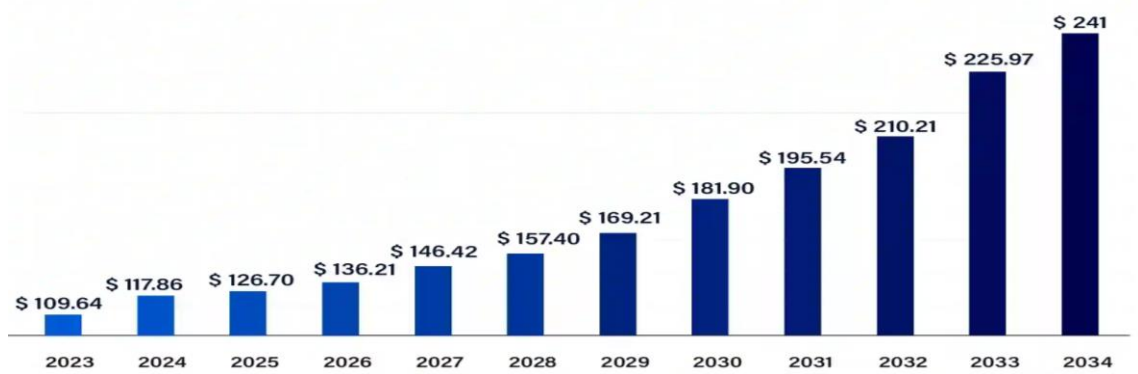


資料來源：Omdia's Micro LED Display Market Tracker

預測到 2028 年 AMOLED 將成為顯示器市場的主要成長動力，AMOLED 技術的快速成長可能是受到高端產品需求不斷增長和持續技術創新的推動。同時在需求穩定支撐下 TFT LCD 將繼續滿足中階和低階市場的需求。隨著顯示器產業競爭日益激烈，技術的進步、生產效率的提升將成為未來市場競爭的關鍵。

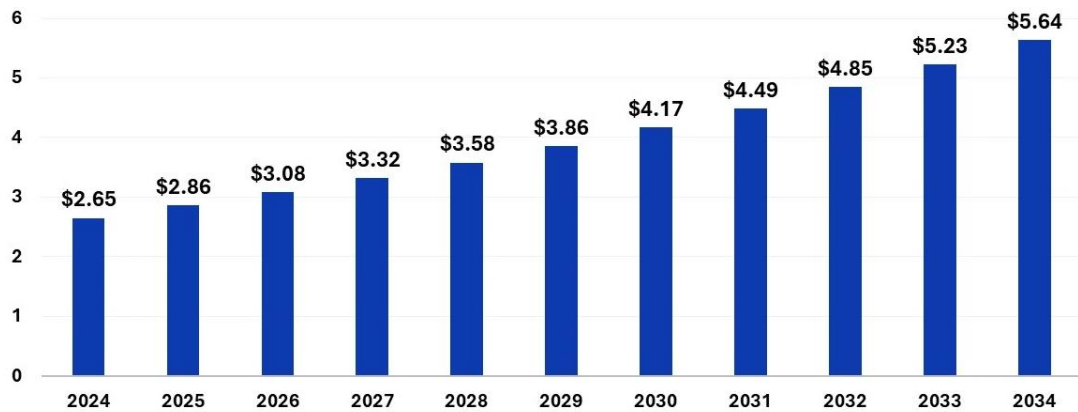
● 自行車相關產業

全球自行車市場受到人們對健身的認識和關注不斷提高的推動，導致自行車銷售繁榮，因為自行車提供了一種很好的交通替代品，並且有利於健康的生活方式。根據 Precedence Research 報告，預計全球自行車市場 2024 年將達到 1,178.6 億美元，2034 年將達到 2,410 億美元左右，2024 年至 2034 年的複合年增長率為 7.42%。亞太地區的市佔率約為 31.27%，道路交通事故頻繁是阻礙亞太地區自行車市場成長的主要因素。該地區大量年輕人口和快速老齡化人口開始意識到騎自行車對健康的益處，而可支配收入的增加和保持健康和健康的日益增長的願望正在推動整個亞太地區對自行車的需求。歐洲的複合年增長率為 10.5%。這種增長歸因於多個城市擁有鼓勵人們使用自行車的支持性基礎設施。丹麥、義大利、比利時和法國等多個歐洲國家正在推出自行車友善基礎設施，以促進自行車通勤。人們對車輛碳排放的擔憂日益加劇，以及超重和肥胖現象的增加進一步刺激了歐洲民眾對自行車的需求。城市化進程的加速和永續交通的推動使得自行車成為汽車的可行且環保的替代品，尤其是在擁擠的城市。其次，隨著越來越多的人追求積極的生活方式，健康和健身意識的不斷增強導致自行車需求激增。此外，專用自行車道和大都市地區的自行車共享計劃等基礎設施的擴建也正在鼓勵人們使用自行車。技術進步，尤其是配備追蹤和安全功能的電動自行車和智慧自行車的進步，也透過吸引精通技術的消費者和通勤者而擴大了市場。隨著消費者尋求特定的解決方案來滿足其需求，對自行車的需求變得越來越多樣化。在城市地區，由於通勤者尋求高效、低成本、可持續的短程至中途移動方式，對電動自行車的需求強勁。在休閒愛好者和競技自行車手的推動下，山地自行車和公路自行車的需求也很高。此外注重永續發展的品牌優先考慮環保製造工藝和再生材料，也能夠吸引越來越多關注環境影響的消費者群體。



資料來源：Precedence Research

電動自行車配備了更有效的整體速度管理裝置，為山區、天橋和崎嶇道路的騎乘者提供舒適的駕駛體驗，電動自行車市場預計將成為最具機會的市場，根據 Precedence Research 報告，2024 年全球高速電動自行車市場規模為 26.5 億美元，預計將從 2025 年的 28.6 億美元增至 2034 年的約 56.4 億美元，2025 年至 2034 年復合年增長率為 7.84%。此外，電池的進步、電池的更高容量和更長的使用壽命是電動自行車的主要特徵，電動自行車為城市交通提供了實用且節能的選擇。此外世界各國政府正在推出激勵措施和補貼措施來推廣電動自行車的使用，作為更廣泛的清潔能源計畫的一部分，預計將推動電動自行車市場的成長。



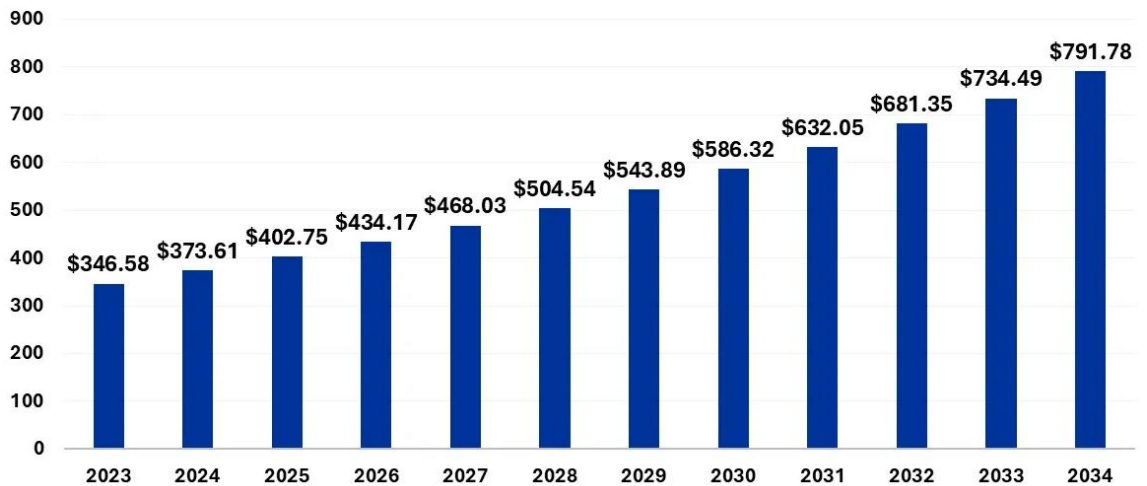
資料來源：Precedence Research

根據 Technavio 分析報告，全球高端自行車市場規模預計將從 2025 年到 2029 年增長 65 億美元，市場復合年增長率將達到近 7.5%。高端自行車市場正在經歷創新和技術發展的繁榮，以滿足挑剔的自行車愛好者的需求。這些自行車以其精湛的工藝、高性能以及輕質碳纖維、鈦和精密合金等優質材料而聞名。空氣動力學設計、精密工程和先進的懸吊系統確保強度、耐用性、靈活性和整體性能。零件和配件，包括變速箱、強力煞車、電子元件和智慧連接，增強了騎乘體驗。自行車產業正在經歷向電動自行車的轉變，電動自行車具有高效、可持續和環保的特點，如踏板輔助和流線型設計。輕質材料，例如電動自行車及其特定部件，開啟了新的騎行可能性。豪華自行車配備內建感測器、使用 3D 掃描和生物力學分析的客製化服務以及電子變速系統。自行車變速箱是一種整合式驅動輪、輪轂齒輪、變速器齒輪和動力傳動系統的齒輪系統，可實現扭力倍增、慣性匹配、速度控制和致命事故預防。自動化產業的技術進步對高端自行車市場產生了重大影響，為騎乘者提供了無縫且愉快的騎乘體驗。

無樁共享自行車系統使用戶能夠自由地尋找、解鎖和停放自行車，徹底改變了城市交通，無需永久性的停靠站。在擁擠的城市中，這種方法提高了可及性和便利性，使騎自行車成為一種受歡迎的交通方式。使用 GPS 和行動應用程式來有效地處理自行車租賃業務。政府鼓勵非機動化交通的項目和日益增長的環境問題推動了無樁自行車共享系統的擴張。現在許多城市地區都已建成共享自行車網絡，確保無縫連接。然而，有限的停車位仍然是一個挑戰，需要多層自行車停車場等創新的解決方案。隨著城市中心優先考慮綠色出行，自行車通勤預計將繼續成長，從而塑造交通的未來。

● 航太相關產業

儘管持續存在供應鏈中斷和經濟不確定性，但全球航空航太製造業預計將繼續穩步成長。這一成長軌跡伴隨著全球航空旅行的預期復甦。在商用航空的不斷擴張是航空航太市場最重要的催化劑。為了滿足不斷增長的需求，航空公司不斷尋求實現機隊的現代化和擴大機隊規模。根據 Precedence Research 研究報告指出，到 2034 年將達到 7,917.8 億美元左右，在 2024 年至 2034 年的預測期內，複合年增長率為 7.8%。



資料來源：Precedence Research

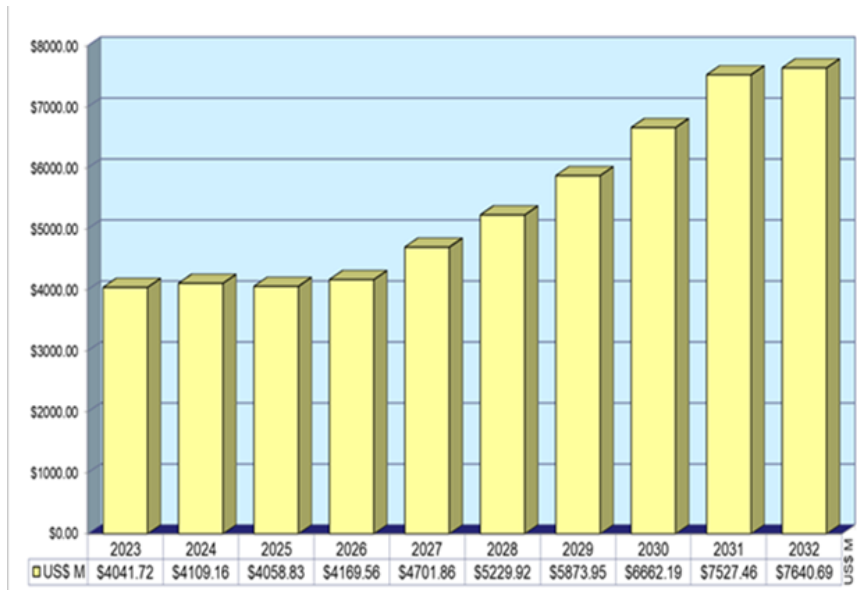
根據美國波音公司在 2024 年 7 月發布的全球航空市場預測報告指出，未來 20 年(2024 年-2043 年)航空客運量(RPK)成長率將達 4.7%，波音公司預估全球航空公司未來 20 年將需要 43,975 架新機，而受到中國大陸、印度及其他新興經濟體大幅度成長的刺激，亞太地區將占新飛機產值市場的 40% 以上，新機市場需求量為 19,180 架。

地緣政治不穩定和緊張局勢會嚴重抑制航空航太產業的市場需求。這些不確定因素包括貿易爭端、制裁和外交衝突，可能會擾亂全球供應鏈、影響國際合作並改變國防採購決策。由於全球國防和安全要求的提高，航空航太市場經歷了大幅成長。在日益複雜多變的地緣政治格局中，世界各國政府都以增強軍事能力作為首要任務。隨著國防預算的增加，擴大航太製造業中的國防類別，這一領域對航空航太公司產生了巨大的需求，促進了軍事航空和技術的創新，同時增強了該行業的整體經濟健康。因此，國防和安全需求對於推動航空航太市場成長和支持該產業的長期永續發展至關重要。

普遍大眾都意識到了航太業對於環境的影響，譬如以客機與貨機來說，其就佔比了全球約 1.9% 的溫室氣體排放、2.5% 的碳排以及 3.5% 的等效輻射驅力。而 IATA 也逐漸提出越來越嚴格的碳排目標，計畫在 2050 年能夠做到淨零排放。而不僅是淨零碳排的大趨勢，當前能源價格高攀不下，也讓省油機型的吸引力大幅上升，尤其是在北美與歐洲。隨著環境問題日益嚴重，人們越來越需要燃料消耗更少、排放更少的飛機，這為電力和混合動力推進系統等創新綠色技術打開了市場。為了因應更嚴格的全球排放標準，推動機隊現代化，使用更省油、更環保的飛機。這一趨勢迫使商業和軍事領域採用尖端技術的新機型取代舊款飛機，以獲得更好的性能並降低對環境的影響。此外包括新材料和新系統的開發在內的航空航天技術的進步使製造商能夠生產更安全、更可靠且能夠降低營運成本的飛機。航空公司正在投資新飛機以滿足日益增長的需求。

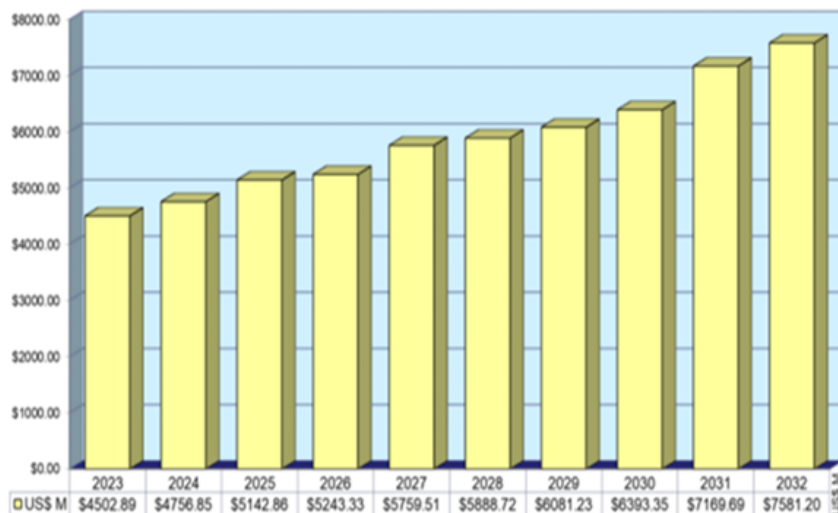
俄烏戰爭衝擊中，烏克蘭運用無人機進行不對稱作戰，且於戰場中無人機屢屢扮演關鍵作戰角色，各國開始關注無人機於戰略上之角色，無人機作為不對稱戰力之應用，更是我國政府所重點關注領域。因應國際地緣政治發展，無人機扮演關鍵作戰角色，促使各國加速推動無人機自主研發能量。根據 Forecast International 無人機市場報告預估，2023 至 2032 年全球軍用無人飛行載具市場將有超過 5.6 萬具軍用無人

機需求，累計產值高達 540 億美元。



資料來源：Forecast International 無人機市場報告—全球軍用無人機產值預測

根據 Forecast International 無人機市場報告預估，民用無人飛行載具市場方面，未來 10 年預估將有超過 8,554 萬具、累計產值高達 585 億美元。



資料來源：Forecast International 無人機市場報告—全球商用無人機產值預測

被推進太空的物體數量不斷增加既是戰略上的當務之急，也是逐漸成熟的成長機會。近年，隨著政府和企業利用與發射能力和衛星製造相關的投資加劇、技術突破和成本下降的趨勢，衛星發射顯著激增。然而隨著每年發射次數的不斷增加，空間碎片的數量也在猛增。低地球軌道中的許多小型衛星壽命有限，這些衛星及其運載火箭缺乏適當的管理導致太空垃圾激增，現在已經超過了現役衛星的數量。因此優先考慮可持續性對於確保空間仍然可供子孫後代使用至關重要。

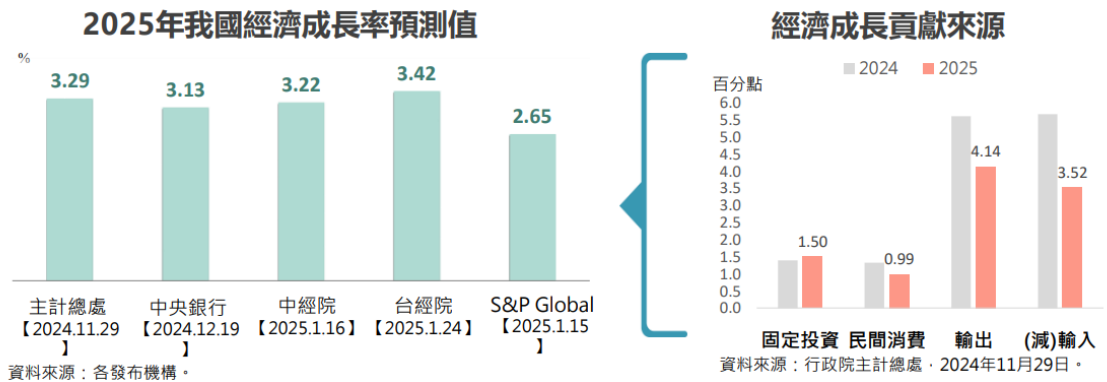
(2) 我國產業概況

● 產業概況

因美中貿易戰和 Covid-19 期間的斷鏈危機經驗，促使國際間出現「國際分工型態改變」和「供應鏈分工關鍵之改變」兩種趨勢。前者為各國供應鏈有部分重疊生產，避免供應鏈斷鏈的危機再現；後者則是將長鏈轉為短鏈降低斷鏈風險，故同時掌握關鍵技術及關鍵零組件國家，能成功吸引供應鏈落地投資。臺灣企業除了考量國際情勢，經比較過後評估中國大陸基礎建設完整性仍勝過東協許多國家，改採中國+N 策略兼顧成本和供應鏈彈性。

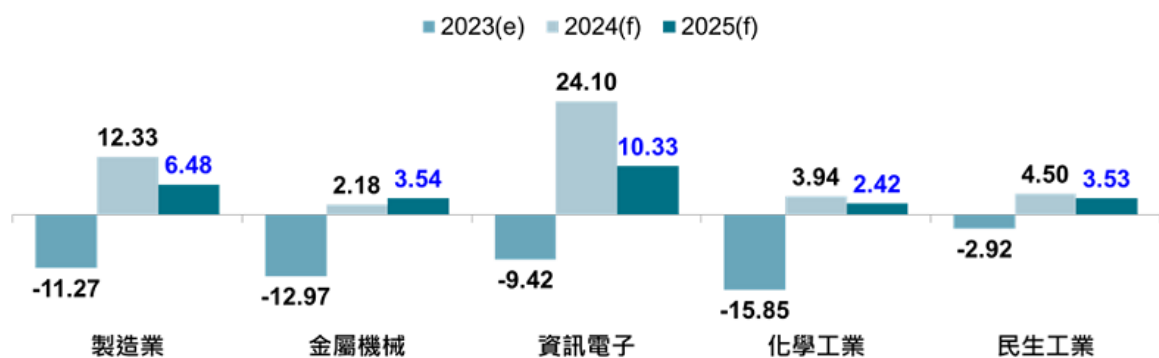
除了掌握美中對抗的商機，近年來臺灣掌握科技世代的關鍵力量，持續與市場並進前行，特別是當前熱門的 AI 商機，讓全球更加關注半導體產業，這也是臺灣的強項。根據知名研究顧問機構單位 Gartner 指出，全球半導體產業歷經 PC 產業、Internet、行動裝置、物聯網為主體的各個階段，如今將邁向 AI 應用領域。半導體新一波的成長動能是來自於 AIoT、5G、精準健康以及資安防護，使得全球半導體營收有望於 2024 年站上 6,543 億美元，臺灣的占有率將高達 6 至 7 成，高階晶片則是高達 9 成。在國內五大信賴產業的持續推動，以及國際科技大廠如 NVIDIA、Google、微軟、亞馬遜來臺設立研發中心和資料中心下，臺灣製造業在全球仍將持續扮演重要的角色，這也是臺灣經濟持續成長的基本動能。

IMF 等國際機構普遍預測 2025 年全球貿易量成長率將較今年提升，顯示終端需求維持復甦趨勢，加上 AI、高效能運算等新興科技應用持續推展，對外出口成長態勢有望延續，這也是臺灣的機會。值得注意的是，2025 年與 2024 年仍可能出現產業表現差異大的情況。傳統產業受到中國產能過剩、內需疲弱以及中國在東南亞的低價競爭，加上歐洲與日本景氣未見明顯復甦而表現不佳。國發會指出台灣經濟基本面強韌，在人工智慧等新興科技應用加速擴展下，有助帶動出口及投資動能，加以內需消費穩定擴增，依主計總處預估今年台灣經濟成長率可望達 3.29%。隨半導體供應鏈積極擴充國內先進製程及高階封測產能，且國際大廠陸續在台設立研發或資料中心，以及企業朝向淨零與數位雙轉型投資，投資持續擴增，並成為今年經濟成長關鍵。



資料來源：國發會彙整

根據工研院分析報告指出，在全球貿易重返溫和擴張下，輔以 AI 熱潮點火帶動我終端資通訊產品需求強勁，部分傳統產業供應鏈回補庫存效應，帶動我國出口、外銷訂單連續數月正成長。國際需求回暖推動我業者擴充產能、綠能基建投資、廠商低碳轉型等利多因素，帶動我民間投資動能增溫，而民間消費基期雖高但擴張持續，臺灣經濟預料仍將溫和成長。2025 年四大工業年增率依序為資訊電子 10.33 %、金屬機械 3.54 %、民生工業 3.53%、化學工業 2.42 %。



資料來源：工研院

展望未來，全球經濟仍將面臨諸多不確定因素，例如川普新政、各國央行貨幣政策走向、中國經濟刺激政策，以及國內投資動能等。因此根據台經院最新預測結果，2025年國內經濟成長率為3.42%。預期2025年台灣經濟成長仰賴內需支撐，外需亦重回經濟成長主力。在外需方面，隨著資通訊產品基期逐步墊高，出口增速或將趨緩，惟近期外銷訂單仍顯示新興科技需求強勁，加上全球多國已開啟降息循環，2025年全球貿易量可望續增，傳統產業亦有望緩步復甦，推動台灣外需穩健成長。內需方面，零售及餐飲銷售額年增率持續穩定成長，加上就業市場依舊穩健，失業率維持低位，實質經常性薪資年增率自2024年轉正，預期此趨勢將延續，為民間消費提供支撐，惟比較基數已高，成長漸緩。投資部分則受惠於新興科技需求強勁帶動，自2024年下半年起半導體設備購置需求大幅成長，機電設備進口值維持高檔，國內晶片領導廠商擴大資本支出、加速淨零轉型投資，並吸引國際大廠加碼在台投資，估計續為經濟成長帶來正貢獻。

受惠新興科技需求持續暢旺，自2024年下半年起，半導體設備的購置需求顯著攀升，機電設備進口值當前仍維持高檔年增率，加上國內晶片領導廠商加大資本支出規模，廠商加速淨零轉型投資，並吸引國際大廠持續加碼在台投資，預期在2025年上半年基期尚未墊高的情況下，投資活動將繼續為台灣經濟注入動能，有助於拉抬整體固定資本形成表現，故預估2025年整體固定資本形成成長率為5.95%，其中民間投資成長率為5.66%。

在貿易方面，台灣出口成長主要受到資通訊產品帶動，反映新興科技需求的強勁動能。近期資通訊產品出口年增率仍維持雙位數成長，顯示AI相關需求持續旺盛。然而各產業復甦不均，傳統產業因終端需求疲弱及中國生產過剩削價競爭，成長動能相對不足，惟隨著中國推行刺激經濟政策及減產措施，部分傳產經濟指標已出現改善，但未來仍需觀察政策成效。隨著主要經濟體步入降息循環，終端需求有望回升，推動2025年全球貿易成長。同時新興科技應用拓展和電子終端產品復甦將持續支撐出口表現，而傳統產業亦有望接棒資通訊產品，助力台灣外貿穩健成長，故預估2025年出口與進口金額成長率則為6.49%與6.96%，2025年輸出與輸入成長率分別為6.05%及6.27%。

● 半導體產業

根據工研院分析報告指出，2024 年台灣半導體業產值首度突破新台幣 5 兆元關卡，達 5 兆 3151 億元，較 2023 年成長 22.4%。其中 IC 設計業產值為新臺幣 12,721 億元，較 2023 年成長 16.0%；IC 製造業為新臺幣 34,195 億元，較 2023 年成長 28.4%，其中晶圓代工為新臺幣 32,438 億元，較 2023 年成長 30.1%，記憶體與其他製造為新臺幣 1,757 億元，較 2023 年成長 3.3%；IC 封裝業為新臺幣 4,233 億元，較 2023 年成長 7.7%；IC 測試業為新臺幣 2,002 億元，較 2023 年成長 5.0%。

而展望 2025 年，預期產值可望進一步突破 6 兆元關卡，達 6 兆 1785 億元，再增加 16.2% 其中，IC 製造業產值將突破 4 兆元關卡，達 4 兆 827 億元，增加 19.4%，仍是台灣半導體業產值成長的主要動能，又以台積電為主要驅動力。台灣 IC 設計業 2025 年產值將約 1 兆 4155 億元，增加 11.3%，IC 封裝業產值 4608 億元，增加 8.9%。IC 測試業產值 2195 億元，增加 9.6%。2025 年台灣半導體業產值增幅將持續高於全球半導體業的 11.2%。

2021~2025(e)年台灣 IC 產業產值

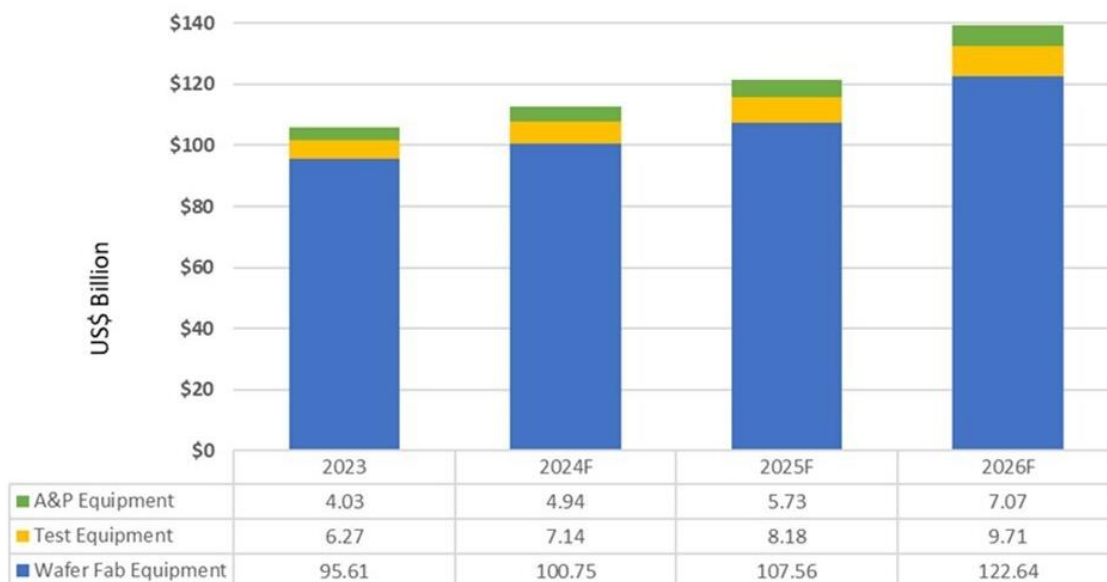
億新臺幣	2021	2021 成長率	2022	2022 成長率	2023	2023 成長率	2024	2024 成長率	2025 (e)	2025 (e) 成長率
IC 產業產值	40,820	26.7%	48,370	18.5%	43,428	-10.2%	53,151	22.4%	61,785	16.2%
IC 設計業	12,147	42.4%	12,320	1.4%	10,965	-11.0%	12,721	16.0%	14,155	11.3%
IC 製造業	22,289	22.4%	29,203	31.0%	26,626	-8.8%	34,195	28.4%	40,827	19.4%
晶圓代工	19,410	19.1%	26,847	19.1%	24,925	-7.2%	32,438	30.1%	38,960	20.1%
記憶體與其他製造	2,879	51.0%	2,356	-18.2%	1,701	-27.8%	1,757	3.3%	1,867	6.3%
IC 封裝業	4,354	15.3%	4,660	7.0%	3,931	-15.6%	4,233	7.7%	4,608	8.9%
IC 測試業	2,030	18.4%	2,187	7.7%	1,906	-12.8%	2,002	5.0%	2,195	9.6%
IC 產品產值	15,026	44.0%	14,676	-2.3%	12,666	-13.7%	14,478	14.3%	16,022	10.7%
全球半導體市場(億美元)及成長率(%)	5,559	26.2%	5,741	3.3%	5,269	-8.2%	6,276	19.1%	6,979	11.2%

資料來源：TSIA；工研院

全球半導體應用市場往非傳統 3C 發展趨勢趨於顯著，即 2028 年全球半導體銷售額應用比重最大的將為運算用電子，比重由 2023 年的 26.7% 攀升至 2028 年的 30.4%，係因生成式 AI 的驅動，而 2028 年應用比重居次的為通訊的 27.1%，車用電子位居第三將來到 14.4%，另外若以 2023~2028 年全球半導體應用市場的年複合成長率來看，超過 10% 含括儲存用電子、運算用電子。事實上，AI 將持續成為驅動 2025 年半導體業成長的主要動能之一，而臺灣廠商的先進製程、先進封裝依舊是全球 AI 供應鏈中的重中之重，

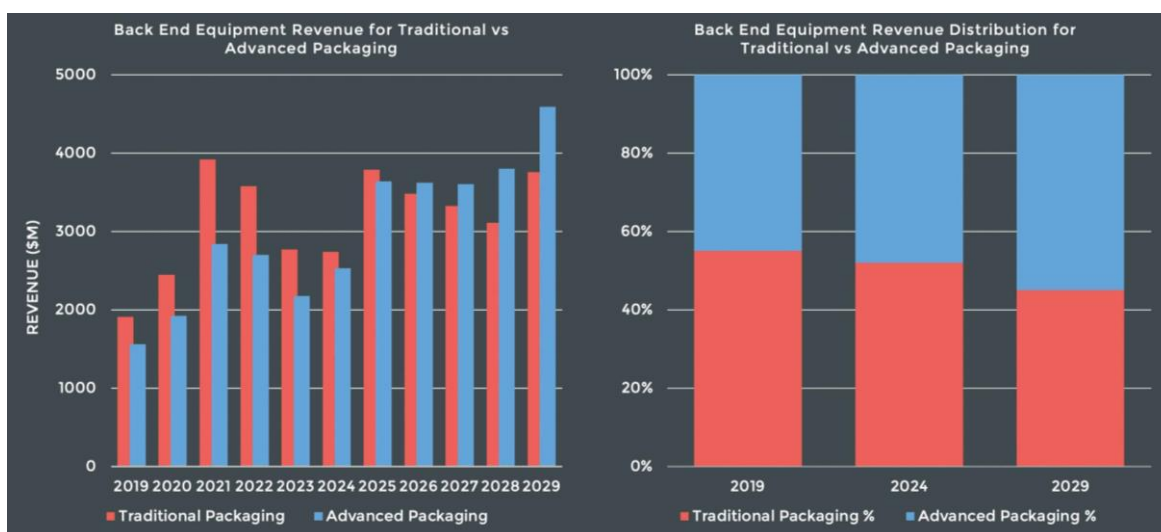
從美中貿易戰開始，美國對中國大陸進行一系列制裁，特別是 2022 年宣布晶片出口管制措施，禁止未獲允許之使用美國技術的先進晶片及相關製造設備出口至中國；2024 年再宣布對中國大陸成熟製程晶片發起 301 條款調查，對於後續台灣半導體產業帶來政策不確定性。台灣企業擁有尖端製程、IC 設計及封裝產業高度的競爭力，特別是在先進製程的技術方面領先全球。然而，在材料與設備部分，台灣的自給率不高，成為了一項風險。此外在成熟製程方面，由於中國積極擴充產能並壓低價格，台灣大廠如聯電、世界先進、力積電等面臨相對的壓力，尋求其他出路成為半導體廠的備戰選擇之，例如化合物半導體。隨著自駕車、新能源、無線通訊等創新發展，其耐高電壓、高電流、高散熱效率、高操作頻率等優越材料特性，各界預期其將成半導體產業明日之星，世界主要國家亦積極投入並發展茁壯，特別是目前以 IDM 廠為主要 player，台灣僅在代工領域有其角色，然而在設計及模組及應用市場段，仍需追趕。

根據 SEMI 分析報告指出，生成式 AI 和新資料中心建置一直是高頻寬記憶體等最先進代工和儲存裝置成長的重要驅動力，但其他終端市場大多還未能從過剩庫存的影響中完全恢復，工業半導體市場仍處於強勁庫存調整階段，對全球矽晶圓出貨造成一定的衝擊，主要是中國大陸對晶圓廠的擴充投資及 AI 應用的 DRAM 與高頻寬記憶體相關強勁的設備投資所驅動超乎預期，預估半導體製造投資估計將有連續三年的增長，這顯示出半導體業在支撐全球經濟與尖端科技創新方面扮演的重要角色。直到 2026 年台灣、中國大陸與南韓，仍是全球前三大半導體設備支出市場，而中國大陸仍居首位，隨著台積電等半導體廠持續在台灣投資建廠、擴充產能，相關先進製程與先進封裝設備供應鏈也可望雨露均霑。



資料來源：SEMI Equipment Market Data Subscription (US\$ Billion)

未來半導體業技術持續推展的關鍵將在於先進封裝、Chiplet、背面電軌、矽光子技術、導入 High-NA EUV 曝光機的時機等，首先超級電軌與 High-NA EUV 將成為先進製程競爭關鍵，主要是隨著半導體製程持續微縮，電晶體密度與堆疊層數不斷提升，如何解決訊號與供電網路的資源排擠成為重要課題。其次就先進封裝成為產業新戰場方面，台積電以先進封裝 CoWoS 推進晶片發展，引爆全球半導體廠搶攻商機，在應用需求驅動下，晶片異質整合成為重要趨勢，並視先進封裝將是下世代 AI、通訊、高效能運算和智慧物聯網等應用的決戰關鍵。根據 Yole Group 指出，近二年先進封裝產能連年倍增，預估 2025 年先進封裝市場占比將正式超過傳統封裝，可見先進封裝市場大餅成長力道驚人，台系一線封測代工廠如日月光、京元電、力成，甚至到設備廠供應鏈，2025 年營運持續看好。先進封裝主流技術架構除了台積電的 CoWoS 之外，還包括日月光半導體的 FoCoS、矽品精密的 FO-MCM 及 Amkor 的 S-Swift 等。研究機構 Yole Group 預測，先進封裝在整體封裝市場中的比例將於 2025 年超過非先進封裝，達到 51.03%，可見先進封裝製程在半導體產業中的重要性，不僅逐年提升，且成長相當強勁。在高效能運算客戶需求推動下，台積電 CoWoS 產能持續倍增，目標將從 2024 年的 33 萬片大幅擴充至 2025 年的 66 萬片，年增 100%，其中以 CoWoS-L 產品線年增 470% 為主要動能，而台灣設備供應鏈包括濕蝕刻、點膠、揀晶等關鍵製程設備廠商，將在此波擴產潮中獲得更多成長契機。



資料來源：Yole Group

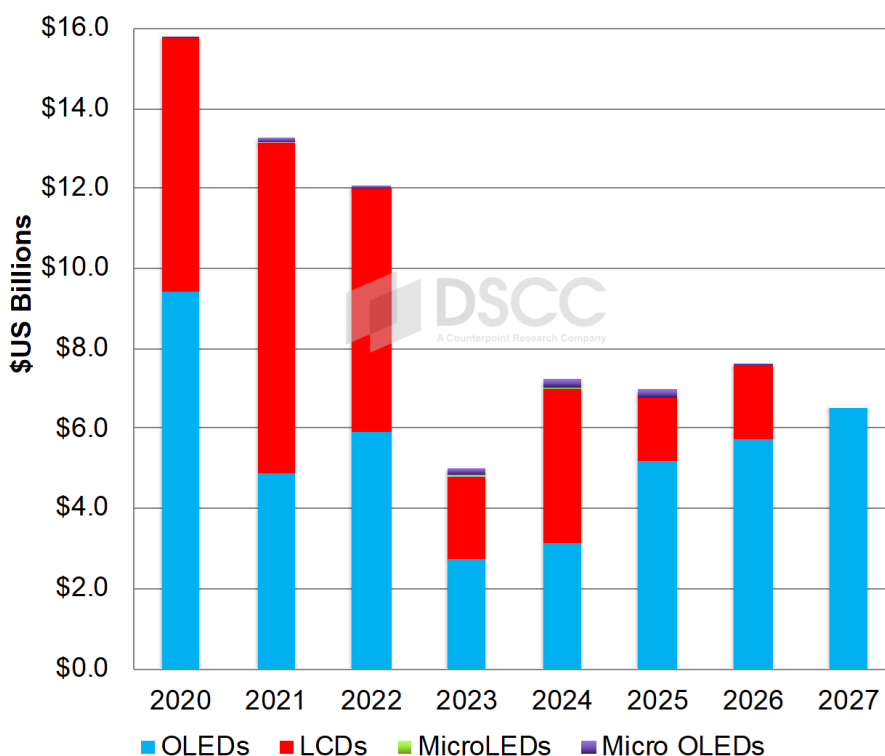
在 FOPLP 方面，2025 年起將快速成長，根據 DSCC 分析報告指出，扇外型面板級封裝市場包括玻璃

基板封裝預計將以 29% 的 CAGR 成長至 29 億美元，目前以玻璃 Base 製程為主，應用於 PMIC、RF 等小型晶片，預計技術累積數年後可望進軍封裝面積要求更大的 AI 晶片市場，扇外型面板級封裝能提供更高的資料頻寬與散熱效能，特別適用於 GPU、CPU 和 ASIC 的運算需求，並導入技術門檻要求更高的玻璃 Base 產品。隨著晶片設計日益複雜且尺寸增加，晶圓廠與封裝供應商正採用玻璃基板與扇外型面板級封裝等新型封裝技術。玻璃基板具備優異的平整度與熱機械穩定性，可支援更高密度與高效能的晶片封裝，成為推動 AI 應用的關鍵。主要挑戰包括：面板尺寸標準化、翹曲控制，以及設備成熟度。另外，材料的創新，低熱膨脹係數玻璃與先進鍵合技術，將是扇外型面板級封裝規模化的關鍵。

至於矽光子技術引領下世代半導體創新部分，面對高速資料傳輸需求與能源效率挑戰，矽光子技術逐漸成為產業焦點，特別在 AI 與雲端運算等應用推動下，共同封裝光學元件市場預計在 2023-2028 年將以 35.1% 的年複合成長率擴張；其中台灣半導體業者已透過成立 SEMI 矽光子產業聯盟，集結產業力量搶攻商機，甚至台積電計畫於 2025 年完成 COUPE 驗證，2026 年整合 CoWoS 封裝成為 CPO 方案，展現在新興技術領域的布局決心。

● 顯示器產業

DSCC 研究報告預測由於顯示器需求增加和面板供應商利用率上升，OLED 設備支出預計從 2023 年到 2027 年逐年增加，到 2027 年將達到 65 億美元。OLED 在智慧型手機、平板電腦、筆記型電腦和其他市場的滲透率持續提高，平均面板尺寸持續成長，當利用率預計達到過高水準時，這將鼓勵面板供應商增加產能。由於需求不斷增長且資本密集度高於 LCD，預計 OLED 將佔 2020 年至 2027 年顯示設備支出的 58%，而 LCD 晶圓廠預計將佔 40% 的份額，目前預計 2024 年至 2027 年期間將僅有四座新的 LCD 晶圓廠投入生產，LCD 支出維持穩定在 300 億美元，而 Micro OLED 和 MicroLED 支出也保持穩定。

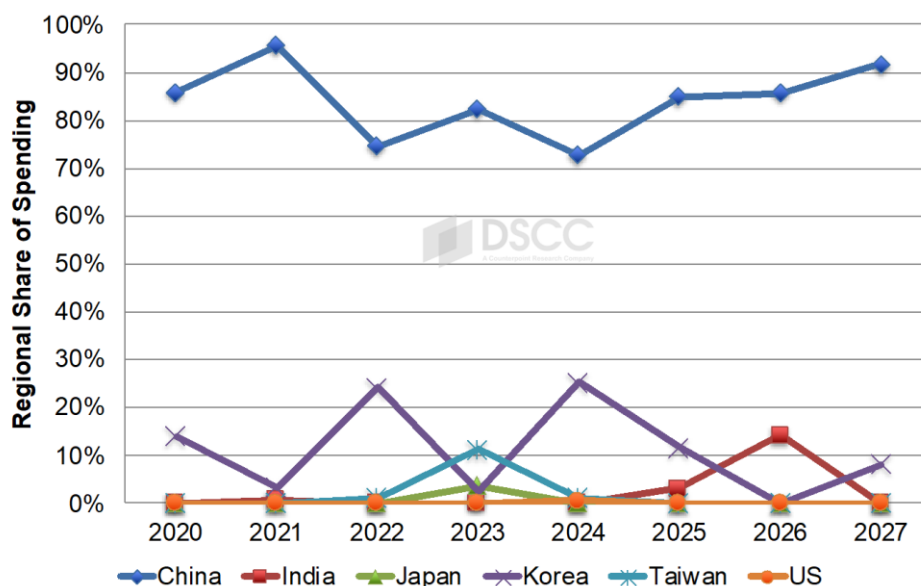


資料來源：DSCC's Quarterly Display Capex and Equipment Market Share Report

按地區劃分，中國在 2020-2027 年支出中的份額預計將從 83% 上升至 85%，支出金額為 630 億美元，而且中國每年都處於領先地位。預計韓國在此期間的支出份額將從 13% 下降至 12%，支出金額為 90 億美元。預計印度將佔 2%，台灣將佔 1%。預計同期中國將以 92% 的份額佔據 LCD 支出的主導地位，OLED 區域支出將以 77% 的份額佔據主導地位，Micro OLED 支出將以 80% 的份額佔據主導地位。

按面板製造商來看，京東方預計將以 23% 的份額領先，其次是華星光電以 20% 的份額，天馬以 11%

的份額，惠科和維信諾各以 10% 的份額，Samsung Display 以 7% 的份額，LG Display 以 5% 的份額。預計京東方將在 OLED 領域以 27% 的份額領先，而華星光電將在 LCD 領域以 30% 的份額領先，全球面板產能集中度將持續提升，而中國面板廠在 TFT-LCD 領域在取得絕對的產能優勢下，超大尺寸的需求同樣的持續攀高，對全球顯示產業的影響力也將繼續擴大，LCD TV 產能很有機會成為各面板廠接下來擴大市場影響力與穩定獲利的重要資源。



資料來源：DSCC's Quarterly Display Capex and Equipment Market Share Report

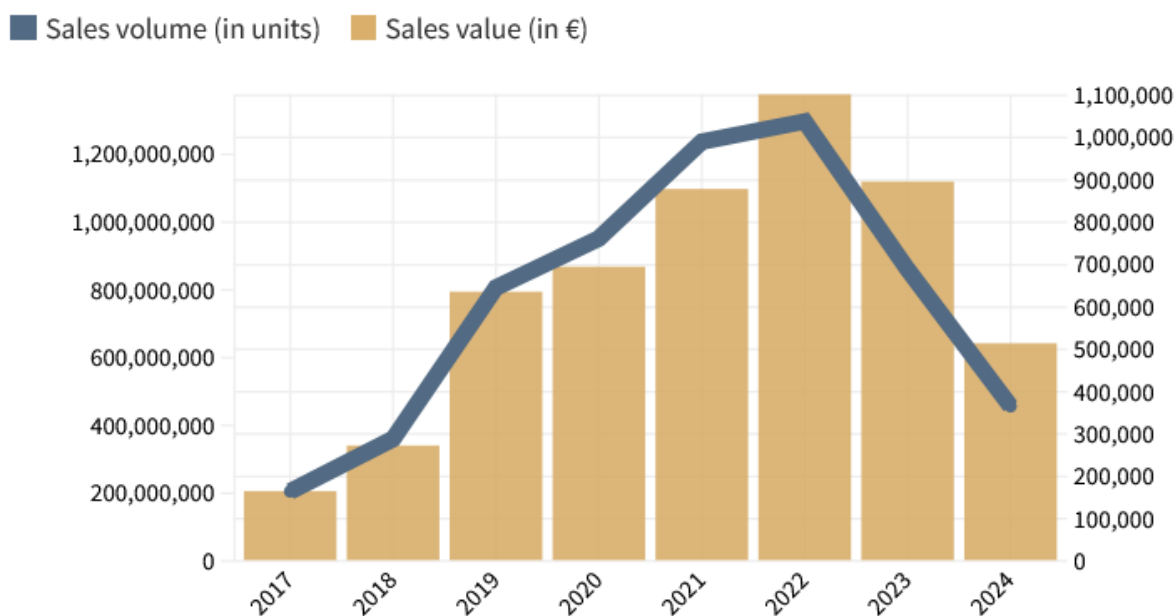
根據 TrendForce 最新 OLED 技術及市場發展分析報告，OLED 顯示技術的應用範圍已從智慧手機擴大至平板電腦、筆電、穿戴式裝置以及汽車顯示器等，促使面板廠加速投入高世代產線建設。為優化產品壽命，OLED 架構將採用 Tandem 技術，加上量產初期良率待提升，整體製造成本較高，Samsung Display 和京東方均已著手建置 G8.6 產線，維信諾則計畫於 2028 年啟動高世代產線量產，以其新一代 ViP 顯示技術開拓應用。JDI 近日與群創和其子公司 CarUX 共同成立 eLEAP 策略聯盟，推廣 32 吋 OLED 整合型車內顯示器。至於 LG Display 的高世代產線計畫仍因資金限制處於評估階段。高世代 OLED 量產初期因良率待改進，材料價格壓力仍大，就現金成本來看，預估新建設的 G8.6 高世代廠需經歷一年半至兩年的時間，才有機會與 G6 產線相當。2024 年蘋果正式推出採用 RGB AMOLED 面板的 iPad Pro 系列，揭示了 RGB AMOLED 面板的下一步將擴大至中尺寸產品應用。除了平板電腦，筆記型電腦採用 AMOLED 面板的趨勢也在醞釀中。雖然蘋果計畫在 2026 至 2027 年間於 Macbook 系列導入 AMOLED 面板，但其早已開始推進面板廠擴大投資，將 RGB AMOLED 面板的產線配置從 6 代線擴大至 8.6 或 8.7 代線規模，以對應後續潛在需求。在趨勢已然確立下，帶動其他品牌提前布局，利用現有產線先開拓市場。以 2025 年的 AMOLED 筆電規模來看，預計有望突破 600 萬台，市場滲透率預估將達 3%。

目前台系面板廠仍有不少較小世代的產能，這些產能過去主要生產 IT 面板與中小面板，隨著競爭對手的大世代產能不斷擴充，台廠的小世代線越來越難與大世代產能競爭，促使這幾年台廠開始邁向轉型的路線。群創 2023 年底關閉 5.5 代線後，開始積極探詢後續轉型的可能性，最終拍板直接由台積電買下該廠房，用以擴充先進封裝產能。這項交易對雙方都有好處，對群創而言，轉手閒置廠房資產可望獲得業外收入的挹注；對台積電而言，快速取得既有廠房，將有助加速擴充先進封裝產能，緩解產能吃緊的問題。群創近年開始積極利用小世代線產能發展非顯示相關的利基型應用，如面板級扇外型封裝、X-ray Sensor 等，也積極朝向車用市場等系統整合領域開拓新業務。被寄予厚望的面板級扇外型封裝技術，歷經長時間的開發，有望見到初步成果，這將有助於群創淡化傳統純面板廠的角色，並透過其核心技術能力朝多元領域發展與轉型。

● 自行車產業

台灣自行車產業受到歐美市場忙著去化庫存、大量減少新車訂單影響，根據台灣自行車輸出業公會、海關提供的草本統計資料顯示，去年台灣自行車出口表現延續2023年的低迷，全年出口量僅達90.98萬台、年減31.27%，跌破100萬台大關，總出口值10.29億美元、年減25.65%，平均出口單價年增8.19%至1,130.79美元，續創單價新高。兩大主要出口市場歐盟和美國，需求持續低迷，去年從台灣進口的自行車數量分別年減30.28%和33.27%。至於電動輔助自行車去年出口量也僅36.38萬台，年減幅高達47.01%，總出口值6.72億元、年減44.60%，平均出口單價1,847.56美元、年增4.55%。去年台灣自行車零件出口量與出口值，也分別年減13.61%與17.46%。受人們健康意識增強、環境問題加劇和城市化進程加快的推動，全球自行車產業正經歷一段蓬勃發展的時期。隨著越來越多的人尋求永續與健康的交通方式，對自行車，尤其是電動自行車的需求正在上升，這為製造商和零售商創造了新的機會和挑戰。

台灣電動自行車出口在2024年對台灣產業來說卻是最難熬的一年。儘管出口在6月達到高峰，但全年的月均出口量仍遠低於前一年水平。2024年台灣電動自行車出口值估計面臨4.77億歐元的損失。從近年的出口數量及金額發現，雖然數量下降但出口金額卻高速成長，平均單價更持續上揚，表示台灣正在走高質化路線。



資料來源：BOFT/Bike Europe

自行車作為減碳、環保及健康的象徵，在全球 ESG 浪潮推動下愈發重要。臺灣在全球高階自行車市佔率達20%，在國際供應鏈中具有舉足輕重的地位，隨著全球環保意識提升和減碳倡議的推動，電動自行車及輕型移動載具近年成為歐美國家交通及載運的首選，顯示出市場的巨大潛力和增長前景。展望2025年自行車雙雄巨大、美利達均持審慎樂觀的態度。巨大認為，歐洲、美國與大陸三大市場都可望出現成長，今年營收可望優於去年；美利達表示為，歐美市場庫存水位已低，今年出貨量可望成長，但大陸市場在庫存量提高下，產銷量恐將下滑。

隨著全球人口逐漸老化，健康與舒適性成為自行車設計的重要考量。長者和中高齡騎行者需要低衝擊、易操作的自行車產品，以適應他們的日常需求。電動自行車和智慧化功能正好能解決這類需求，使自行車產業的未來朝向「全齡化」發展，讓不同年齡層的使用者都能享受到自行車帶來的便利。自行車產業發展趨勢為輕量化設計能提升騎行的靈活性與速度，並減少騎行的負擔，成為自行車產業持續研發的重點。通過新材料的運用，如碳纖維和鋁合金等，自行車企業正在不斷改進材料科技，以實現輕量、耐用且安全的設計，讓自行車成為更輕便且適合長距離使用的代步工具。隨著電動科技的普及，電動自行車逐漸成為城

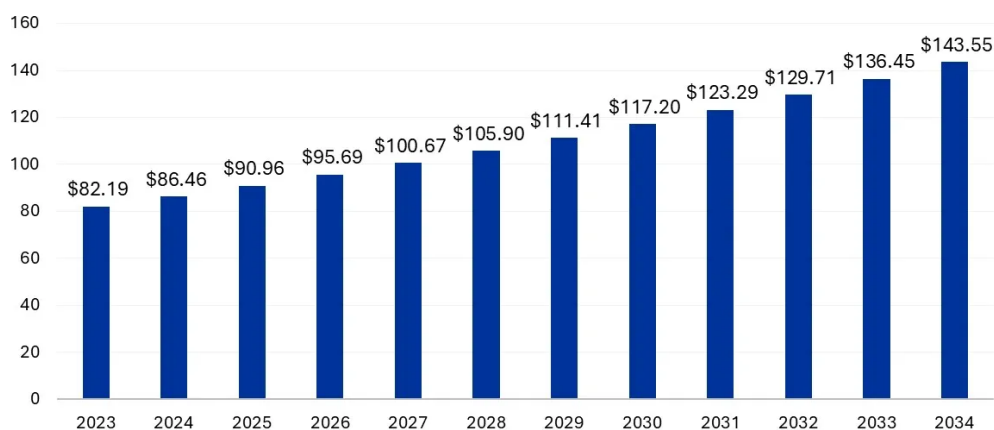
市通勤的首選。電動自行車具有操作簡便、低碳排放等特性，尤其適合市區的短距離通勤需求。自行車產業正在開發更高效的電動馬達、續航電池，以提升電動自行車的功能和性能。此趨勢也契合了全球城市追求低碳、永續交通的需求。智慧化則將數位科技應用於自行車裝置中，如 GPS 定位、騎行數據監測、以及車輛追蹤系統等。智慧化不僅可以提升騎行安全性，還能改善使用體驗。連接智能裝置的自行車，能幫助用戶隨時掌握車輛狀態並管理騎行路線，成為智慧城市的理想交通工具。共享服務則已在全球範圍內廣泛推行，特別是在城市密集地區，自行車共享系統提供了一種環保、便捷的通勤方式。透過大數據與共享經濟模式的結合，企業能更有效地配置車輛資源，提升運營效率。共享自行車服務也助推了低碳出行的普及，使自行車產業更接近全民化。自行車產業需要在數位技術的投入上與時俱進，提供消費者更多元的運動數據解決方案，以滿足市場需求。

自行車行業的優勢在於其需求量長期穩定。雖然自行車屬於非必要性消費品，但其特點是消費者在經濟景氣好的時候會增加購買，而景氣差的時候則可能延遲購買。全球自行車市場呈現 M 型化發展，低階市場縮減，高階與電動自行車持續成長。預期歐美市場產業重整後，中小品牌淘汰速度加快，有助於財務穩健、品牌力強的業者擴大市佔，台灣自行車產業亦受惠於全球去中化趨勢，競爭優勢進一步鞏固。

● 航太相關產業

隨著航空業逐步從疫情中復甦，全球航空機隊需求快速回升。然而，供應鏈受勞動力短缺、材料延遲及技術瓶頸影響，新飛機交付進度受阻。雖然波音與空巴正努力擴大產能，以應對未來需求增長，但實際操作仍困難重重，兩家公司的訂單積壓已經達到將近 1.5 萬架，比 2022 年初多了快 27%。而且新訂單還在不停地進來，生產速度卻跟不上，積壓的壓力只會越來越大。航空業正面臨嚴峻的供應鏈危機，引擎維修週期從疫情前的三個月延長至六個月，對運營造成嚴重影響。為此，各航空公司被迫採取應急措施，包括削減航班、拆解機上零件，甚至租用臨時引擎或飛機以維持運營。台灣航太供應鏈主要業務為波音單走道機身結構件及搭載於單走道 LEAP 引擎相關零組件，受到波音產量被限制，波音交機量及 LEAP 引擎生產量都呈現衰退，影響台灣供應鏈廠商營運。因此在兩大飛機製造商產量持續提高下，國內航太產業已逐漸復甦跡象，看好 2025 年航太供應鏈營收有成長表現。

根據 Precedence Research 研究報告指出，全球航空維修、修理和大修（MRO）市場預計 2025 年將增長至 909.6 億美元，預計到 2034 年將達到 1435.5 億美元。MRO 產業是航空業中不可或缺的一部分，負責維持飛機的安全性、可靠性及運營效率。該產業涵蓋從日常檢修到大規模整修的全方位服務，是確保航空運營順暢的重要基石。在全球航空業市場穩步成長的背景下，亞太地區成為增長最快的市場之一，台灣也因此區域航空維修領域中具備重要戰略地位。依託完善的製造產業基礎與地理優勢，台灣的 MRO 公司有機會在全球供應鏈中扮演更積極的角色。

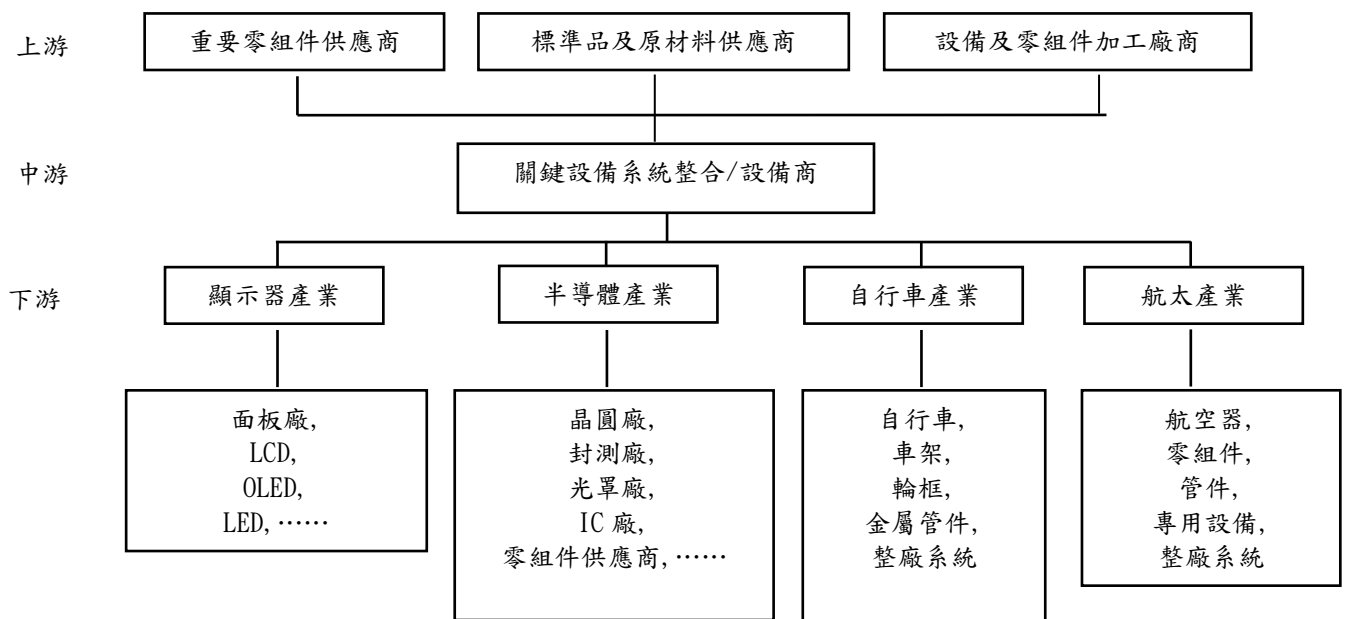


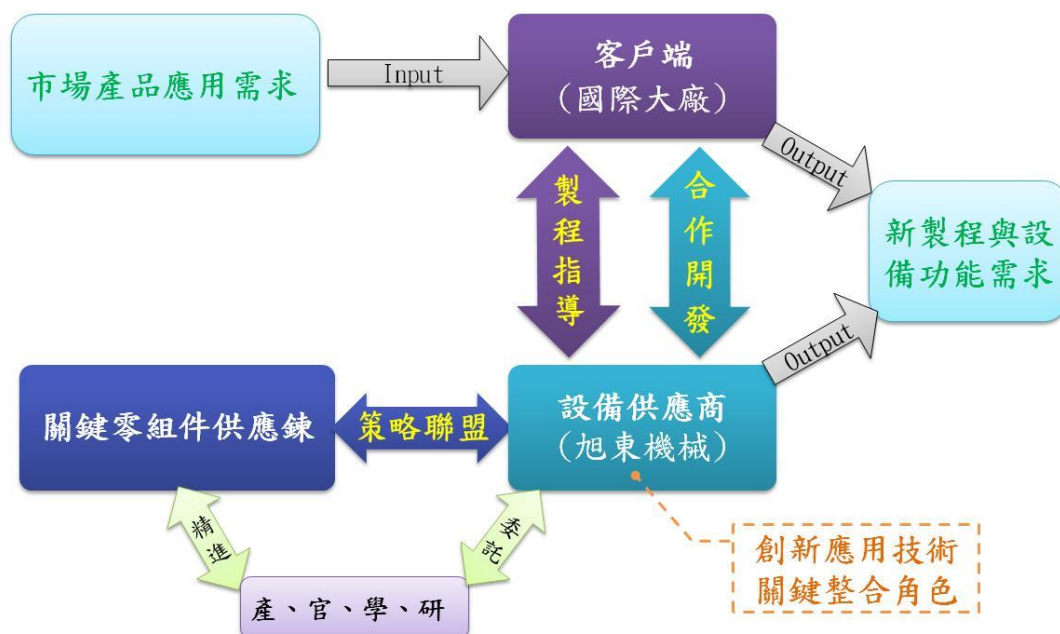
資料來源：Precedence Research

台灣航太產業已建構民用及軍用航太產品供應鏈體系，包括漢翔等台灣航太廠商，與波音、空中巴士、龐巴迪、奇異、勞斯萊斯、Pratt & Whitney、Snecma 及 Honey well 等世界航太大廠，都已建立合作夥伴關係。台灣航太產業面對國際供應鏈調整和新興科技需求，出口表現增長 15%，顯示出台灣在這一領域的競爭力正在不斷提升。其中，關鍵零件與引擎製造成為台灣航太出口的亮點。隨著全球低軌衛星技術的需求日益增加，台灣也將迎來更多的技術與商業機會。低軌衛星技術將是未來數年內航太產業的關鍵突破點，未來幾年內，低軌衛星的應用將大幅改變全球通訊與數據傳輸的方式。政府積極推動 2027 年發射首顆 B5G 低軌衛星，並規劃投資 30 億新台幣，積極發展低軌衛星的通訊酬載與地面設備，並努力實現關鍵零組件的自製化，預估創造 300 億元的產值。特別是隨著 5G 和 B5G 技術的普及，低軌衛星通訊系統將成為全球通訊基礎設施的重要組成部分。

政府建立軍民整合的國防及戰略產業為長期目標，期帶動整體產業技術升級，發展核心關鍵技術，藉由國防航太內需市場，以軍帶民推動民間廠商投入航太領域，進而帶動創造就業機會提升與航太產業升級。無人飛行系統已成為 21 世紀航太產業之新興產品，全球航太產業國家與業者均積極投入相關的研製工作。海巡單位及軍方為主要應用市場，另在民用市場方面為海洋污染監控、國境海岸監控、環境監測、大氣氣候研究、地質探勘研究、國土開發、漁業資源研究、農/漁業應用、交通控制、公路即時流量監控、進出港船舶管理、管制、水災、火災、油污、核污染等區域性的監控等應用，民用市場已隨無人飛行系統技術成熟而蓬勃發展。經濟部宣示台灣卓越無人機海外商機聯盟正式成立，由漢翔公司擔任產業代表，目前已集結超過 120 家國內業者，共同爭取國際無人機市場商機。聯盟將優先媒合外商無人機零組件或供應鏈需求，代表台灣與國際進行合作洽談，進一步深化台灣在全球無人機產業中的角色，經濟部也定期組團參加國際展覽，展示台灣無人機自製能量，促進雙邊業者合作與市場拓展，希望藉由建立海外合作管道，推動台灣無人機產品及技術進入全球市場，並增進業者之間的互相交流與合作，共同提升台灣在無人機領域的國際地位，以聚焦國際合作，配合政策方向，並帶領聯盟成員打造無人機非紅供應鏈。航空市場具龐大成長潛力，配合國機國造政策，以軍用需求帶動民用需求，建立國防產業供應鏈體系，強化軍民技術相互支應。無人機部分，從飛控系統的 AI 創新應用，到無人機關鍵模組突破，帶動相關技術根留臺灣。

2. 產業上、中、下游之關聯性：



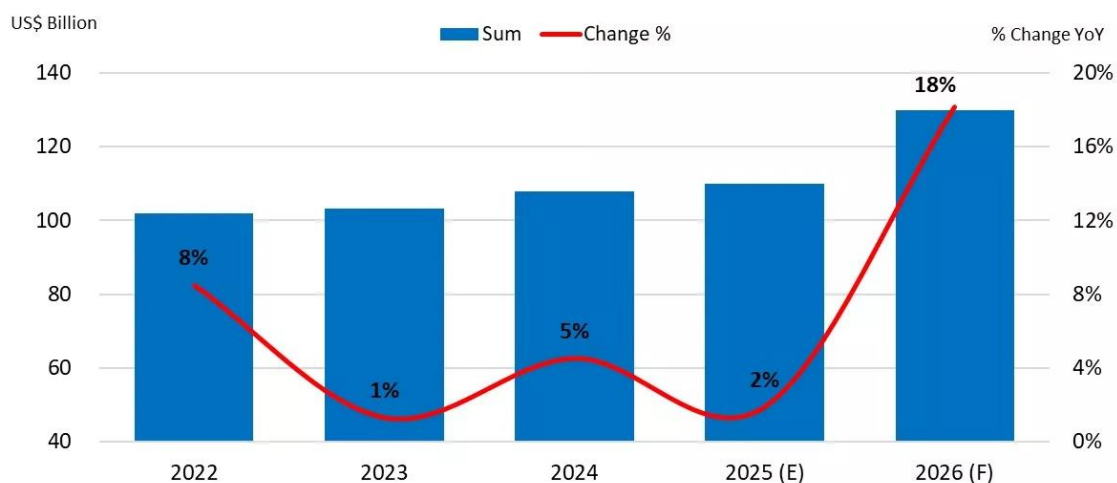


3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

現在國際工業製造業的主要發展趨勢，以數位轉型以及永續發展為兩個主要的方向。此外因應全球保護主義抬頭及區域間衝突不斷，地緣政治風險所帶來的威脅，全球供應鏈動態重組，各國將面臨打造競爭優勢和建構韌性供應鏈之挑戰，需透過調整生產布局，強化產業韌性與競爭力。工研院建議，在地緣政治的部分，貿易保護主義抬頭，可以藉由發展特色領域調整全球生產布局，擴大與國際企業的合作，強化產業韌性與競爭力；在產業 AI 化方面，優先由製造、醫療、零售、電商等產業切入，建立產業化 AI 中心，幫助業者降低發展 AI 應用技術的門檻；面對永續供應的浪潮，要協力合作開發科學化淨零減碳方法，推動產業綠色數位雙轉型。在 AI 熱潮下，將成為引領產業成長的火車頭，拉動臺灣百工百業成長。

半導體設備發展態勢

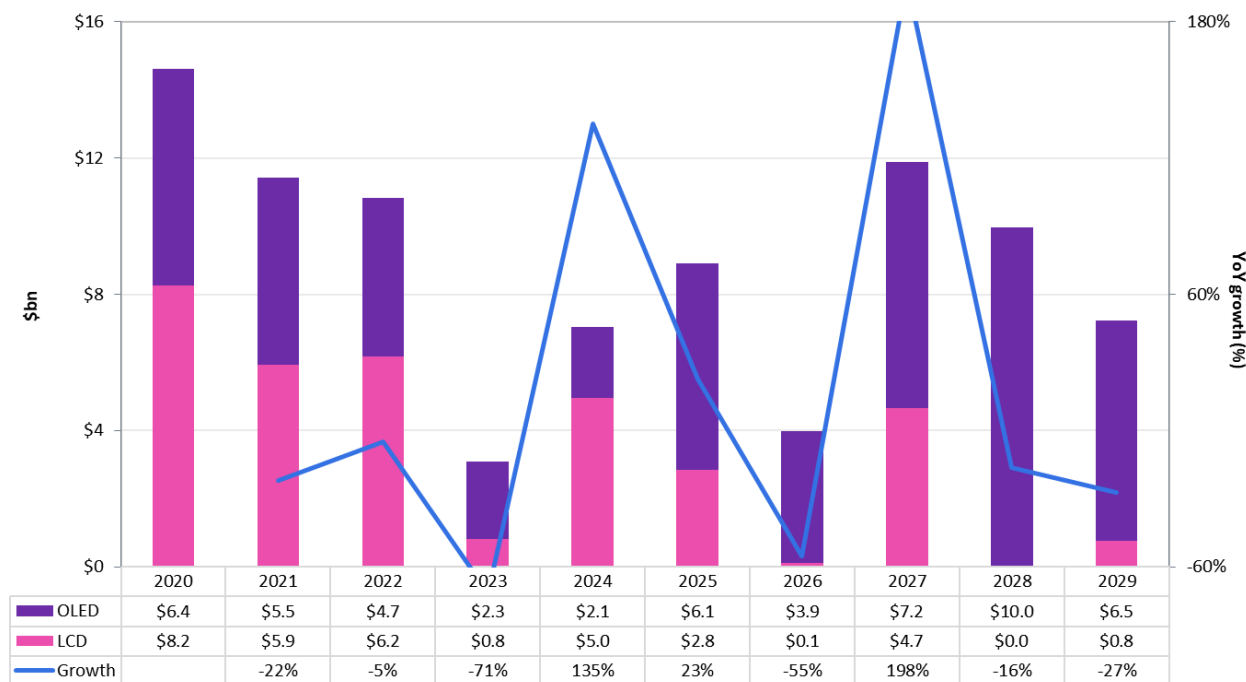
台灣半導體產業協會 (TSIA) 預期，台灣半導體業產值可望達 6 兆 1,785 億元，年增 16.2%，其中，IC 製造業產值年增幅度最大，估將首度突破 4 兆元關卡、達 4 兆 827 億元，年增 19.4%，持續為台灣半導體業產值成長的主要動能，IC 製造業產值若細分，晶圓代工產值估年增 20.1% 居冠。根據 SEMI 研究報告指出，2025 年預估將成長至 1,100 億美元、2026 年大增 18% 至 1,300 億美元，半導體製造投資估計將有連續三年的增長，這顯示出半導體業在支撐全球經濟與尖端科技創新方面扮演的重要角色。自 2024 年半導體設備展望更為光明，主要是因資料中心的高效能運算需求以及 AI 推升邊緣裝置需求帶動。直到 2026 年，台灣、中國大陸與南韓，仍是全球前三大半導體設備支出市場，而中國大陸仍居首位。晶圓廠設備支出增加主要驅動力是邏輯領域，由 2 奈米製程和背供電等先進技術投資帶動。2025 年記憶體領域支出成長 2%、達 320 億美元，2026 年成長率更將達 27%；其中 DRAM 在 2025 年支出將減少 6% 至 210 億美元，不過 2026 年將成長 19% 至 250 億美元；NAND Flash 支出則將大幅復甦，2025 年估成長 54%、達 100 億美元，2026 年續增 47%、達 150 億美元。展望未來，SEMI 預期晶圓廠設備銷售 2026 年主要動能是先進邏輯製程與記憶體應用。台灣在晶片廠持續加強先進技術和生產能力領先地位，2025 年及 2026 年投資額預計分別達 210 億美元和 245 億美元，以滿足跨雲端服務和邊緣裝置領域不斷增長的人工智慧應用需求。



資料來源：SEMI World Fab Forecast Report

顯示器設備發展態勢

根據 Omdia 研究報告指出，隨著製程技術的重大進步和應用範圍的不斷擴大，OLED 面板出貨量預計將在 2025 年首次超過 10 億片。這些面板將為各種設備供電，包括 OLED 電視、智慧型手機、智慧型手錶、VR 耳機、平板電腦、筆記型電腦、顯示器和汽車顯示器。同時隨著韓國業界領導者和中國挑戰者爭奪技術和生產能力的主導地位，OLED 市場的競爭也日益激烈。在地緣政治議題和關稅挑戰中，顯示器製造商和 OEM 供應鏈正在重塑其全球製造策略。目前，越來越多的 LCD 和 OLED 後端模組在東南亞生產，而東協和南美國家在液晶電視組裝領域的重要性日益凸顯，同時中國正採取新措施刺激國內顯示器需求。大尺寸電視顯示器和公共顯示器市場的成長，預計 2025 年 85 吋及以上電視和公共顯示器的出貨量將成長 34%，而 100 吋以上液晶電視顯示器的出貨量預計將在 2025 年首次超過 100 萬台。隨著汽車產業向軟體定義汽車轉型並擁抱智慧移動，汽車顯示器和人機介面的作用正在迅速發展，其發展取決於技術進步與成本效率和市場需求之間的平衡。除了技術之外，確保產品品質、穩定的產品價格、生命週期穩定性和長期協議有助於製造商滿足行業標準、保持可靠性並建立持久的合作夥伴關係。根據 GII 分析報告指出全球顯示設備市場規模 2024 年至 2031 年的預測期內複合年增長率為 5.3%，2031 年將達 2,316 億美元。



資料來源：Omdia

自行車生產設備發展態勢

美國和歐盟市場對台灣自行車製造商來說意味著巨大的機會。受人們健康意識增強、環境問題以及對永續交通的偏好日益增加等因素推動，海外對自行車的需求強勁。而東南亞市場受可支配收入增加、城市化進程加快以及人們對騎自行車的健康和環境益處的認識不斷提高等因素的推動，東南亞自行車市場正在快速增長。這對台灣自行車製造商來說是一個擴大影響力、進入新興市場的重大機會。隨著節能永續趨勢環保意識提升，電動載貨自行車（E-cargo）逐漸成為物流運輸的關鍵解決方案之一。E-cargo 結合電動輔助驅動系統與靈活的載貨設計，不僅能有效降低碳排放，更能適應現代城市對於短程配送的需求，E-cargo 成為城市中短距離配送的理想工具，另外在車款規格上，E-cargo 相較於一般 E-bike 亦有顯著規格差異，差異主要體現於車架設計、載重量、電池容量、電機系統與續航力等方面，規格優化也使整體 E-bike 市場產品組合優化，整體產業轉往高值化發展。近年來公司產品朝高值化發展，持續在自動化設備投資與製程改善研發，並重新思考定位策略和努力轉型，在不斷努力研究創新後，已朝向高附加價值的設備發展，並創造公司發展新契機。

航太製造產業發展態勢

隨著疫情後全球旅遊需求回升，航空公司開始擴大機隊規模，帶動飛機製造與維修產業發展。Airbus 與 Boeing 兩大航空巨擘，持續增加單走道客機訂單，顯見民用飛機的市場需求仍在成長。尤其隨著全球航空需求的持續擴大以及航空技術的更新換代，航太產業對高精密機械設備的需求不斷攀升，然而全球航太產業面臨不少挑戰，罷工、生產限制、零件短缺、勞動力不足，讓歐美主要供應鏈難以滿足市場需求，供應鏈去歐美化的趨勢越來越明顯，歐美航太企業不再依賴傳統供應鏈，而是積極分散風險，擴大在印度、亞洲等地的採購規模。公司產品發揮其在精密機械製造方面的技術優勢。在航太領域的產品不僅在品質和精度上具備優勢，還能根據市場需求提供定制化的智能解決方案，持續擴增發展競爭力。

我國設備業SWOT 競爭分析

(1) 優勢 (Strength)

- A. 國內精密產業價值鏈建置完整，對全球產業朝工業 4.0 發展，具相對優勢能量。
- B. 國內製造彈性及品質，較主要競爭者仍有相對優勢。
- C. 本土廠商具有維修服務速度快、溝通方便，可爭取國內市場商機。
- D. 電子及航太產業設備驗證期間長，故形成市場寡佔，進入障礙高。
- E. 旭東公司機台設備，已成功導入相關產業國際大廠，擁有實績及多年經驗與技術。

(2) 劣勢 (Weakness)

- A. 光電產業發展進入成熟期，對設備業者的拓展不利。
- B. 製程設備的新產品開發學習曲線長，替換新設備廠商考量相對嚴苛。
- C. 較缺乏製程驗證能力及機會，在新市場應用缺乏實績。
- D. 低價供應商的競爭，國內多為中小企業，研發經費較為不足。

(3) 機會 (Opportunities)

- A. 國內光電廠商及自行車廠面臨競爭壓力，故積極尋求技術本土化及差異化發展。
- B. 國內半導體產業聚落完整，市場需求緊密與開發步調快速，供應鏈策略合作，進而搶占市場商機。
- C. 新興國家市場開拓，包括東南亞、歐洲及美洲國家。
- D. 新世代設備體積龐大，搬遷運輸不易，故有在本土組裝、測試之必要。

(4) 威脅 (Threats)

- A.大陸韓國垂直整合能力佳，供應鏈朝向在地化發展，採用低價機種競爭。
- B.國外設備商降價銷售打壓新開發廠商，面臨競爭對手學習強勢崛起。
- C.產業景氣循環快，設備需求變化大，研究開發挑戰高。
- D.匯率、關稅及貿易戰，海外市場的競爭力弱。

(三) 技術及研發概況

1. 最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用：

單位：千元

年度	113年度	114年度截至4月30日
研究發展支出	271,281	64,679
營業額	1,822,989	383,602
研究發展支出佔營業額比例	14.88%	16.86%

2. 開發成功之技術或產品：

(1) 技術項目

技術項目	具體效益
複合光學量測系統	關鍵尺寸量測，薄膜厚度量測、薄膜應力量測，微奈米等級的高度測量。
複合軟體整合技術	開發製程參數管理、檢測軟體、產品生產資訊、機台狀態、客製化介面設計等功能，提升設備服務化能量。
節能設計技術	整合機、電節能系統設備設計，建置系統整合能力，提供製程設備平台應用需求。
高效能影像縫合技術	影像從傳送到電腦後，進行圖像縫圖與偏移補正，經由快速二值化找出邊緣有特徵處，進行小區域特徵補正縫接，達到即時縫圖效果。
AI應用模組技術	不同的影像在 AI 自動檢測應用上套用不同的深度學習模型來作推論應用框架，並透過中控管理平台進行資料處理，滿足符合多樣性產品使用。
智慧化路徑規劃技術	針對場域自動動態避障，無人化充電、車隊調度應對複雜環境，高精度定位，車隊協同應用，提供即時監控與數據分析，支持遠程調度與決策，滿足倉儲搬運的全自動化與智能化。
自動化專用管材規劃製程技術	針對高階專用管件的製程加工，依據圖片加工資訊，自動化進行路徑與彎管規劃，並結合機器人控制系統，進行點位校準，達到產業應用需求。

(2) 產品項目

產品項目	具體效益
晶圓光學顯微鏡自動檢測設備(全檢機)	<ul style="list-style-type: none"> 研發全自動光學晶圓檢測設備，提供抽檢與全檢功能，及具備全自動化傳送系統，自動缺陷分類，結合製程參數管理、檢測軟體、產品生產資訊管理、機台狀態管理、人性化客製化介面設計，支援SECS/GEM通訊，提升設備服務化能量，滿足產業最先端的半導體晶圓應用良率控管需求。
雷射光罩缺陷檢查設備	<ul style="list-style-type: none"> 研發針對光罩的表面缺陷檢測，具備全自動化傳送系統，提供光罩正面及背面檢查，並將檢測結果依照表面缺陷等級自動分類。
次世代晶圓盒自動包裝設備	<ul style="list-style-type: none"> 研發低碳節能設備設計的全自動晶圓盒包裝系統，客製化多複合功能系統整合，整合包裝袋模組、標籤模組、濕度卡模組、乾燥劑模組、熱封模組、真空及充填氮氣模組、包裝品質檢測。積極建置自動化製程系統技術持續創新能力，建立完整產業供應鏈體系。
自行車產業智慧機器人解決方案	<ul style="list-style-type: none"> 研磨拋光模擬路徑生成，導入工研院開發之CPS機器人模擬器-EzSim，複製工研院協助水五金業者進行產業升級成功經驗，並擴散至自行車產業

(3) 公司計畫開發之新商品(服務)：

目標產品名稱	主要目標
晶圓光學顯微鏡自動檢測設備	研發全自動晶圓檢測設備，提供高精度全區域量測，具備自動缺陷分類，全自動化傳送系統，結合製程參數管理、檢測軟體、產品生產資訊管理、機台狀態管理、人性化客製化介面設計，支援SECS/GEM通訊，提升設備服務化能量，滿足產業最先端的半導體晶圓應用良率控管需求。
晶圓表面微奈米量測設備	大面積的晶圓厚度測量功能，微奈米等級的高度測量，微奈米級表面粗糙度量測功能，具區域抽樣量測與全面量測功能，滿足客戶基板產品的產線量測需求
先進封裝探針量測設備	具備高解析度與高景深2D及高量測範圍3D光學量測系統，檢量測項目包含針尖/導版及電子元件檢測，產品生產資訊管理、機台狀態管理，數據可視化達到自動數據儲存、上報及分析。
基板熱翹取量測設備	研發針對基板的溫度變形量，並設計符合客戶要求的升溫及降溫曲線控制，建立量測熱影響變形量，滿足客戶基板產品的產線全檢需求，提升建置高階產品出貨品質控管能力。
雷射光罩缺陷檢查設備	研發針對光罩的表面缺陷檢測，具備全自動化傳送系統，並將檢測結果依照表面缺陷等級自動分類。
晶圓載具倉儲自動化物流系統	結合AGV/AMR & Stocker串連，整合上下游，全自動晶圓載具包裝及拆包，提供智慧化自主導航，高效自動運輸，並實現與客戶MES等垂直系統的深度聯動，滿足客戶多元化和高度客製化的需求，助力客戶打造最符合效益的智慧工廠。
晶圓載具包裝系統	研發低碳節能設備設計的晶圓盒包裝系統，整合機、電、軟、光進行低碳節能系統設備設計，客製化多複合功能系統整合，包裝品質自動光學檢測，提供半導體高精度製程設備平台應用需求。
次世代顯示器檢量測設備	開發高精度2D量測功能及多樣化檢測形狀與區域檢查，提供客戶產品全面檢測與量測功能，量測能力具關鍵尺寸量測，偏移量測，數量檢測功能。

邊緣運算檢測系統	開發檢測系統的邊緣雲端架構，建立影像辨識管理平台及針對客戶多樣性產品的AI辨識軟體，滿足產業最先端的應用控管需求。
自行車產業智慧機器人解決方案	開發管件拋光研磨智慧機器人系統，具備CPS智慧機器人虛實整合技術，提供自動化研拋路徑的規劃，建置自動化製程系統技術。
散熱循環管件設備	開發高階散熱專用管材的製程加工，具備智慧化彎管及路徑的規劃與共通精密治具的設計，進行產業供應鏈升級。

(四)長、短期業務發展計畫

旭東公司耕耘兩岸機械設備業多年，在此波貿易戰衝擊中受到重大影響，為維持公司穩定永續發展以及秉持核心能量根留台灣的一貫經營策略。在數位轉型、永續發展兩大全球浪潮下，也積極調整經營策略，配合政府獎助輔導措施，擴大回台投資佈局，投入高端前瞻設備的研發，培育關鍵技術人才，佈建鍊結未來台灣產業發展的策略藍圖。

主要從事自行車、半導體、平面顯示器、金屬加工、航太及醫療產業等自動化設備與精密機械之研發、設計及製造，從基礎生產設備，技術轉移，技術諮詢到整廠規劃，為客戶提供高效，高度整合的客製化支持，憑藉最新的市場趨勢保持競爭力，努力滿足客戶的需求及了解生產情況。積極塑造公司成為產業發展體系中重要策略夥伴地位，成為全球頂尖的製程設備商。短期發展自動化、智慧化製造應用方案，保留充分彈性資源以因應外部環境變化風險；展望中長期，外部環境趨穩與傳統典範轉移，落實企業誠信經營，配合各國產業政策的法規與標準，進而在長期競爭中續保優勢，將成為企業轉型突破的契機，無論是AI的發展、電動車的滲透，或節能訴求應用趨勢，勢必加大布局耕耘中長期成長動能，將是全球分散布局與掌握價值體系之關鍵，提升開創新局機會、維持優勢。

1.短期發展計畫

(1) 行銷策略方面

- 加強完善的售後服務體系及資訊管理系統，提升售後服務品質，鞏固與客戶端的供應關係。
- 蒐集新市場訊息，前進偏遠但經濟潛力不錯的地方。如：亞洲、中亞、中歐、南美、印度...等。
- 重點商訪與展覽活動，加強網路亮點資訊，重點參展加強曝光率。

(2) 生產政策方面

- 持續改善生產管理，提高採購效率，充分掌握原物料動態。
- 強化衛星加工體系，強化彈性調度加工生產能量，改善生產作業流程。
- 推行全面品質管理政策，降低設計變更成本，改善生產成本，提高競爭力。

(3) 產品研發方向

- 積極研發新產品與持續精進，使產品多角化多功能化，以開發新市場。
- 持續深厚產品研發人力，整合機構設計、軟體開發到製造生產，以提高產品附加價值。
- 結合上、下游廠商的關鍵技術合作能量，發展關鍵性策略合作夥伴，積極研發高階產品。

(4) 營運管理方面

- 跟隨主要客戶需求及發展策略，架構全球化的布局。
- 同時兼顧高毛利的精密製程設備及低毛利高營收的自動化設備，穩固公司營收。
- 積極培訓研發、技術、業務及經營管理人才，厚植公司人力資源，強化公司競爭力。

(5) 財務管理方面

- 與金融機構建立良好關係，積極掌握金融市場脈動，提高財務規避風險能力及運用績效。
- 根據中長期資金需求計畫，在安全穩健的原則下，進行縝密短期財務規劃。
- 規劃在資本市場上獲取公司成長所需之長期資金，擴展公司之營運規模。

2.長期發展計畫

(1) 行銷策略方面

- 以多元化之產品佈局，包含半導體、顯示器、自行車及航太等各大產業，分散獲利來源及營運風險。

- 與國際領導廠商建立緊密策略合作關係，取得產品實績，進而鞏固市場客戶關係。
 - 強化與國際型代理商之合作關係，擴展產品銷售以及市場佔有率。
- (2) 生產政策方面
- 原物料的供應體系，以期自原物料採購到上線生產乃至品質檢驗、交期配合及各項流程檢驗均能順利配合需求進行。
 - 外包廠商及原物料供應商策略聯盟，確保產能及原料取得之無虞。深化外包廠商品質觀念，確保加工品質無虞，以利後續製程順利進行，配合交期準時出貨。
- (3) 產品研發方向
- 結合光學、機構、電控、軟體、製程的研發能量及系統整合能力，拓展應用於主流產業之關鍵生產設備。
 - 機器視覺檢測技術在光電產業及大量生產的產業應用，結合客戶端實際產線需求，共同研究開發專用設備。
 - 積極導入人工智慧元素與低碳節能技術，強化智能設備的發展。
- (4) 營運管理方面
- 持續人員各階段培訓，提升工作效率及專業技能累積。
 - 建立安全舒適之工作環境，使員工能安心發揮所長。
 - 完善的福利及管理制度，秉持永續經營的理念，建立企業文化，凝聚公司團隊向心力與目標。
- (5) 財務管理方面
- 規劃現金流量，搭配金融機構之貸款、募資及營業活動資金之控管，確保未來所需資金之充足。
 - 公司全面性財務規劃，以降低營運風險，提升市場競爭優勢。
 - 配合政府相關計畫，獲得政府補助開發及租稅減免，並申辦政府低利研發貸款。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 主要商品(服務)之銷售(提供)地區：

單位：新台幣千元

銷售地區	112 年度		113 年度	
	銷售淨額	銷售淨額	銷售淨額	比例
內銷(註)	1,304,628	80.18%	1,053,437	57.79%
外銷(亞洲)	251,325	15.45%	518,979	28.47%
外銷(其他)	71,200	4.37%	250,573	13.74%
合計	1,627,153	100.00%	1,822,989	100.00%

註：內銷係指本公司銷售予台灣當地客戶、大陸公司銷售予大陸當地客戶

2. 市場占有率：

- 地緣政治風險、極端氣候的實體風險居高不下、通貨膨脹與金融不穩定風險，如服務業通膨仍高，以及中國各種製造業不能丟和長期不公平的製造業補貼政策，中國部分產品低價傾銷全球，加劇與西方和新興市場的貿易關係緊張。第二次美中貿易戰鐘聲已被敲響，歐盟和加拿大對中國也升起關稅旗幟，尤其川普 2.0 對外關稅戰。IMF 示警，貿易保護主義恐使全球經濟朝不樂見的方向邁進，通膨危機可能再現。因應可能的區域衝突和貿易緊張，供應鏈進行靈活性布局，以確保供應鏈的韌性、加速產能分散，積極佈局智慧製造系統整合、發展利基型產品、提升整體附加價值，同時兼顧高毛利的精密製程設備及低毛利高營收的自動化設備，穩固公司營收。
- 積極佈局半導體設備，跟隨主要客戶需求及發展策略，技術創新是半導體產業的立身之本，持續加大研發投入，特別是積極布局下世代半導體技術，為長期發展奠定基礎。面對複雜多變的地緣政治環境，需要採取多元化的策略，並積極尋求國際合作，除增加夥伴間的技術互補性之外，並確保供

應鏈安全與韌性，整合智慧系統自動數據雲端儲存分析等功能，滿足智能產線智動化之需求，隨著客戶征戰全球，為客戶升級智能化、產線優化，助益客戶更添戰力。在綠色製造趨勢下近年來佈局半導體先進封裝製程自動化設備與檢量測設備有成，並切入利基市場，逐步展現深耕半導體檢量測領域之成效，積極佈建下一波競爭優勢的關鍵能量。

- 在智慧機械基礎上發展，結合新興的 AI、機器人等新興技術，整合資通訊與 IC 製造生態系，以關鍵模組技術與產品切入機器人供應鏈，再搭配豐富的資通訊系統整合實績，發展相應的機械零組件、設備與製造應用方案，使產品多角化，以開發新市場，公司營業重心將積極切入系統級客製化設備，並積極將核心技術能量擴展至產業製程專用設備，提供高附加功能的整合性方案，積極開拓市場利基。
- 勞動人口不足情形嚴重，啟發製造業思考建構更具韌性的生產體系，機器人可自動化執行高危險性的製程，有助降低職業災害，也可彌補產業就業人口不足。透過高度客製化、分散式生產方案以滿足製造需求，並針對半導體、航太、能源等產業，善用產業群聚完整的優勢，透過結盟合作，推出符合應用場景的解決方案，爭取國際市場機會，進而開發新的藍海市場，立足台灣、佈局全球、行銷全世界。

3. 市場未來之供需狀況與成長性：

根據台灣經濟研究院對於 2025 年經濟成長率的預測數據可知，經濟成長仰賴內需支撐，外需亦重回經濟成長主力。在外需方面，隨著資通訊產品基期逐步墊高，出口增速或將趨緩，惟近期外銷訂單仍顯示新興科技需求強勁，加上全球多國已開啟降息循環，2025 年全球貿易量可望續增，傳統產業亦有望緩步復甦，推動台灣外需穩健成長。內需方面，零售及餐飲銷售額年增率持續穩定成長，加上就業市場依舊穩健，失業率維持低位，實質經常性薪資年增率自 2024 年轉正，預期此趨勢將延續，為民間消費提供支撐，惟比較基數已高，成長漸緩。投資部分則受惠於新興科技需求強勁帶動，自 2024 年下半年起半導體設備購置需求大幅成長，機電設備進口值維持高檔，國內晶片領導廠商擴大資本支出、加速淨零轉型投資，並吸引國際大廠加碼在台投資，估計續為經濟成長帶來正貢獻。整體而言，受比較基期影響，2025 年台灣經濟成長呈現前低後高。展望未來，全球經濟仍將面臨諸多不確定因素，例如川普新政、各國央行貨幣政策走向、中國經濟刺激政策，以及國內投資動能等。因此，根據台經院最新預測結果，2025 年國內經濟成長率為 3.42%。展望 2025 年，全球經濟仍將面臨諸多挑戰，其中又以美國川普新政、各國央行貨幣政策未來走向、中國經濟刺激政策之成效，以及國內投資動能能否延續等最為關鍵，不僅影響台灣出口表現，也透過金融市場及進口物價影響台灣內需及消費，值得加以關注。

半導體高階製程與伺服器需求強勁，隨著全球地緣政治風險不斷升高，從貿易戰到科技戰，高階晶片的管制出口政策，低價傾銷，以及關稅壁壘等等因素，半導體供應鏈與市場正在進行區域性的重組，各國開始追求晶片自主製造的情況下，國際政治情勢的瞬息萬變，將為半導體產業同時帶來機會與風險。根據 TSIA 的預測資料，2025 年台灣半導體業產值將達 6 兆 1785 億元、年增 16.2%，優於全球市場的 11.2%。根據 SEMI 研究報告指出，預測 2025 年將增長 1,232 億美元，2026 年將成長 11% 至 1,362 億美元，2027 年將再增加 3%，攀抵 1,408 億美元。2025 至 2027 年間，合計將支出逾 4,000 億美元。中國大陸未來三年料將投資逾 1,000 億美元，仍是全球 12 吋晶圓廠設備最大支出國。但報告也說，中國大陸的支出將從今年創紀錄的 450 億美元逐漸下滑，2027 年降至 310 億美元。南韓為鞏固動態隨機存取記憶體、高頻寬記憶體和 3D 儲存型快閃記憶體等記憶體領域的主導地位，未來三年將合計支出 810 億美元，位居第二。台灣未來三年對 12 吋晶圓廠的設備支出為 750 億美元，居第三。

半導體產業正處於關鍵時刻，擴產投資正在推進先進與主流技術的發展，以滿足不斷演進的全球產業需求。生成式 AI 與高效能運算，正在推動先進邏輯與記憶體領域的進步，而主流製程則繼續支撐汽車、物聯網和功率電子類別等關鍵應用。2025 年即將啟建的 18 座新半導體廠，晶圓代工供應商仍將

是半導體設備採購的領頭羊，晶圓代工類別產能預計年增 10.9%，將從 2024 年月產 1,130 萬片成長至 2025 年創紀錄的月產 1,260 萬片晶圓。記憶體別整體而言產能擴張則走向穩定緩和路線，2024 年成長 3.5%、2025 年成長 2.9%。然而，強勁的生成式 AI 需求已經席捲記憶體市場，帶來重大變化。高頻寬記憶體(HBM)出現大幅成長，為 DRAM 和 NAND 快閃記憶體部門帶來不同的產能成長趨勢。DRAM 類別將持續走強，到 2025 年將與去年同期比成長約 7%，達月產 450 萬片晶圓。3D NAND 裝置容量相對之下也有 5% 的漲幅，達同期月產 370 萬片晶圓。

2025 CES 主要大廠顯示技術發展趨勢，Mini LED、Micro LED、OLED 顯示技術及各式各樣顯示新興應用，仍持續驅動顯示器產業升級轉型。價格與需求在經濟不確定下進行動態競爭，廠商須靈活規劃產能與供應鏈，而地緣政治風險升溫，帶動顯示器產業生產基地布局趨於多元化。展望 2025 年，廠商亟需兼顧風險分散與成本效益，以提升獲利與競爭力。近年來台灣面板大廠積極轉型，以減少產業景氣循環所帶來之衝擊，在轉型過程中順勢進行產線產能之調整，淘汰老舊及效率不佳之廠房，將資源集中至高值化產品及非面板領域之佈局，且將產業轉向提升高階 IT 面板占比，以及加大布局高附加價值的車載及醫療等利基型面板，亦積極投入衛星天線、太陽能案廠管理及扇外型面板級封裝等非面板領域之佈局，針對次世代技術 Micro LED 則是積極參與並未淡出顯示器面板市場。

資策會預測在全球對健康與環保的重視下，自行車逐漸成為兼具運動、休閒與交通功能的重要工具，自行車產業正迎來軟、硬體整合的嶄新時代。過去自行車的創新重心集中在硬體層面，如避震系統的改良、車架材質的輕量化，以及流線設計的優化等技術突破，現在有愈來愈多的自行車和科技廠商將目光轉向自行車硬體和軟體技術的應用與整合，為騎行體驗注入更多可能性。科技驅動下，多項創新技術正在改變自行車運動的面貌，特別是電動輔助自行車的產業發展已呈現明顯的智慧化、加值化趨勢。透過運動數據的蒐集與分析，可實現高度個人化的訓練方案，或結合即時互聯技術提升騎行的安全性與便利性，使得軟硬整合成為自行車運動科技的核心發展趨勢，科技已快速改變自行車運動的產業格局，軟硬整合的趨勢不僅提升騎行體驗，未來自行車將成為結合健康促進、環保理念與科技創新的典範，也為產業注入新的活力。

近年應用市場投資趨緩與中日夾擊下，台灣機械業遭逢競爭壓力，所幸全球半導體、航太、能源等產業需求增溫，皆可帶動機械設備需求回升，對此工研院估台灣機械業預測 2025 年產值可增至 11,224.1 億元，年增率 3.7%。生產設備、彎管設備、異形管雷射切割設備、研磨設備等專用加工設備，發展智慧、綠色轉型與節能永續，環保節能融入商業模式中，特別是加速導入 AI。AI 應用正重塑全球製造業的格局，深化智慧製造技術，不僅能提升加工品質與流程效率，也可望進一步解決缺工常態化的現實困境，缺工趨勢是必然的，降低繁瑣事務的時間，讓機器人自動化處理，讓人能專注在管理決策。隨著新技術的飛躍成長，智慧工廠的配置，讓人力資源發揮最大價值，未來銷售將以低價產品和高價產品區隔的機種 並開發新興產業應用機台為主，以更環保的生產和節能措施來走向綠色製造產業，適應國際政經環境的變化。

航太產業面對國際供應鏈調整和新興科技需求，其中關鍵零件與引擎製造成為台灣航太出口的亮點，航太產業的製造趨勢朝向輕量化、高強度與高耐久性發展，無論是飛機引擎、渦輪葉片、結構部件，甚至是新興的航太 3D 列印技術，都對材料有更高要求。而全球對環保要求的提升，航空業正朝著碳中和目標邁進，電動飛機與氫燃料技術成為研究熱點。這不僅改變了航空器的設計，也影響了整體供應鏈的生態。在這樣趨勢下，現代國防需求推動了新型武器與系統的開發，無人機技術的普及和低軌衛星的應用深化，透過技術創新與國際合作，將持續引領全球未來產業趨勢。

4. 競爭利基及發展遠景之有利與不利因素與因應對策：

(1) 掌握領先業界之光、機、電、軟多項核心技術

- 超高精度機構設計能力

本公司多項新設備已經通過顯示器產業與半導體產業客戶認證。其精度達製程設備要求，亦可運用其他加工、光電、航太等產業設備，產品線廣度自可擴增。

- 卓越的控制系統及軟體服務

本公司擁有自己的軟體及控制系統研發團隊，可即時滿足客戶各項需求，具有以下優勢：

- a. 彈性佳：提昇設備性能價值，或是客戶的需求皆能有相對的配合，具彈性應變調整之競爭優勢。
- b. 自主性高：核心能力由公司自行建立，依實際需求設計，內部快速溝通。
- c. 反應迅速：針對任何問題及需求，提供即時反應、迅速服務。
- d. 成本低：本公司擁有自己的軟體及電控系統研發團隊，無須委外處理，不論於金錢成本及溝通時間上，均具競爭力。

- 高度智慧化軟體設計能量

- a. 自動化控制軟體：建構於PC BASE 與PLC BASE下之控制系統。
- b. 人機介面控制軟體：作為使用者與設備間溝通介面工具。
- c. 系統分析及整合技術：分析整合設備於生產過程中產生資料。
- d. Multi Thread 多工處理技術：可同時平行處理多種程式演算，提升作業效率。
- e. Real Time 即時控制技術：即時偵測機台動作及狀況，並回報資訊予使用者。
- f. 物流與資料流設計技術：可由設備即時進行資料流管理。

- 完整機器視覺解決方案

公司已建立滿足多樣化、客製化視覺需求技術，包括視覺辨識、視覺定位、視覺檢測等核心技術。技術團隊擁有光電視覺硬體設計能力、影像處理程式設計能力、演算法開發、視覺檢測辨識、視覺定位技術，並自行開發視覺軟體及 AI 應用技術，製程技術支援與修改自主性高。

- 多元化的自動化應用技術

自動化應用包括物流系統針對自動動態避障、無人化充電、高精度定位、車隊協同應用，提供即時監控與數據分析，支持遠程調度與決策，滿足全自動化與智能化。具備自主的設計能力及多年的設計經驗，並與單機設備設計垂直整合，可快速研發設計，滿足客戶多元的自動化應用需求。

- 產品線完整，可規劃客製化生產線

擁有系統整合能力、多項設備製造之關鍵核心技術與零組件來源，產品線完整，可滿足客戶完善設備規劃構想、一次購足或整合整線操作介面，從單機自動化、整線自動化、整廠自動化與跨廠之智慧工廠。

- 完善服務網，服務據點在地化

時間等於是高科技業者的命脈。因此不論是新機台交機、定期設備調校或維修保養，本公司為提供客戶即時服務，分別於總公司、外埔、科學園區及大陸昆山設置專責客服團隊，就近服務鄰近之客戶，服務效率及成本具相對優勢。

(2) 不利因素及因應對策

- 跨入新設備領域的門檻較高，高科技廠商對採用新進廠商設備或新研發設備，觀察期與實績是業者採購相當大的決定因素，因此在新設備的研發與新市場的開拓，往往需要強的耕耘與合作來取的客戶端的信任，相對成本較高。

因應措施：旭東公司積極建構領先業界之光、機、電、軟研發技術能力，開發出創新技術，並以客戶需求為導向，將研發統合觸角延伸至客戶的製程改善、未來新世代製程需求

設備以及能大幅降低成本之替代機會；以全方位的實力，直接參與產業鏈創新應用的關鍵角色。期許能成為世界級大廠製程研發重要夥伴，並與全球領導廠商共同建構產業完整供應鏈與價值鏈，創造多元的附加價值。

- 產業具有景氣循環的特性，加上製程變化速度快，如何提供客戶高效率、高品質服務是設備供應業者的一大挑戰。設備使用客戶不單只是重視性能、成本要求，還必須因應產業環境變遷而造成需求的改變。

因應措施：為達成客戶多變的需求，有必要從研發、生產、銷售、服務等各領域扮演重要角色，藉由情報工具的應用，可節省時間的浪費及手續的簡化。此外正確將交期與設備資訊傳達給客戶，是提昇客戶滿意度的關鍵。若能符合客戶服務的高品質要求，對公司內部經營也有助益。

- 地緣政治挑戰，美國的不可預測性及課徵關稅，將帶給公司進一步衝擊的挑戰。即使回流、友善外包和近岸外包，傳統的通路合作夥伴模式和聯盟關係也可能被顛覆。區域衝突和戰爭的延長會進一步影響重要物資和庫存的流動。

因應措施：為滿足產業的多變需求計劃，公司需更加靈活並調整供應鏈和採購合約及定價條款，達到節省時間及減少手續浪費，密切掌握市場需求動向與客戶端生產狀況，配合隨時進行公司內部產能上的調配，可有效降低庫存、採購、管理成本等效益。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之重要用途

專用設備部門	
產品項目	主要用途
輪圈組裝設備	1.輪框與鋼絲及銅頭組裝製程 2.鋼絲鎖緊及鋼絲張力與輪框偏擺製程 3.組裝後輪圈偏擺的校正製程
車架生產設備	自行車各類金屬管材的製程加工與組裝。
前叉生產設備	自行車各類金屬管材的製程加工與組裝。
彎管機	各類金屬及管材的成型製程加工。
3D 異形管雷射切割設備	自行車架異形管雷射切割製程加工。
拋光研磨設備	自行車架異形管拋光研磨製程加工。
散熱循環管件設備	高階散熱專用管材的製程加工。

電子設備部門		
產品種類	產品名稱	主要用途
顯示器設備	PCB Bonder In-Line System	運用於 TFT-LCD、OLED、E-PAPER。
	LCM JI In-Line	We provide total solutions for LCM JI in-line equipments。
	Laser short ring cut	High Cutting Accuracy for TFT-LCD, Combine Cutting with AOI。

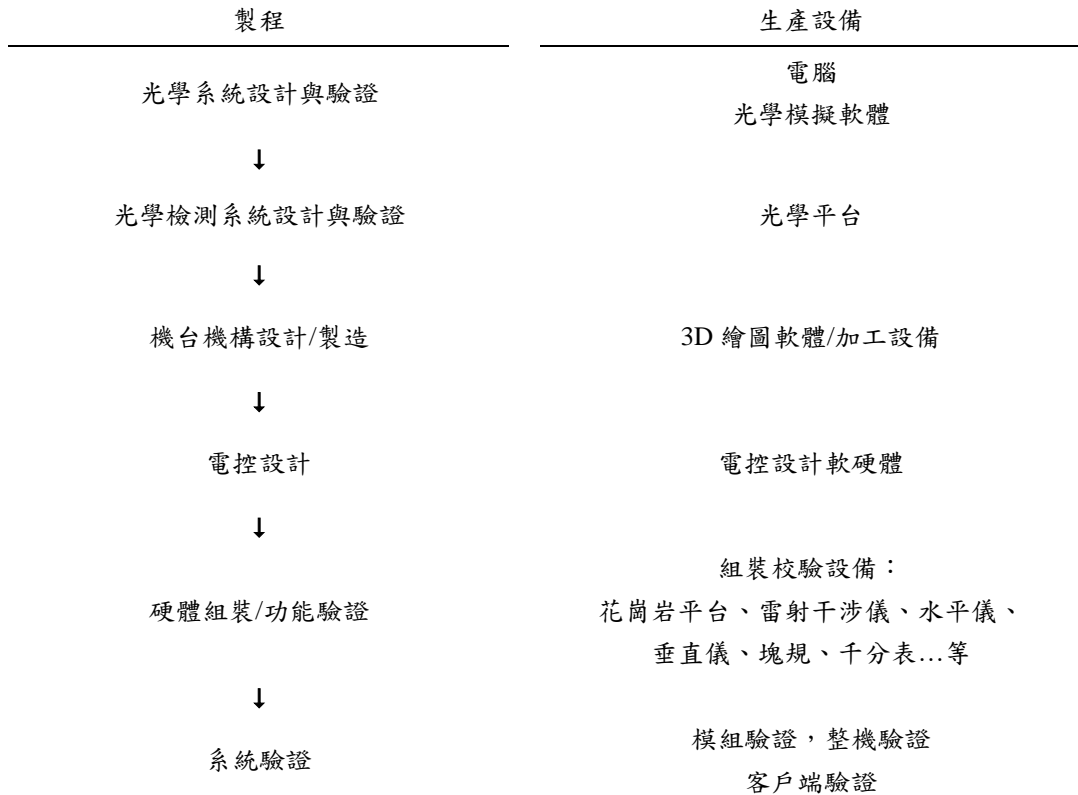
電子設備部門		
	Auto Laser Repair	High Stability Fully Automatically Repairing System for TFT-LCD.
	Automatic Laser Scribing System	High Stability Fully Automatically Laser Scribing System for TFT-LCD.
	Lead Check AOI Equipment	檢測 Micro Led 面板導電粒子之數量與精度。
	Dispenser	將 UV 膠材以定量的方式塗布在要求之區域範圍內，並完成塗膠位置膠體之固化。
	ACF 貼附機	適用於將 ACF 貼附於基板上，可運用於 TFT-LCD、OLED、E-PAPER。
	FPC 貼附機	適用於將 FPC 貼附於基板上，可運用於 TFT-LCD、OLED、E-PAPER。
	PCB TEST	Light-on test after PCB bonding。
	Glass Automatic In-Line	應用於多種尺寸玻璃製品的全自動傳輸系統
半導體設備	MEMS IC Packaging System	Flexible production, Devices that can be connected in series or independently. automatic dispensing + AOI + Cap Mount function, flexible design allows the machine to be equipped with front and rear automatic loading/unloading, satisfying the customer's production line needs.
	Auto Unpacking	Semiconductor wafer manufacturing, packaging, testing and related industries. Applicable for wafer/IC shipment and inter-factory transfer. Optional single or double layer unpacking. FOUP/FOSB、Reel、Tray、HWS 及 Carton. Applicable Packaging Bags: Aluminum Bags, Antistatic Bags, Transparent Bags
	Auto Packing	Semiconductor wafer manufacturing, packaging, testing and related industries. Applicable for wafer/IC shipment and inter-factory transfer. Optional single or double layer packing. FOUP/FOSB、Reel、Tray、HWS 及 Carton. Applicable Packaging Bags: Aluminum Bags, Antistatic Bags, Transparent Bags
	Wafer Carrier Warehouse Automation System	Applicable for varies wafer shippers : FOUP/FOSB/Coin Stack/HWS/POD/Reel/Jedec Tray. AGV/AMR & Stocker performs inbound and outbound tasks between CPU、Stocker E-rack、and shipping dock according information Control system.

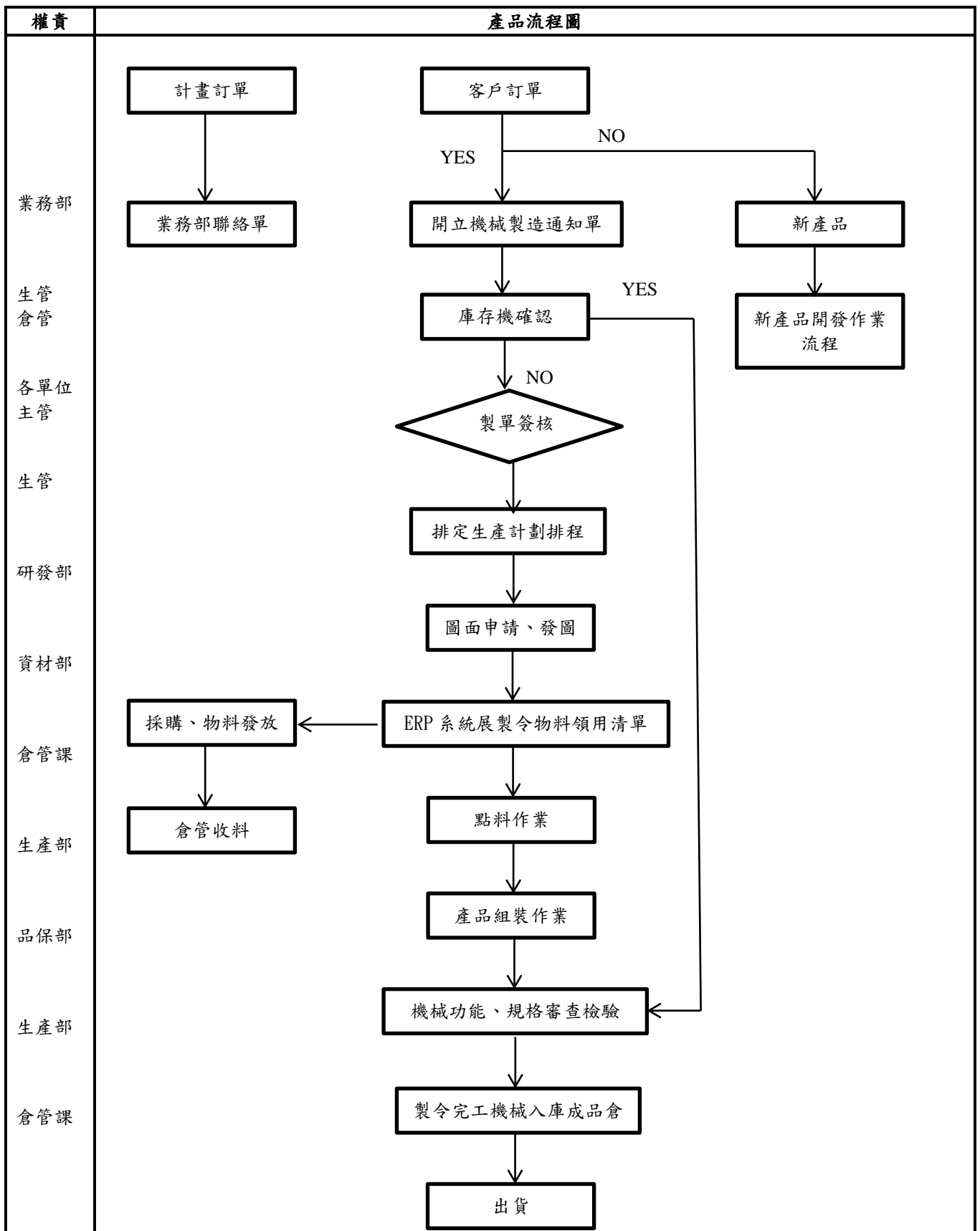
電子設備部門		
	Wafer Sorter	The infeed area has a mapping function, which allows you to know the current In the playback status, the alignment station has a wafer mark scanning function, which can know the wafer mark. The conversion method includes splitting the batch, batching, and one-to-one transmission.
	Wafer Metal Frame Tape Disassembly	The equipment can automatically remove the film for the wafer iron frame, and features the functions of detecting residual wafer, cleaning residual glue and bagging the iron frame automatically.
	Auto Laser Grooving Profile Measurement	Before dicing saw, laser Grooving 3D measurement Integrated auto loading, unloading and wafer mapping Load port design meets both 8 and 12 inch wafer ring cassette
	FOUP/FOSB AOI	Optional inspection items: dimensions, missing parts, deformations, foreign objects, etc. SEMI S2 Certifi.
	Wafer Probe Card AOIM	Measurement Item: Tip Length, Tip Diameter, Tip Alignment, Tip Planarity, Guide Plate Planarity, Screw Height, PCB components. Manually Adjust the Needle.
	Automatic Wafer Optical Microscope	Optional single or double wafer cassette automatic loading system. With dimension measurement and AOI + AI defect detection function. Auto Cover Opening
	Automatic Wafer Optical Macro Defects Inspection	Optional single or double wafer cassette automatic loading system. With AOI + AI inspection & classification. Wafer Size : 8” , 12”
其他產業應用設備	LED Wafer 導角量測	該設備主要針對 LED 原素材晶柱切割成片狀完成後，經高精度表面研磨與邊緣導角後，利用此設備進行下製程產品品質確認需求是否符合製程或出貨前產品品質確認。
	LED AOI 表面瑕疵檢查機	該設備為 Wafer 表面瑕疵檢查機用途為針對 LED 晶圓片經製程設備在晶圓片上光阻後，進行產品表面瑕疵檢查，確認產品表面之缺陷有無超出規格式樣，主要檢查 LED Wafer 表面瑕疵。
	Roll To Roll AOI	高精度 R2R 連續模式之缺陷檢測。
	Roll to Roll 貼合機	本設備為電子紙製造過程中以 R2R 的方式將四層膜進行貼合之設備，依指定的長度裁切，並依客戶指定噴墨並堆疊至 tray 盤。

電子設備部門

	Chip ID laser marking	Laser Marking which is used for chip ID marking Process °
	Tablet Laser Drilling Machine	A choice of drilling hole diameters, allowing producers the flexibility to adjust the perforation according to their needs. the machine is equipped with an automatic one-by-one inspection function.

1. 主要產品之產製過程





(三) 主要原料之供應狀況：

主要原料	供應來源	供應狀況
主軸頭	方技、怡堡、優技	良好
滑座	怡堡、國際直線、通益、上銀	良好
伺服馬達	能匠、台灣珊華、羅昇、台信、東岱、統嶺、台灣安川	良好
控制器	能匠、台灣珊華、昌德、豐筌、統嶺	良好
油壓元件	品正、群策、怡堡	良好
氣壓元件	金器、飛斯妥、品正、速睦喜、亞德客	良好
傳動元件	銓德、飛斯妥、速睦喜、品正、直得、上銀、東佑達	良好
雷射元件	銓莘科技、先鋒、基恩斯、易群	良好
鋁擠元件	寶緯、固勵、清木、浦暘、鎬億、樺皓、和麟、大榮金屬	良好

(四) 最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因。

- 最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之廠商名稱及其進貨金額與比例：最近兩年無單一供應商之進貨占全年度進貨總額10%以上之情形。
- 最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，並說明其增減變動原因。

單位：新台幣千元

項目	112 年度				113 年度			
	客戶名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人關係	客戶名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人關係
1	A 客戶	-	-	無	A 客戶	286,380	15.71	無
2	B 客戶	173,033	10.63	無	B 客戶	189,660	10.40	無
3	E 客戶	182,788	11.23	無	E 客戶	139,732	7.67	無
4	I 客戶	318,491	19.57	無	I 客戶	56,918	3.12	無
	其他	952,841	58.57		其他	1,150,299	63.10	
	銷貨淨額	1,627,153	100.00		銷貨淨額	1,822,989	100.00	

增減變動說明：A 客戶係配合其新廠需求故大幅增加資本支出，I 客戶因新廠已落成運作無太多新設備需求，故營收逐漸下滑。

三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止之資料

年 度		112年底	113年底	114年截至4月30日
員 工 人 數	直接人工	203	213	209
	間接人工	126	137	141
	業務人員	64	65	64
	管理人員	90	89	94
	研發人員	274	268	251
	合 計	757	772	759
平均年歲		35.1	35.1	35
平均服務年資		5.3	5.3	7
學 歷 分 布 比 率 %	博 士	1	0	0
	碩 士	8	11	11
	大 專	67	66	67
	高 中	22	21	20
	高 中 以 下	2	2	2

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失(包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

五、勞資關係

1. 列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

本公司為吸引及留任公司發展所需之人才，並激勵員工向心力，持續增加員工之福利，注重員工之訓練及發展；並致力於維持勞資和諧關係，自公司成立以來勞資關係互動良好，並無發生重大勞資糾紛情事。

茲針對公司各項員工福利措施、退休制度與實施情形及勞資間之協議情形描述如下：

(1)員工福利措施

勞工保險與健康保險均依據勞保局與健保局薪資投保規定辦理，注重勞工教育，舉辦在職訓練及不定期派員工參加研習。本公司訂有完善的福利措施，依職工福利金條例設立職工福利委員會，提撥福利金辦理福利事項。員工福利包括：廠醫定期健康檢查、員工婚、喪、喜、慶補助，三節禮品金及教育訓練..等。

(2)員工進修、訓練及其實施狀況

為滿足充實員工求知慾，本公司安排員工在職進修及外派訓練，並制定教育訓練辦法，使員工之學識、經驗因不斷學習進修，並隨著公司成長而紮實精進。

(3)退休制度與其實施情形

本公司依勞動基準法訂有員工退休相關制度，並就員工選擇「勞退舊制」及「勞退新制」每月依法提列員工退休準備金。

(4)勞資間之協議與各項員工權益維護措施

本公司自創立起，即採取人性化自我管理，予同仁充分之尊重與照顧，且不斷規劃各項員工福利，以追求完善之工作環境，故勞資關係非常和諧，並無發生因勞資糾紛而導致損失之情事。定期召開勞資協調會議。務使勞資雙方取得共同之認知，使各項工作順利推動。

職場平等與多元化

截至目前為止，本公司並無任何性別、種族歧視案件或是違反人權之情事。本公司於進用人員時秉持「用人唯才」原則，完全以專業能力及工作經歷為依據，不以種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、外貌、身心障礙、血型或以工會會員身分為由，予以不同考量。本公司現有身心障礙 7 人，所有員工之晉升與培育訓練皆平等，不因背景而有所差異。

(5)其他重要協議與各項員工權益維護措施情形：無。

2. 列明最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實： 無。

六、資通安全管理

旭東資訊安全管理及執行情形如下：

(一) 管理架構

由總經理所管轄資訊部負責統籌並執行資訊安全政策，於112年8月11日董事會決議通過設置「資安專責單位」及「資安專責主管」，由稽核室擬定相關內部控制程序管理每年進行內部稽核。此外會計師事務所每年依據公司現行資訊作業方式及財務報表簽證之查核需求，考量風險管理等因素，進行資訊環境風險評估與必要之控制測試，以評估公司資訊作業內部控制之有效性。



(二) 資訊安全政策

1. 維持各資訊系統持續運作
2. 防止駭客、各種病毒入侵及破壞
3. 防止人為意圖不當及不法使用
4. 防止機敏資料外洩
5. 避免人為疏失意外
6. 維護實體環境安全

(三) 具體管理方案及投入資通安全管理之資源

1. 為因應在有重大災害及突發狀況發生，而危及、阻斷資訊系統及人員的正常運作時，能有效地讓資訊系統繼續運作，以確保公司業務持續營運，訂定「系統備援及回復計劃」程序，以降低事故衝擊損害。
2. 定期針對ERP系統進行資料還原演練測試，並評估是否合於現況及本公司之營運需求。
3. 建立資訊安全事件通報機制，回應解決資安事件。
4. 使用防火牆設備控管外界與內部網路之資料傳輸並定期檢視相關日誌。
5. 定期對內部資訊設備進行防毒查核並持續進行防毒系統病毒碼與作業系統安全性更新。
6. 使用備份系統進行資料本地與異地端備份。
7. 資安防護機制持續優化，保護公司重要系統與資料安全。
8. 隨時宣導資訊安全訊息，提升員工資安意識。

(四) 列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無此情形。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
土地租賃契約	行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局	99.08.01~119.07.31	土地租賃契約	轉租、轉借或轉讓予他人，應先報經出租人同意 第8條懲罰性違約金；第15條及第17條損害賠償責任；第18條終止契約之規定
銀行團簽訂聯合授信合約	彰化銀行為主辦銀行等6家金融機構	112.12.20~118.01.22	金額新台幣15億元聯合授信契約	依契約內容規定
借款契約	彰化銀行	109.8.07~120.08.15	臺商回台投資： 分72期攤還(寬限一年) 分84期攤還(寬限三年)	依契約內容規定
人才培育	國立聯合大學 臺中市私立致用高級中學	112.01.30~本合作計畫 班級學生畢業	人才培育及產學合作計畫	
人才培育	勞動部勞動力發展署中彰投分署	114.01.23~114.11.25	充電起飛計畫	-
承攬契約	利科光學股份有限公司	113.10.18~114.04.30	機台組裝承攬契約	-
承攬契約	利科光學股份有限公司	114.01.01~114.06.30	機台組裝承攬契約	-

伍、 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、 財務狀況

(一) 最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響：

單位：新台幣千元

項目	年度	112 年度	113 年度	差 異	
				金 額	%
流動資產		2,993,231	3,197,994	204,763	6.84
不動產、廠房及設備		837,348	780,828	(56,520)	(6.75)
無形資產		8,494	10,331	1,837	21.63
其他資產		207,443	145,834	(61,609)	(29.70)
資產總額		4,046,516	4,134,987	88,471	2.19
流動負債		2,209,009	1,841,985	(367,024)	(16.61)
非流動負債		467,176	851,395	384,219	82.24
負債總額		2,676,185	2,693,380	17,195	0.64
歸屬於母公司業主之權益		1,370,331	1,441,607	71,276	5.20
股本		788,400	788,400	0	0.0
資本公積		153,938	153,938	0	0.0
保留盈餘		477,284	517,347	40,063	8.39
其他權益		(49,291)	(18,078)	31,213	(63.32)
非控制權益		0	0	0	0.0
權益總額		1,370,331	1,441,607	71,276	5.20
變動原因說明(變動達 20% 以上，且變動金額達新臺幣一千萬元者)：					
1. 其他資產：下降原因，主要係本公司積極收回應收帳款致呆帳回升利益所產生之遞延所得稅資產減少所致。					
2. 非流動負債：動撥聯貸償還短期借款所致。					
3. 其他權益：主係因匯率變動產生之累積換算調整數所致。					

(二) 未來因應計畫：本公司將持續致力於績效之改善並增強研發實力，開發新產品，拓展產業領域，以提高獲利能力。

二、 財務績效

(一) 最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因及其影響：

單位：新台幣千元

項目	年度	112 年度	113 年度	差 異	
				金 額	%
營業收入		1,627,153	1,822,989	195,836	12.04%
營業毛利		452,478	563,008	110,530	24.43%
營業費用		637,534	593,316	(44,218)	(6.94%)
營業淨利(損)		(185,056)	(30,308)	154,748	(83.62%)
營業外收入及支出		40,009	132,060	92,051	230.08%
稅前淨利		(145,047)	101,752	246,799	(170.15%)
所得稅費用		(10,759)	61,689	72,448	(673.37%)
本期淨利		(134,288)	40,063	174,351	(129.83%)
本期綜合損益總額		(150,694)	71,276	221,970	(147.30%)

單位：新台幣千元

年度 項目	112 年度	113 年度	差 異	
			金 額	%
變動原因說明(變動達 20% 以上，且變動金額達新臺幣一千萬元者)：				
1. 營業毛利及營業淨利(淨損)：主係因半導體產業營收比重增加所致。				
2. 營業外收入及支出：主係因美金升值產生之兌換利益所致。				
3. 稅前淨利(淨損)、本期淨利(淨損)及本期綜合損益總額：主係因半導體產業營收比重增加及美金升值導致的兌換利益所致。				

(二) 預期銷售數量與其依據：

自行車庫存已逐漸去化，疫情造成影響因素也逐漸消除，故預期114年度主要產品銷售數量將較去年微幅成長。

(三) 對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：本公司財務健全，且預估未來之業務應呈現穩定狀態，故未來財務業務應無重大不確定性。

三、現金流量

(一) 最近年度現金流量變動之分析說明：

單位：新台幣千元

年 度 項 目	112年度	113年度	變動金額	變動率%
營業活動之淨現金流入(出)	257,509	537,729	280,220	108.82
投資活動之淨現金流入(出)	(329,967)	644,462	974,429	(295.31)
籌資活動之淨現金流入(出)	247,578	(172,701)	(420,279)	(169.76)
1. 營業活動之淨現金流入(出)：主要係本期稅前淨利較去年大幅度增加所致。				
2. 投資活動之淨現金流入(出)：主要係本期因其他金融資產因償還美金質押借款新台幣全數歸還所致。				
3. 籌資活動之淨現金流入(出)：主要係本期大量償還借款所致。				

(二) 流動性不足之改善計畫：不適用。

(三) 未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣千元

期初現金餘額	全年來自營運活動淨 現金流量	全年現金流入 (出)量	現金剩餘(不 足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
1,812,414	234,785	(241,570)	1,570,844	不適用	不適用
預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

(一) 重大資本支出之運用情形及資金來源：無。

(二) 預計可能產生效益：無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

1. 最近年度轉投資政策：

本公司對轉投資之管理訂有明確之政策，對關係企業及特定公司訂有「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」，另針對子公司之管理，除於本公司投資循環作業有規範外，另訂有「子公司監督與管理辦法」以規範子公司之各項作業。

2. 最近年度轉投資獲利或虧損之主要原因、改善計畫：

113年12月31日；單位：新台幣(美金；歐元；人民幣)千元

	實際投資金額	政策	本期認列投資損益	獲利或虧損之主要原因	改善計畫
Bouncy Development Group Inc.	242,439	從事國際投資之控股公司	(70,483)	因轉投資虧損所致。	持續改善公司體質，健全財務結構。
昆山鉅東光電設備有限公司	USD2,020	機械生產及買賣	(17,409)	因本期客戶擴廠及擴線需求減少以致訂單減少，營收下降所致。	持續改善公司體質，健全財務結構。
昆山威仕東人工智能科技有限公司	RMB750	軟體開發及機械系統設置	(4,179)	因受旭東昆山營收下降，需求減少所致。。	持續改善公司體質，健全財務結構。
ASIA Great International Co., Ltd	USD8,534	從事國際投資之控股公司	(70,483)	因轉投資虧損所致。	持續改善公司體質，健全財務結構。
Shuz Tung Machinery Industrial Co.,Ltd.	USD4,200	從事國際投資之控股公司	(34,537)	因轉投資虧損所致。	持續改善公司體質，健全財務結構。
旭東機械(昆山)有限公司	USD5,300	機械生產及買賣	(70,864)	因本期客戶擴廠及擴線需求減少以致訂單減少，營收下降所致。	持續改善公司體質，健全財務結構。
耀東機械(天津)有限公司	USD800	機械生產及買賣	-	已無實質營運	已無實質營運，近期清算規劃中。
LDI Systems B.V.(註 1)	EUR\$1,103	技術研發	-	已無實質營運	已無實質營運

註1：業已全數提列減損損失。

3. 未來一年度投資計畫：無。

六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1. 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響

單位：新台幣千元

項 目	113年度		截至114年3月	
	金額	金額	金額	占營業收入比重%
利息收入	51,855	51,855	9,334	3.14
利息費用	35,384	35,384	7,368	2.48
兌換利益(損失)	108,377	108,377	13,967	4.69

本公司利息收入、利息費用占營業收入比重不高，屬合理範圍，故利率變動對本公司損益之影響尚屬合理，本公司以美金收款為大宗，且台幣資金需要為主。113年度美金匯率升值，致較上期兌換利益差距較大外，尚無重大異常之情事；另外，112年度及113年度之通貨膨脹對本公司之損益尚無重大影響。

2. 未來因應措施

本公司為降低資金成本的負擔，已建立多元籌資管道及增加往來金融機構，爭取優惠的借款利率，以降低利率變動對公司損益之影響，另本公司於112年度辦理銀行聯貸案作為償還既有金融機構借款暨充實營運資金之用途。

本公司之匯兌損益之主要來自本公司外銷部分以美元報價之部位，為有效控管匯率波動，本公司採取下列措施以因應匯率變動對於獲利之影響：

- (1) 資金調度人員隨時注意國際匯市各主要貨幣之走勢及變化，以掌握匯率走勢。
- (2) 業務單位向客戶報價時，加入因匯率變動連帶產生之售價調整考量。
- (3) 與銀行保持良好之互動關係，俾能得到更廣泛的外匯訊息與較優惠的匯率報價。

本公司除了密切觀察市場物價波動，積極開發原物料供貨來源，以試圖降低生產成本外，並與客戶維持良好的關係適時的向客戶反應生產成本，故尚能有效降低通貨膨脹對本公司獲利的影響。

(二) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

1. 從事高風險、高槓桿投資之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

本公司財務策略以穩健保守為原則，最近年度截至年報刊印日止並未從事高風險、高槓桿投資之行為。

2. 從事資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

本公司除對擁有控制權之子公司或因業務需求外，原則上不對外提供背書保證或資金貸與。且本公司已訂定「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」為日後執行之依據以確保公司最大利益。另，本公司已於112年5月5日董事會決議通過修訂本公司不得從事非避險性之衍生性金融商品，

本公司均依相關管理規定行之。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用

目標產品名稱	主要目標
晶圓光學顯微鏡自動檢測設備(全檢機)	● 研發全自動光學晶圓檢測設備，提供抽檢與全檢功能，及具備全自動化傳送系統，自動缺陷分類，結合製程參數管理、檢測軟體、產品生產資訊管理、機台狀態管理、人性化客製化介面設計，支援SECS/GEM通訊，提升設備服務化能量，滿足產業最先端的半導體晶圓應用良率控管需求。
大視野晶圓平坦度(SFQR)量測設備	● 研發具備大面積視場的晶圓幾何測量功能的量測設備，量測能力具有微奈米等級的高度測量、關鍵尺寸量測、薄膜厚度量測、薄膜應力量測、矽通孔深量測。
基板熱翹取量測設備	● 研發針對基板的溫度變形量，並設計符合客戶要求的升溫及降溫曲線控制，建立量測熱影響變形量，滿足客戶基板產品的產線全檢需求，提升建置高階產品出貨品質控管能力。
雷射光罩缺陷檢查設備	● 研發針對光罩的表面缺陷檢測，具備全自動化傳送系統，提供光罩正面及背面檢查，並將檢測結果依照表面缺陷等級自動分類。
次世代晶圓盒自動包裝設備	● 研發低碳節能設備設計的全自動晶圓盒包裝系統，客製化多複合功能系統整合，整合包裝袋模組、標籤模組、濕度卡模組、乾燥劑模組、熱封模組、真空及充填氮氣模組、包裝品質檢測。積極建置自動化製程系統技術持續創新能力，建立完整產業供應鏈體系。
自行車產業智慧機器人解決方案	● 研磨拋光模擬路徑生成，導入工研院開發之CPS機器人模擬器-EzSim，複製工研院協助水五金業者進行產業升級成功經驗，並擴散至自行車產業

一般開發機台時程約需6~12個月，主要技術為機構設計、光學系統開發、影像辨識軟體、電子系統等，本公司已累積數年基礎，目前主要在此基礎作業系統進行整合商品化；且其商品化過程中，皆受各大面板廠在需求規格上的協助，各研發計畫均可按進度完成。

本公司預計114年度投入之研發費用達295,224千元，並將視營運狀況維持一定幅度之成長，以確保本公司之核心競爭優勢。

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司向來密集注意並掌握可能影響公司營運的政策及法令，並配合調整公司內部相關制度。113年相關法令的變化對本公司的營運並無重大影響。

本公司日常營運均遵照國內外相關法令規定辦理，並隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情形，蒐集相關資訊提供經營階層決策參考，以調整本公司相關營運策略。截至目前為止，本公司並未受國內外重要政策及法律變動而有影響公司財務業務之情形。

(五) 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

本公司隨時注意所處產業之科技改變及技術發展演變，並掌握產業動態及同業市場訊息，加上不斷提昇產品品質及製程，積極擴充產能規模及提高研發能力，亦採行穩健的財務管理策略，以保有市場競爭力，故科技改變及產業變化目前對本公司尚無重大影響。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司最近年度及截至年報刊印日止，企業形象始終良好，自成立以來均專注於本業經營，並無企業形象變化產生企業危機的問題。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

本公司最近年度截至年報刊印日止，並無進行任何併購計畫，惟將來若有進行併購計畫時，必秉持審慎評估態度，考量合併是否能為公司帶來巨體綜效，以確實保障股東權益。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

本公司短期尚無其他擴充廠房的需求。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1. 進貨集中風險評估及因應措施：

本公司在重要關鍵零組件的採購上，均維持兩家以上之供應商為原則。雖本公司與各供應商間已建立長期且良好之合作關係，惟仍會定時針對各供應商之供貨品質狀況、交期及準確性做評核，以確保其供貨品質。最近二年度本公司對單一廠商之採購比重均未逾10%，故進貨來源尚稱穩定，應不致發生供貨短缺或中斷之情事。

2. 銷貨集中風險評估及因應措施：

由於本公司光電設備主要銷售對象為面板製造業及半導體製造業，目標客戶本屬少數，加上客戶建廠資本支出龐大，故客戶若將部分資本支出交由合作密切或有能力生產之設備商承做，則很容易導致設備製造商銷售集中情形；此一產業特性所造成之系統風險，實為積極開發新產品及拓展新客戶，強化產品組合結構，以擴展不同產品別客戶及訂單，避免銷貨集中之市場風險。

目前本公司依然積極拓展新客戶，每年陸續接到海外新客戶訂單，藉以分散銷貨集中之情形。

(十) 董事或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：本公司最近年度及截至年報刊印日止，董事或持股超過百分之十之大股東，並無股權大量移轉之情事。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

(十二) 本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無經營權改變之情形，故不適用。

(十三) 訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無。

(十四) 其他重要風險及因應措施：

本公司為維持資訊及電腦系統在一安全環境下正常運作，訂有資訊循環控制及資訊安全管理辦法，並於112年8月11日董事會決議通過設置「資安專責單位」及「資安專責主管」。平時除防範不明網路攻擊及惡意程式癱瘓系統外，也不定期宣導常見資訊安全事件或近期發生相關新聞，提高同仁資安意識；上班日針對 ERP 等內部重要資料做好異地備份，對於同仁系統權限管控、系統進出及 USB 存取等均有紀錄及不定時檢查，全時電子郵件收發紀錄備份，嚴格管控電腦安裝之軟體，避免公司內部重要資訊外洩。個人電腦之防毒軟體隨時自動更新，將電腦中毒風險降至最低。

七、其他重要事項

無。

陸、特別記載事項

一、 關係企業相關資料

相關資訊請連結至公開資訊觀測站(https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10)關係企業三書表。

二、 最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形

無。

三、 其他必要補充說明事項

無。

柒、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項

無。

旭東機械工業股份有限公司



董事長：莊添財

